

公司代码：688521

公司简称：芯原股份



芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分内容。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

五、 公司负责人Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、主管会计工作负责人赵春蓉及会计机构负责人（会计主管人员）沙乐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及公司未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 4

第二节 公司简介和主要财务指标 9

第三节 管理层讨论与分析 14

第四节 公司治理、环境和社会 92

第五节 重要事项 94

第六节 股份变动及股东情况 121

第七节 债券相关情况 126

第八节 财务报告 127

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、芯原、芯原股份	指	芯原微电子（上海）股份有限公司
芯原有限	指	芯原微电子（上海）有限公司，公司的前身
美国思略	指	美国思略科技有限公司（Celestry Design Technologies, Inc.）
图芯上海	指	图芯芯片技术（上海）有限公司，公司的境内子公司
图芯美国	指	Vivante Corporation，原名为 Giquila Corporation，公司的美国子公司
芯原成都	指	芯原微电子（成都）有限公司，公司的境内子公司
芯原北京	指	芯原微电子（北京）有限公司，公司的境内子公司
芯原南京	指	芯原微电子（南京）有限公司，公司的境内子公司
芯原海南	指	芯原微电子（海南）有限公司，公司的境内子公司
芯原科技	指	芯原科技（上海）有限公司，公司的境内子公司
芯原广州	指	芯原微电子（广州）有限公司，公司的境内子公司
天遂芯愿	指	天遂芯愿科技(上海)有限公司，公司的境内控股子公司
逐点半导体	指	逐点半导体（上海）股份有限公司，于 2026 年 1 月成为天遂芯愿的全资子公司
逐点珠海	指	逐点半导体（珠海）有限公司，逐点半导体（上海）股份有限公司的全资子公司
芯思原	指	芯思原微电子有限公司，公司的境内联营企业
台湾分公司	指	香港商芯原有限公司台湾分公司，公司的中国台湾分公司
芯原开曼	指	VeriSilicon Holdings Co., Ltd.，原名为 VeriSilicon Holdings（Cayman Island）Co.,Ltd.，报告期内曾经为公司前身的唯一股东，为公司在开曼设立的境外子公司
芯原香港	指	VeriSilicon（Hong Kong）Limited，公司的中国香港子公司
芯原美国	指	VeriSilicon, Inc.，公司的美国子公司
共青城原天	指	共青城原天投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
共青城原厚	指	共青城原厚投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
共青城原德	指	共青城原德投资合伙企业（有限合伙），公司首次公开发行前股东
兴橙投资方	指	嘉兴时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）
国开基金	指	济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙），曾与兴橙投资方构成一致行动关系。2025 年 9 月，因国开基金执行事务合伙人变更，国开基金不再与兴橙投资方构成一致行动关系。
浦东新兴	指	上海浦东新兴产业投资有限公司，公司首次公开发行前股东

华为	指	华为投资控股有限公司或其有关实体
英特尔	指	Intel Corporation
博世	指	Robert Bosch GmbH 或其有关主体
恩智浦	指	NXP USA, Inc.
新思科技	指	Synopsys International Limited
三星	指	Samsung Electronics Co., Ltd.或其有关实体
铿腾电子	指	Cadence Design Systems, Inc.
亚马逊	指	亚马逊公司（Amazon com, Inc.），美国纳斯达克交易所上市公司（股票代码：AMZN.O）或其有关实体
报告期、报告期内	指	自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止的期间
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《公司章程》	指	《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》
A 股	指	获准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票
中国香港	指	中国香港特别行政区
中国台湾	指	中国台湾地区
中国、境内	指	中华人民共和国，为本报告之目的，不包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
半导体器件	指	利用半导体材料特殊电特性完成特定功能电子器
芯片、集成电路、IC	指	Integrated Circuit，一种微型电子器件或部件，采用一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
晶圆、晶圆片	指	Wafer，指经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 成品
裸片、芯片裸片	指	Die，晶圆经过切割测试后没有经过封装的芯片
芯片设计	指	包括电路功能设计、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制和验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程
芯片封装	指	把晶圆上的半导体集成电路，用导线及各种连接方式，加工成含外壳和管脚的可使用的芯片成品，起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
芯片测试	指	集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作
工艺节点、制程	指	集成电路内电路与电路之间的距离，精度越高，同等功能的 IC 体积越小、成本越低、功耗越小，当

		前工艺节点已达 nm 级
流片	指	为了验证集成电路设计是否成功，需要进行流片，即从一个电路图到一块芯片，检验每一个工艺步骤是否可行，检验电路是否具备所需要的性能和功能。如果流片成功，就可以大规模地制造芯片；反之，则需找出其中的原因，并进行相应的优化设计——上述过程一般称之为工程试作样片流片。在工程试作样片流片成功后进行的大规模批量生产则称之为量产流片
RTL	指	Register-Transfer Level，即寄存器转换级电路描述，是芯片设计中的一种实现形式
IDM	指	Integrated Device Manufacturer，指涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装及测试等各业务环节的集成电路企业
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，指原始设备制造商，意为通常拥有充裕、廉价的劳动力，提供国际市场所需的制造、组装产品之委托服务的厂商，即代工厂
系统厂商	指	面向终端应用提供整机系统设备的厂商，本报告中系统厂商包括 OEM 和 ODM
芯片设计公司	指	无晶圆生产设计公司，指企业只从事集成电路研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试环节分别委托给专业厂商完成
晶圆厂	指	晶圆代工厂，指专门从事晶圆加工代工的工厂、企业
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆制造、封装和测试厂商
CSP	指	Cloud Service Provider，指云服务提供商
芯片定制解决方案服务	指	过往信息披露中的“一站式芯片定制业务”
半导体 IP 授权服务	指	过往信息披露中的“半导体 IP 授权业务”
设计服务	指	过往信息披露中的“芯片设计业务”
量产服务	指	过往信息披露中的“量产业务”
IP 授权使用费	指	过往信息披露中的“知识产权授权使用费”
IP 特许权使用费	指	过往信息披露中的“特许权使用费”
IP、半导体 IP	指	Semiconductor Intellectual Property，指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块
处理器 IP	指	用于完成取指令、执行指令，以及与外界存储器和逻辑部件交换信息等操作的数字 IP
模拟 IP	指	基于晶圆厂工艺的，用于处理连续性的光、声音、速度、温度等自然模拟信号的 IP
内核	指	处理器 IP 指令集架构的电路实现，是处理器 IP 的一部分
FinFET	指	Fin Field-Effect Transistor 简称，又称鳍式场效应晶体管，是一种新的互补式金属半导体晶体管，一种集成电路制造工艺
FD-SOI	指	Fully Depleted-Silicon-On-Insulator，即完全耗尽型绝缘体上硅，是一种实现平面晶体管结构的工艺技术，具有减少硅几何尺寸同时简化制造工艺的优点

CPU	指	Central Processing Unit，微处理器，是一台计算机的运算核心和控制核心
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术。本报告中，传统 CMOS 指平面基体型 CMOS 工艺
GPU IP	指	图形处理 IP，专用于绘图运算工作的数字 IP
NPU IP	指	神经网络处理 IP，专用于加速神经网络运算、机器视觉和机器学习等人工智能应用的数字 IP
VPU IP	指	视频处理 IP，专用于进行视频编解码，并结合视频增强处理和压缩技术的数字 IP
DSP IP	指	数字信号处理 IP，专用于将数字信号进行高速实时处理的数字 IP
ISP IP	指	图像信号处理 IP，专用于对图像传感器的原始数据进行处理以获得优质视觉图像的数字 IP
Display Processing IP	指	显示处理 IP，是一种进行图像显示处理的数字 IP
RF IP、射频 IP	指	射频 IP 指用于处理由天线发送接收的一定频率射频信号的 IP
SoC、系统级芯片	指	System on Chip，即片上系统，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
蓝牙、经典蓝牙、Bluetooth	指	一种支持设备短距离通信(一般 10m 内)的 2.4GHz 无线电技术及其相关通讯标准。通过它能在包括移动电话、掌上电脑、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换
低功耗蓝牙、BLE	指	Bluetooth Low Energy，与经典蓝牙使用相同的 2.4GHz 无线电频率的一种局域网技术，旨在用于医疗保健、运动健身、信标、安防、家庭娱乐等领域的新兴领域
SerDes	指	Serializer（串行器）/Deserializer（解串器），是一种主流的时分多路复用、点对点的串行通信技术
传感器	指	Sensor，用于侦测环境中所生事件或变化，并将此讯息传出至其他电子设备（如 CPU）的装置，通常由敏感元件和转换元件组成
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit，一种为专门目的而设计的集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
版图	指	Integrated Circuit Layout，集成电路版图，是真实集成电路物理情况的平面几何形状描述。
布图设计	指	集成电路设计过程的一个工作步骤，即把有连接关系的网表转换成芯片制造厂商加工生产所需要的布图连线图形的设计过程
纳米（nm）	指	长度单位，1nm（纳米）=0.001μm（微米）
fps	指	Frames Per Second，每秒帧数，每秒钟帧数愈多，所显示的动作就会越流畅
RISC	指	Reduced Instruction Set Computer 的缩写，精简指令集计算机，该指令集精简了指令数目和寻址方式，指令并行执行效果好，编译器效率高
RISC-V	指	基于精简指令集计算（RISC）原理建立的开放指令集架构，RISC-V 指令集开源，设计简便，工具链完

		整，可实现模块化设计
FPGA	指	Field Programmable Gate Array，即现场可编程逻辑门阵列，是一种可编程逻辑器件
EDA 工具	指	Electronic Design Automation，即电子设计自动化软件工具
MCU、微控制器、单片机	指	Microcontroller Unit，即微控制单元，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。
存储器、存储芯片、Memory	指	电子系统中的记忆设备，用来存放程序和数据。例如计算机中全部信息，包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。它根据控制器指定的位置存入和取出信息
HD	指	High Definition，即通常意义上的高清，分辨率在 720p 或以上
SDK	指	Software Development Kit，即软件开发工具包
物联网、IoT	指	一个动态的全球网络基础设施，它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合
AI、人工智能	指	研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学
Linux	指	一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，是一个基于 POSIX 和 UNIX 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。它能运行主要的 UNIX 工具软件、应用程序和网络协议
8K	指	一种分辨率，其横向纵向分辨率可高达 7680×4320 像素
5G	指	5th-Generation，即第五代移动电话行动通信标准
PPA	指	芯片设计中的一个重要概念，代表性能（Performance）、功耗（Power）和面积（Area）
大数据	指	巨型多元化的数据集，可透过新处理模式，发掘隐藏模式、未知的关连、市场趋势、客户喜好及其他有用信息资产，增强决策力、洞察力及处理优化能力
数据中心	指	数据中心是一整套复杂的设施，不仅包括计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系统），还包含冗余的数据通信连接、环境控制设备、监控设备以及各种安全装置。它为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽等业务。数据中心是对入驻企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟（其分销商、供应商、客户等）实施价值链管理的平台。
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会。
IC Insights	指	IC Insights, Inc.，即集成电路观察，美国半导体市场研究公司
IPnest	指	知名 IP 领域调研机构

IBS	指	International Business Strategies，国际商业战略公司
2020 年限制性股票激励计划	指	芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划
Chiplet	指	预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片，是半导体 IP 在硅级别的实现
云服务	指	基于云计算而为用户提供服务
边缘人工智能	指	将人工智能技术和边缘计算能力相结合，使人工智能算法运行在可进行边缘计算的设备上而不必上传云端进行处理
GNSS	指	所有导航定位卫星的总称，凡是可以通过捕获跟踪其卫星信号实现定位的系统，均可纳入 GNSS 系统的范围
Alphawave	指	Alphawave IP Inc.
赛昉科技	指	上海赛昉半导体科技有限公司
兆易创新	指	兆易创新科技集团股份有限公司
威视芯	指	威视芯半导体（合肥）有限公司
鹏瞰	指	鹏瞰集成电路（杭州）有限公司
至成微	指	至成微科技（浙江）有限公司
迈矽科	指	南京迈矽科微电子科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司基本情况

公司的中文名称	芯原微电子（上海）股份有限公司
公司的中文简称	芯原股份
公司的外文名称	VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	VeriSilicon
公司的法定代表人	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	http://www.verisilicon.com/
电子信箱	IR@verisilicon.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	石雯丽	石为路、王晓璐
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A	中国（上海）自由贸易试验区春晓路289号张江大厦20A
电话	021-68608521	021-68608521
传真	021-68608889	021-68608889
电子信箱	IR@verisilicon.com	IR@verisilicon.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

（一）公司股票/存托凭证简况

（二）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	芯原股份	688521	不适用

（三）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

（四）其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
	签字会计师姓名	沈洁、王婧琳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
	签字的保荐代表人姓名	许小松、邬凯丞
	持续督导的期间	2025 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 31 日

四、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,863,539,395.68	973,799,834.20	91.37
利润总额	-596,954,213.39	-308,379,073.86	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-612,125,014.89	-319,848,567.48	不适用
归属于上市公司股东的	-621,849,867.50	-358,014,994.84	不适用

扣除非经常性损益的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	625,794,918.53	-365,199,793.86	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,925,491,889.07	3,417,506,484.87	-14.40
总资产	9,060,498,441.18	7,717,557,679.75	17.40
项目	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经调整后归属于上市公司股东的净利润（注）	-422,728,063.71	-319,652,305.39	不适用
经调整后EBITDA（息税折旧及摊销前利润）（注）	-222,459,900.51	-155,802,610.59	不适用

注：EBITDA（息税折旧及摊销前利润）=净利润+财务费用利息支出+所得税费用+折旧+摊销。
经调整后归属于上市公司股东的净利润、经调整后 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）调整项目均主要包括：①报告期内股份支付费用；②报告期内公司收购事项产生的非经营性或非现金性费用。

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-1.16	-0.64	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-1.16	-0.64	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-1.18	-0.71	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-19.29	-15.42	减少3.87个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-19.60	-17.26	减少2.34个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	50.49	65.71	减少15.22个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司实现营业收入 18.64 亿元，同比增长 91.37%，经调整后归属于上市公司股东的净利润-4.23 亿元，经调整后 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）-2.22 亿元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 90.60 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 29.25 亿元。公司报告期内经营情况分析请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

五、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

六、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,076.67	二十、1
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,645,176.17	二十、1
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-13,046,432.13	二十、1
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	245,500.00	二十、1
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,700.89	二十、1
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,598,015.65	二十、1
少数股东权益影响额（税后）		
合计	9,724,852.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐适用 ☒不适用

七、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	-479,314,914.01	-319,652,305.39	不适用

八、非企业会计准则业绩指标说明

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	本期数	上期数
会计指标：净利润	-612,125,014.89	-319,848,567.48
调整项目：折旧摊销、利息与 所得税费用	200,268,163.20	163,849,694.80
调整项目：股份支付费用	132,810,100.88	196,262.09
调整项目：公司收购事项产生 的非经营性或非现金性费用 (注)	54,615,431.37	-
调整项目：其他	1,971,418.93	-
非企业会计准则财务指标：经调 整后 EBITDA（息税折旧及摊销 前利润）	-222,459,900.51	-155,802,610.59

注：公司收购事项产生的无形资产摊销及非现金性利息费用在“公司收购事项产生的非经营性或非现金性费用”中列示。

选取该非企业会计准则财务指标的原因

经调整后 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）剔除了折旧、摊销、股份支付、公司收购事项等产生的非经营性、非现金性费用等对业绩的影响，能更准确的反映公司实际经营成果，有助于投资者更准确地评估公司的核心业务盈利能力和经营效率。

选取的非企业会计准则财务指标或调整项目较上一年度发生变化的说明

☐适用 ☒不适用

该非企业会计准则财务指标本期增减变化的原因

公司非企业会计准则财务指标变动分析请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

芯原是一家领先的芯片定制解决方案上市公司，且拥有全面、专有的半导体 IP 组合。

公司拥有自主可控的图形处理 IP（GPU IP）、神经网络处理 IP（NPU IP）、视频处理 IP（VPU IP）、数字信号处理 IP（DSP IP）、图像信号处理 IP（ISP IP）和显示处理 IP（Display Processing IP）这六类处理器 IP，以及 1,700 多个数模混合 IP、射频 IP 和接口 IP。

基于自有的 IP，公司已拥有丰富的面向人工智能（AI）应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AI/AR 眼镜等始终在线（Always on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、AI 玩具、AI 戒指、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。

为顺应大算力需求所推动的 SoC（系统级芯片）向 SiP（系统级封装）发展的趋势，芯原正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的研发和产业化。

基于公司独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式，目前公司主营业务的应用领域广泛包括消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等，主要客户包括芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商等。

芯原在传统 CMOS、先进 FinFET 和 FD-SOI 等全球主流半导体工艺节点上都具有优秀的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm/4nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。根据灼识咨询的最新报告，截至 2025 年底，芯原在半导体 IP 和定制芯片两大领域均位居全球前列：在 IP 业务方面，芯原拥有全球最多的半导体 IP 类别，IP 总收入位列中国大陆第一、全球第八，IP 授权收入排名全球第六，且在主要专注于数字 IP 的供应商中排名全球第二；在定制芯片解决方案方面，芯原则是全球第四大全栈式服务商，同时在中国大陆高居榜首。2020 年，公司在科创板上市时，曾被誉为“中国半导体 IP 第一股”；随着公司业务在 AI 芯片定制领域获得快速增长，目前公司已被业界誉为“AI ASIC 龙头企业”。

2、主要服务情况

公司主要为消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等广泛市场提供

芯片定制解决方案服务和半导体 IP 授权服务。具体情况如下：

（1）芯片定制解决方案服务

芯片定制解决方案服务是指向客户提供平台化的芯片定制方案，并可以接受委托完成从芯片设计到晶圆制造、封装和测试的全部或部分服务环节，充分利用半导体 IP 资源和芯片研发能力，满足不同客户的芯片定制需求，帮助客户降低设计风险，缩短设计周期。其中，半导体 IP 除在芯片定制解决方案服务中使用外，也可以单独对外授权。

芯片定制解决方案服务具体可分为两个主要环节，分别为芯片设计服务和芯片量产服务。

①芯片设计服务：主要指为客户提供以下过程中的部分或全部服务，即根据客户对芯片在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和 IP 选型，通过设计、实现及验证，逐步转化为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产工程晶圆，封装厂及测试厂进行工程样片封装测试，从而完成芯片样片生产，最终将经过公司技术人员验证过的样片交付给客户的全部过程。

②芯片量产服务：主要指为客户提供以下过程中的部分或全部服务，即根据客户需求委托晶圆厂进行晶圆制造、委托封装厂及测试厂进行封装和测试，并提供以上过程中的生产管理服务，最终交付给客户晶圆片或者芯片的全部过程。

公司还为客户提供软件开发平台、面向应用的软件解决方案、软件开发包、定制软件、软件维护与升级等服务，可大幅降低客户的研发周期和风险，帮助客户快速响应市场。通过将公司的半导体 IP、芯片定制服务和软件支持服务等全面有机结合，芯原可为客户提供系统平台解决方案，包括高性能 SoC 平台、转码 SoC 平台、自动驾驶 SoC 平台、高性能 AIGC 平台、AI 图像处理 SoC 平台、超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台、混合信号 ASIC 平台、低能耗 BLE MCU 解决方案及芯健康（VeriHealthi）平台等。此外，公司还面向云端 AIGC 计算和智慧驾驶应用提供基于 Chiplet 架构的芯片设计软、硬件解决方案。

按照客户特征类型区分，芯原主要为芯片设计公司、IDM、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商（Cloud Service Provider, CSP）等客户提供芯片定制解决方案服务。

（2）半导体 IP 授权服务

除在芯片定制解决方案服务中使用自主半导体 IP 之外，公司也向客户单独提供处理器 IP、数模混合 IP、射频 IP、接口 IP、IP 子系统、IP 平台和 IP 定制等半导体 IP 授权服务。

半导体 IP 授权服务主要是将集成电路设计时所需用到的经过验证、可重复使用且具备特定功能的模块（即半导体 IP）授权给客户使用，并提供相应的配套软件。

芯原的处理器 IP 主要包括图形处理 IP、神经网络处理 IP、视频处理 IP、数字信号处理 IP、图像信号处理 IP 和显示处理 IP。

公司还拥有数模混合 IP、射频 IP 和接口 IP 共计 1,700 多个。其中，芯原基于 22nm FD-SOI 等工艺开发了多款低功耗高性能的射频 IP 和基带 IP，支持包括蓝牙、Wi-Fi、蜂窝物联网、多模卫星导航定位在内的多种技术标准，所有射频 IP 均已获多款客户芯片采用，被广泛部署于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。芯原还在多节点工艺平台完成了系列接口 IP 的开发，覆盖成熟工艺与先进工艺，具体包括 28nm/22nm FD-SOI、中芯国际 40nm/55nm 及 28nm HKE、三星 4nm/8nm/14nm/28nm，以及台积电 12nm 等，相关 IP 全面支持消费级、企业级及车规级应用场景，广泛赋能消费电子、人工智能、高性能计算和智能汽车等核心领域。

此外，公司还可根据客户需求，为部分芯片定制客户提供定制 IP 的服务。

为降低客户开发成本、风险和缩短产品上市周期，芯原根据客户和市场需求，还推出了半导体 IP 平台授权服务。该授权平台通常含有公司的多个 IP 产品，IP 之间有机结合形成了子系统解决方案和平台解决方案，优化了 IP 之间协处理的效率、降低了系统功耗，简化了系统设计。



图：公司提供的主要服务图

（二）主要经营模式

公司商业模式以及具体盈利、采购、研发、营销、管理及服务模式如下：

1、商业模式

芯原的主要经营模式为芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS®）模式（以下简称“SiPaaS 模式”）。

与传统的芯片设计服务公司经营模式不同，芯原自主拥有的各类处理器 IP、数模混合 IP、射频 IP 和接口 IP 是 SiPaaS 模式的核心。通过对各类 IP 进行工艺节点、面积、带宽、性能和软件等系统级优化，芯原打造出了灵活可复用的芯片设计平台，从而降低客户的设计时间、成本和风险，提高芯原的服务质量和效率。此外，芯原的芯片设计服务全面包含了芯片的前端设计、后端设计、软件设计和量产管理服务，可为客户提供完整的从芯片定义到交付的全栈式服务。

公司与芯片产品公司的经营模式亦有一定差异，通常行业内芯片设计公司主要以设计并销售自有品牌芯片产品而开展业务运营。SiPaaS 模式并无自有品牌的芯片产品，而是通过积累的芯片定制技术和半导体 IP 技术为客户提供芯片定制解决方案服务和半导体 IP 授权服务，而产品的销售则由客户自身负责。该种经营模式使得公司集中力量于自身最为擅长的技术授权和研发平台输出，市场风险和库存风险压力较小。

SiPaaS 模式具有平台化、全方位、一站式三个主要特点，这三个特点分别带来了可复用性、应用领域扩展性、可规模化的独特优势，这些优势共同形成了芯原较高的竞争壁垒。

2、盈利模式

公司主要通过向客户提供芯片定制解决方案服务（含软件支持）和半导体 IP 授权服务取得业务收入。

芯片定制解决方案服务收入主要系公司根据客户芯片和软件定制需求，完成客户芯片设计和制造中的全部或部分业务流程环节，以及相关软件设计所获取的收入。在芯片设计阶段，公司主要负责芯片硬件和软件设计工作，以及按客户需求为其定制部分 IP（通常为模拟 IP），并获取相关收入。

当芯片设计和软件设计完成并通过验证后，客户将根据终端市场情况向公司下达量产芯片的订单，订单通常包含量产芯片的名称、规格、数量、单价等要素，公司将依据客户订单为其提供芯片的委外生产管理服务，交付符合规格要求的芯片产品并获取芯片量产服务收入，该阶段通常在客户下达生产订单时预收一部分款项，待芯片完工发货后收取剩余款项。

半导体 IP 授权服务收入主要系公司将其研发的半导体 IP 以单个 IP 或 IP 平台的方式授权给客户使用所获取的收入。在客户芯片设计阶段，公司直接向客户交付半导体 IP 或 IP 平台，并获取 IP 授权使用费收入。该阶段通常在签署合同时收取一部分款项，待 IP 或 IP 平台交付完成后收取剩余款项。客户利用该 IP 或 IP 平台完成芯片设计并量产后，公司依照合同约定，根据客户芯片的销售情况，按照量产芯片的单位数量获取 IP 特许权使用费收入，该阶段客户通常按季度向公司提交芯片销售情况作为结算依据。

3、采购模式

公司建立了完整稳定的采购管理流程，并使用企业级资源管理系统 SAP 作为基本工具来执行公司采购业务。公司的采购模式主要包括一般采购模式和客户订单需求采购模式。

一般采购模式主要适用于公司研发所需的通用软硬件采购，主要采购内容包含 EDA/设计工具、验证工具、仪器设备、服务器、存储以及网络设备等。客户订单需求采购模式主要适用于芯片定制解决方案服务，公司将根据客户的量产芯片订单需求，以委外的形式向晶圆厂采购晶圆，并向封装及测试厂采购封装及测试服务，以完成芯片制造。

供应商选择方面，公司实施严格的供应商准入制度，设有合格供应商名单，并对该名单中的合格供应商进行定期考核和评定。在具体项目执行时，通常会综合考虑供应商生产工艺节点的稳定性、成本结构以及交货周期等因素，以保证产品的质量，协助客户做出最佳的选择。

4、研发模式

公司采用以市场和客户需求为导向的研发模式，结合未来技术及相关行业发展方向，开展关键性、先进性的芯片定制技术、半导体 IP 技术和软件技术的研发，并建立了中国上海、成都、北京、南京、海口和广州，美国硅谷和达拉斯，以及越南胡志明市九个研发中心。

（1）芯片定制解决方案研发流程

公司芯片定制解决方案研发方向包括应用于设计平台的设计方法论，以 IP 为核心的功能子系统等。公司结合自有或第三方 IP，针对不同应用场景，开发了相应的设计平台并应用于实际客户的项目实现中。设计平台包括功能子系统、相应的设计及验证方法论和工艺节点实现流程。设计平台的研发流程主要包含需求收集、项目立项、项目研发、项目验收及成果推广，研发成果主要应用于设计平台的预研及改进。

（2）软件研发流程

公司软件开发流程主要包括需求分析、软件规格制定、软件开发计划制定、软件架构设计、软件开发、代码审核与测试、软件质量评审以及软件发布。

公司已经建立了完善的自动化测试和严格的质量管控流程，实现软件快速持续迭代与发布，确保按照客户要求交付高质量的软件。

（3）半导体 IP 研发流程

公司半导体 IP 研发流程主要包括产品市场调研、技术可行性分析、产品规格制定、研发计划制定、IP 架构设计、IP 设计实现、IP 设计验证、IP 性能测试以及设计验收。

5、服务模式

（1）芯片定制解决方案服务的服务模式

①设计规格定义

根据客户提交的产品规格要求书，细化芯片的设计规格，包括 IP 选型、部分 IP 的定制、功能及性能指标、芯片架构方案等，并制定芯片设计规格书。芯片设计规格书通常由双方经过反复讨论及修订，形成书面文件，并由双方审核确认。

②设计实现及样片验证

根据芯片设计规格书进行设计实现，包括但不限于 IP 的采购及定制、逻辑设计、设计整合、

设计验证、原型验证、物理实现及封测设计。在设计过程中，根据芯片设计规格书，并按照与客户约定的设计审核里程碑，定期或在关键节点对项目进展及阶段性设计成果进行讨论及审核。依据审核结果决定是否进入下一阶段。如果芯片设计规格需要更改，在双方同意下，更新相应的芯片设计规格书，并对设计计划做相应调整。

设计完成并通过流片审核后，芯片进入样片试生产阶段，设计数据交付给相应晶圆厂、封装测试厂进行样片流片。

样片流片完成后，进入样片验证阶段。公司与客户的设计及系统团队，根据设计规格，完成样片的测试验证，并在双方审核后签署样片确认书。

③产品量产及配套支持

完成样片验证后，项目进入量产阶段。按照与客户约定的下单流程，接受客户订单，制定生产计划，将相应订单分解为各委外供应商（晶圆厂、封测厂、物流及其他供应商）的订单，安排产品生产。同时监控各阶段生产状况（生产进程及相关数据），并定期将生产状况向客户汇报。当生产需求或状况发生变动时，协调客户及委外供应商，调整生产计划、调查变动原因，保证生产的正常进行。

④软件设计支持

根据客户的需求，在芯片设计的同时，开展相应的软件设计服务。按照与客户的约定，为客户设计应用软件、软件开发平台、软件开发包等，亦可根据客户需求提供定制软件、软件维护与升级等服务。在软件设计过程中，按照与客户约定的设计审核里程碑，定期或在关键节点对项目进展及阶段性设计成果进行讨论及审核。依据审核结果决定是否进入下一阶段。如果设计需求发生更改，在双方同意下，对设计计划做相应调整，然后进行下一步的开发。

设计完成后，将所有设计数据交由客户进行验收测试，并根据客户的反馈进行相应的调试工作。设计通过客户审核后，双方签署软件确认书。

（2）半导体 IP 授权服务的服务模式

①半导体 IP 或 IP 平台向客户交付

在根据协议向客户交付授权的半导体 IP 或 IP 平台时，主要交付该 IP 或 IP 平台的数据文件，并附以全套功能说明文档和用户 IP 或 IP 平台的集成和实现使用手册。

②交付后配套支持

一般情况下，根据协议，半导体 IP 或 IP 平台交付后客户享有一年的技术支持期，芯原为客户提供半导体 IP 或 IP 平台集成和使用过程中所需的技术支持。技术支持期结束后，客户可根据实际需要延长技术支持期或采购其他后续服务。

6、营销模式

公司建立了全球化的市场销售体系，在中国大陆、中国台湾、美国硅谷、欧洲、日本、韩国等目标客户集中区域设置了销售和技术支持中心，能及时了解市场动向和客户需求，便于推广和销售公司各项服务。同时，根据芯原分区域销售原则，芯原通常以境外主体与境外客户签署协议、境内主体与境内客户签署协议。在销售过程中，各区域的销售团队和技术支持中心保持紧密沟通和协作，就近为客户提供相关销售及技术支持，以提高客户服务的响应速度和满意度。

7、管理模式

公司采用一站式全流程管理模式，为客户提供从芯片和软件定义、IP 选型及工艺评估，到芯片和软件设计、验证、实现、样片流片、小生产测试，直至大规模量产的全流程服务。一站式全流程管理模式主要包括芯片设计（含软件设计）、流片/小批量生产测试及量产三个阶段。

（三）所处行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司隶属于“软件和信息技术服务业”下的“集成电路设计”（行业代码：I6520）。公司所处行业情况具体如下：

（1）全球集成电路市场需求旺盛

集成电路产业发展的大环境为半导体产业，二者的发展景气度高度一致。受全球经济、国际形势、关键元器件供给周期的影响，近期半导体行业存在一定的周期波动，但长期的增长趋势始终未发生变化，其最重要的原因是以技术进步为基石而带来的新兴应用的推陈出新。

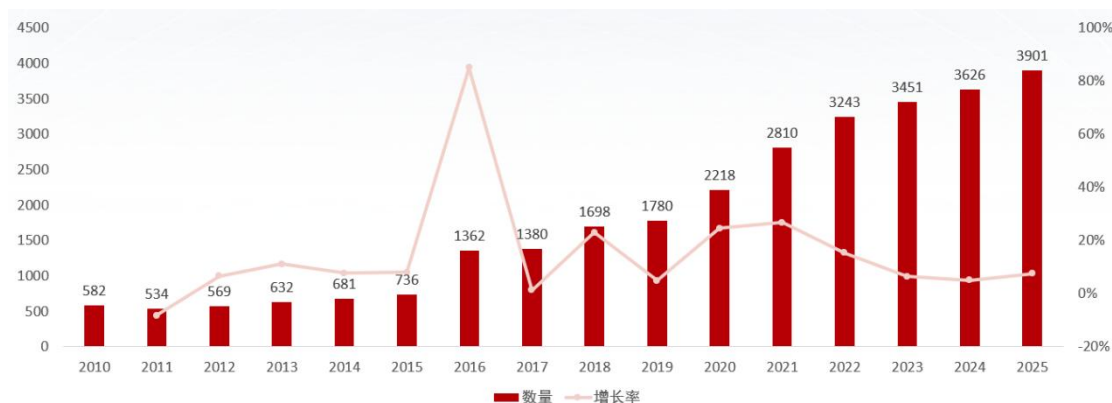
从个人电脑驱动宽带互联网，到智能手机驱动移动互联网，到人工智能（AI）赋能万物，再到生成式人工智能（AIGC）推动生活和生产的全面智能升级，上述技术更替使得半导体产业的市场前景和发展机遇越来越广阔。目前，半导体产业最主要的发展动力源自于人工智能、大数据、云计算、5G 通信、物联网、智慧汽车和新能源等应用的快速发展，而这其中，AIGC 的快速演进与边缘计算技术的日益成熟，正推动全球半导体产业进入新一轮快速增长阶段。根据 IBS 报告，2025 年全球半导体市场规模为 6,726 亿美元，而上述应用将驱动着该市场在 2035 年达到 16,341 亿美元，呈稳定快速增长态势。AIGC 技术则将快速渗透至半导体各类应用场景，到 2035 年，AI 相关半导体将占据 77.7% 的整体半导体市场份额，边缘端物理 AI 的广泛普及将成为半导体市场增长的核心驱动力。

（2）中国集成电路产业快速发展

中国大陆是全球最大的电子设备生产基地，也是集成电路器件最大的消费市场，而且其需求增速持续保持较高水平。强劲的市场需求，明确的政策引导，以及本土化安全可控的供应链管理趋势，促使中国大陆集成电路生态得到快速发展，进而扩大了中国集成电路整体产业规模。

从上游集成电路制造端来看，国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的《300 毫米晶圆厂展望》报告指出，中国大陆将继续在 300 毫米设备支出方面保持领先地位，预计 2026 年至 2028 年的投资额将达到 940 亿美元。韩国将以 860 亿美元的投资额位居第二，中国台湾未来三年将在 300 毫米设备上投资 750 亿美元，位居第三，主要集中在 2nm 及以下产能上。Trend Force 预计，到 2027 年，中国大陆成熟制程产能的全球占比将从 29%增长至 33%。

从下游集成电路设计端来看，中国大陆晶圆产能的快速提升，为国内集成电路设计行业在降低成本、扩大产能、提高地域便利性等方面提供了支持，对整个集成电路产业的发展起到了拉动作用。同时，大陆市场的旺盛需求和投资热潮也促进了我国集成电路设计行业专业人才的培养及配套产业的发展。集成电路产业环境的良性发展为我国集成电路设计产业的扩张和升级提供了机遇。在上述大环境下，中国的芯片设计公司数量稳步增加。中国半导体行业协会集成电路设计分会公布的数据显示，自 2016 年以来，我国芯片设计公司数量大幅提升，2015 年仅为 736 家，2025 年快速增长到了 3901 家。



图：2010-2025 年芯片设计企业数量增长情况

数据来源：中国半导体行业协会集成电路设计分会

中国半导体市场是全球重要且高速发展的市场。根据 IBS 的报告，中国半导体公司在中国市场的供应也处在高速增长阶段，外国半导体公司在中国的市场份额正在减少。2025 年，中国半导体市场规模达 2,744 亿美元，中国半导体公司占据其中 38.2% 的市场份额；到 2030 年，预计中国半导体市场规模达 3,737 亿美元，中国半导体公司所占的市场份额则将快速扩大到 63%。

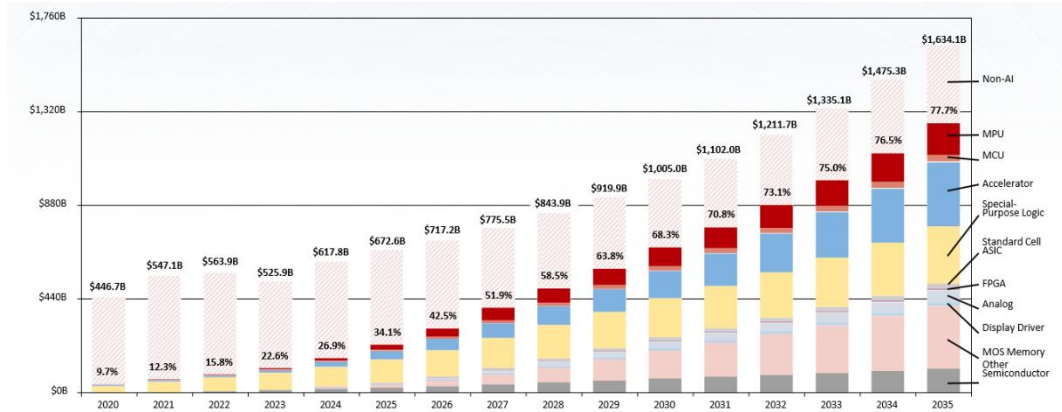


图：中国的半导体供应预测

数据来源: IBS, 2025 年 8 月

（3）AI ASIC 从云到端的需求显著提升，进而推动定制 ASIC 市场增长

近年来，随着人工智能技术的快速发展，尤其是 AIGC 模型的广泛应用，半导体产业迎来了高速增长期。研究机构 IBS 的数据显示，到 2035 年，AI 相关半导体将占据 77.7% 的半导体市场份额，边缘端物理 AI 的广泛普及将成为半导体市场增长的核心驱动力。

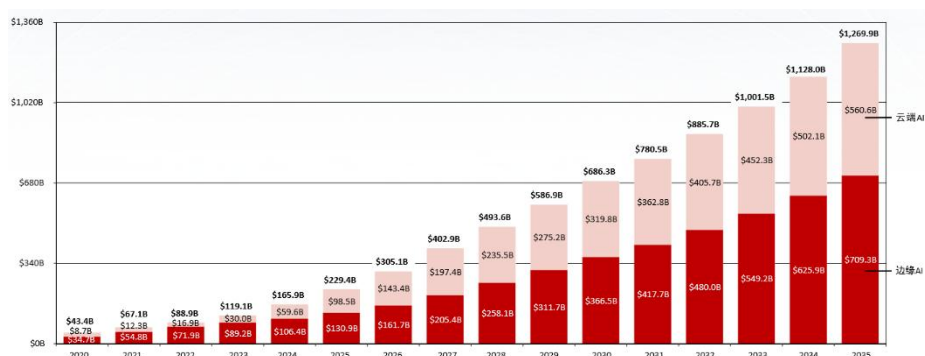


图：AI 相关半导体产品市场占比

数据来源: IBS, 2025 年 8 月

因算法较为复杂和需要进行海量数据处理，AIGC 模型在云侧进行训练和推理，以及在端侧进行微调和推理时，产生了很大的算力需求，传统通用芯片（如 CPU、GPU）在能效比和算力成本上逐渐难以满足特定场景需求。而 AI ASIC 凭借其定制化架构、高计算密度和低功耗特性，可以在特定场景中实现高性价比和低功耗，正成为市场增长的核心驱动力，这也推动了产业链相关企业加速研发更先进的制程工艺、先进的封装技术、创新的芯片架构（如 Chiplet），以及定制专用的 AI ASIC 芯片。目前，AI ASIC 正在被众多细分垂直领域的领先企业所采用，包括谷歌的 TPU、百度的昆仑芯，以及自动驾驶和消费电子领域的领先 OEM 厂商等。

值得一提的是，随着 AI 技术不断向应用端渗透，边缘端的 AI 计算，包括微调和推理，将成为半导体市场未来十年增长的关键。研究机构 IBS 的数据显示，2025 年端侧 AI 的市场规模为 1,309 亿美元，2035 年将快速增长至 7,093 亿美元，极大驱动着半导体市场的增速。在边缘 AI 计算中，性能、功耗和面积尺寸（PPA）的每一项指标都很重要，将直接影响应用端数据处理的效率、能耗和成本，AI ASIC 更是成为端侧 AI 芯片的首要选择。



图片：云端计算 AI 芯片 vs. 边缘计算 AI 芯片

数据来源: IBS, 2025 年 8 月

（4）系统厂商、互联网厂商、云服务提供商、车企自主设计芯片的趋势明显

近年来，系统厂商、互联网公司、云服务提供商、车企因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为业务结构、运营策略、芯片设计资源和经验相对欠缺等原因，多寻求与芯片设计服务公司进行合作。例如小米、苹果等系统厂商都拥有自己的芯片设计团队或者希望依托集成电路设计服务企业帮助自己开发专用芯片；谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、快手等互联网公司，纷纷着手开发与其业务相关的自有芯片；国内知名的新能源车企如蔚来、小鹏、理想等，都纷纷推出了自研智驾芯片等，这种趋势为集成电路设计产业中半导体 IP 和芯片设计服务的发展拓展了市场空间。

此外，该类企业因其核心业务为应用端的产品或是服务，因此在寻求芯片设计服务时，多倾向于采用含硬件和软件的完整的系统解决方案，以缩短开发周期和降低风险。

（5）安全、可控的迫切需求

集成电路产业是国家战略性产业，集成电路芯片被运用在社会的各个角落，只有做到芯片底层技术和底层架构的完全“安全、可控”，才能保证国家信息系统的安全独立。目前我国绝大部分的芯片都建立在国外公司的 IP 授权或架构授权基础上。核心技术和知识产权的受制于人具有着较大的技术和供应风险。IP 和芯片底层架构国产化是解决上述困境的有效途径，市场对国产芯片的“安全、可控”的迫切需求为本土半导体 IP 供应商提供了发展空间。

（6）良好的半导体产业扶持政策

国家高度重视和大力支持集成电路行业的发展，相继出台了多项政策，如国务院于 2020 年 8 月发布的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，将集成电路产业发展提升到国家战略的高度，充分显示出国家发展集成电路产业的决心。在 2021 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中，则进一步提出了要加

强在人工智能、量子计算、集成电路前沿领域的前瞻性布局。2024 年《政府工作报告》则围绕“加快发展新质生产力”做出了三大具体部署，其中包括推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型；深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群；以及积极培育新兴产业和未来产业。2025 年，国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确指出要强化智能算力统筹，支持 AI 芯片创新，加大金融和财政支持力度，发展耐心资本等，以推动人工智能与经济社会各行业各领域广泛深度融合，重塑人类生产生活范式，促进生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态。2026 年 6 月 18 日商务部牵头八部门发布了《加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，该政策通过力推 AI 手机、智能汽车、AI 眼镜等新型终端放量，将直接拉动集成电路在端侧芯片、传感器及通信模组等领域的需求，为产业带来显著的市场增量。

在良好的政策环境下，我国集成电路行业迎来了前所未有的发展契机，有助于我国集成电路设计产业技术水平的提高和行业的快速发展。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

芯原的主要业务为提供芯片定制解决方案服务和半导体 IP 授权服务，且占比均为重要，两者具有很强的协同效应，共同促进公司研发成果价值最大化，加之行业内类似供应商的业务布局、市场策略及目标客户群体有所不同，因此芯原不存在完全可比公司。规模化运营的芯片设计服务提供商或是半导体 IP 提供商基本都集中在海外，芯原是我国企业中极少数能与同行业全球知名公司直接竞争并不断扩大市场占有率的公司。

（1）公司的客户群体逐步转变，系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企占比保持高位

近年来，系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企等因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始设计自有品牌的芯片。这类企业因为业务结构、运营策略、芯片设计资源和经验相对欠缺等原因，多寻求与芯片设计服务公司进行合作。

芯原拥有先进的芯片定制技术、丰富的 IP 储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累，成为了系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企首选的芯片设计服务合作伙伴之一，服务的公司包括三星、谷歌、亚马逊、微软、百度、腾讯、阿里巴巴等国际领先企业。报告期内，公司来自系统厂商、互联网企业、云服务提供商和车企客户的收入占总收入比重约三成。

（2）公司是中国大陆排名第一的半导体 IP 供应商

根据灼识咨询的最新报告，截至 2025 年底，芯原拥有全球最多的半导体 IP 类别，IP 总收入位列中国大陆第一、全球第八，IP 授权收入排名全球第六，且在主要专注于数字 IP 的供应商中排名全球第二。随着后续客户产品的逐步量产，公司的 IP 特许权使用费收入将进一步提升，从而使

得公司 IP 授权业务的规模效应将进一步扩大。

目前，芯原的神经网络处理（NPU）IP 已被 91 家客户用于其 140 余款人工智能芯片中，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货约 2.5 亿颗，这些内置芯原 NPU 的芯片主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、物联网、服务器、汽车电子、智慧医疗等 10 余个市场领域，奠定了芯原在人工智能领域全球领先的根基。芯原最新一代 NPU 架构针对 Transformer 类模型进行了优化，既能高效运行 Qwen、LLAMA 类的大语言模型，也能支撑 Stable Diffusion、MiniCPM 等 AIGC 和多模态模型。芯原与谷歌基于之前 Open Se Cura 开源项目合作基础，共同打造了面向端侧大语言模型应用、基于 RISC-V 指令集的超低能耗 Coral NPU IP，这其中，谷歌提供开源技术，芯原提供企业级 IP、芯片设计及量产服务，为 AI 眼镜等智能可穿戴设备，以及 AI 玩具、AI 戒指等提供“超低能耗、始终在线、超轻量”的端侧计算解决方案。目前，芯原超低能耗 NPU 已可为移动端大语言模型应用提供超 40 TOPS 算力，并已在知名企业的手机和平板电脑中量产出货。芯原的 NPU 还与自有的众多处理器 IP 深度集成，形成包括 AI-ISP、AI-Display、AI-DSP 在内的多个 AI 加速子系统解决方案。其中，芯原的 AI-ISP 芯片定制方案（芯原提供架构设计、软硬协同设计和量产支持）已在知名企业的智能手机中量产出货。此外，针对智慧汽车快速发展的趋势，芯原 NPU IP 部分型号还通过了 ISO 26262 ASIL B 级汽车功能安全认证，标志着公司在 NPU 功能安全领域的重要进展。基于其可编程、可扩展特性，以及自有的创新 NeuroBrick 片上硬件加速解决方案，芯原的 NPU IP 可针对不同应用场景极大优化客户芯片的 PPA 特性，在业界极具竞争优势。

芯原的图形处理（GPU）IP 已深耕嵌入式市场超过 20 年，在多个重要市场领域获得了头部企业的采用，包括数据中心、汽车电子、PC、可穿戴设备等，内置芯原 GPU 的芯片已在全球范围内出货超过 20 亿颗。目前，芯原的 GPU IP 已在 30 余款智能手表和 10 余款 AI 眼镜中量产上市。芯原的 GPU IP 在桌面显示渲染方面也有突出的性能表现，现已在 10 余款国产电脑中量产上市。此外，通过将自有的 GPU 和 NPU 技术进行流水线级的深度融合，芯原还推出了系列 GPGPU IP，可灵活支持图形渲染、通用计算以及 AI 处理，为数据中心、云游戏、边缘服务器、AIGC 相关应用提供大算力通用处理平台，并利用统一的软件接口和一体化的编译器，让用户可以使用标准编程接口来驱动不同的硬件处理单元。目前，芯原的 GPGPU IP 已获得众多 AI 高性能计算客户的采用，并在全球范围内进行了多次架构授权，被应用在多款高性能计算产品中。

芯原的 Hantro 视频处理（VPU）IP 已被全球前 20 名云平台解决方案提供商中的 7 家，中国前 5 大互联网提供商中的 3 家，以及 2024 年中国造车新势力 Top 8 榜单中 5 家所采用。这反映了公司在服务器、数据中心和汽车市场占据了有利地位，这些市场也是芯原重要的目标市场。报告期内，公司的 VC9800D 视频处理（VPU）IP 已支持 AV2 解码，进一步扩展了公司面向下一代视频与流媒体应用的先进视频编解码 IP 组合。

芯原的数字信号处理 ZSP IP 于 2006 年从 LSI Logic 公司收购而来，至今已有 20 余年的技术

积累，被广泛应用于音频/语音、无线通信和计算机视觉等领域。目前，公司已推出了基于芯原第五代经硅验证的数字信号处理（DSP）架构的 ZSP 产品系列，采用高可扩展性和低功耗的设计，并针对计算机视觉、嵌入式人工智能等计算密集型应用进行了深度优化，结合架构的可配置能力，该系列 IP 可为各类边缘设备提供兼具能效优势和计算效率的优秀解决方案。

芯原的图像信号处理（ISP）IP 自 2017 年正式推出以来，快速获得了市场的认可。截至报告期末，已有约 90 家客户授权使用了芯原的 ISP IP，广泛应用于扫地机器人、汽车、安防监控、AI 眼镜、无人机和运动相机等领域，并进一步向 AI 玩具、具身智能等更泛化的 AI 边缘计算领域拓展。芯原的 ISP 研发与车规认证工作同步进行，目前已有多款 ISP IP 通过车规认证。芯原的 ISP/畸变矫正（DeWarp）处理 IP 也已被国内外 20 多家汽车电子客户所采用，已有近 20 款商用汽车集成了芯原的 ISP IP，赋能百万个汽车高级辅助驾驶系统摄像头。

此外，芯原还于报告期内推出了高性能摄像头后处理（CPP）IP，为公司的 ISP 解决方案扩展了先进的后处理能力。该 IP 能够提升移动成像场景下的图像质量与视觉感知能力，为机器人、无人机及其他移动视觉应用提供更加稳定可靠的视觉处理性能。

芯原正在加速各类车规 IP 的认证进程。目前，公司多款 ISP IP、畸变矫正处理 IP、显示处理 IP、NPU IP 和部分接口 IP 均获得了 ISO 26262 ASIL B 认证。公司其他 IP，也正在逐一通过各类车规认证的进程中。

公司在 FD-SOI 工艺上拥有较为丰富的 IP 积累。截至报告期末，公司在 22/28nm FD-SOI 工艺上开发了 60 多个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等。已累计向 47 个客户授权了 330 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 49 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 40 个项目已经流片。

面向物联网多样化场景应用，芯原在 22nm FD-SOI 工艺上还布局了较为完整的射频类 IP 产品及平台方案，支持双模蓝牙、低功耗蓝牙 BLE、NB-IoT、多通道 GNSS 及 802.11ah 等物联网连接技术。所有射频 IP 均已获得客户芯片采用，且采用芯原 802.11ah、802.15.4g 和 GNSS 射频 IP 的客户芯片已量产。上述产品被广泛应用于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。在此基础上，芯原将继续拓展 IP 种类，正在开发 Wi-Fi 6 和 BLE 6 等更多高性能射频 IP 产品及方案，支持更多物联网连接应用场景。

公司在接口 IP 上亦有丰富的布局。芯原已拥有完善的接口 IP 产品组合，可提供端到端完整解决方案，核心产品涵盖 UCIe 物理层及控制器 IP、USB 物理层及控制器 IP、MIPI D-PHY/C-PHY/A-PHY 物理层及控制器 IP、HDMI 物理层及控制器 IP、DP/eDP 物理层 IP，以及 PCIe 物理层与高速 SerDes IP。目前，绝大部分接口 IP 已成功导入国内外客户多款产品，实现大规模量产落地，助力客户在低功耗智能家居、可穿戴设备、车载高分辨率视频传输、Chiplet 高性能计算等领域实现商业化。在车规领域，芯原的接口 IP 也已取得阶段性突破——MIPI C/D-PHY TX/RX IP

已通过 ISO 26262 ASIL B 功能安全认证，并已应用在多款高级驾驶辅助系统（ADAS）芯片中。

（3）公司具有全球领先的芯片设计服务能力

根据灼识咨询的最新报告，芯原是全球第四大全栈式服务商，同时在中国大陆高居榜首。2020 年，公司在科创板上市时，曾被誉为“中国半导体 IP 第一股”，随着公司业务在 AI 芯片定制领域获得快速增长，目前公司已被业界誉为“AI ASIC 龙头企业”。

在芯片定制解决方案方面，芯原拥有从先进 4nm FinFET、22nm FD-SOI 到传统 250nm CMOS 制程的设计能力，所掌握的工艺可涵盖全球主要晶圆厂的主流工艺、特殊工艺等，已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm/4nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验。公司还提供芯片设计相关的全套软件解决方案。

此外，为满足面向汽车应用的定制芯片的特殊要求，芯原的芯片设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证。芯原还推出了功能安全（FuSa）系统级芯片（SoC）平台的总体设计流程，并基于该流程推出了智能驾驶辅助系统（ADAS）功能安全方案，完整的自动驾驶软件平台框架，以及车规级高性能自动驾驶 SoC 设计平台。这其中，自动驾驶 SoC 平台衍生自公司高性能 SoC 平台，配备高性能片上网络、CPU/NPU IP 及 ASIL D 级功能安全岛，支持客户产品获得 ISO 26262 车规认证。该平台已应用于 5nm 客户项目并实现量产。下一代平台将采用更先进工艺，通过 PCIe 和 UCIe 接口增强连接性与带宽。

芯原芯片定制解决方案服务的整体市场认可度不断提高，已占据有利地位，经营成果不断优化，特别是当英特尔、博世、恩智浦、亚马逊、谷歌、微软等众多在其各自领域具有较强的代表性和先进性的国内外知名企业成为芯原客户并且形成具有较强示范效应的服务成果后，公司在品牌方面的竞争能力进一步增强。

基于公司先进的芯片设计能力，芯原还推出了一系列面向快速发展市场的平台化解决方案。尤其在 AI 应用领域，公司已拥有了丰富的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AI/AR 眼镜、AI 戒指等始终在线（Always-on）的轻量化空间计算设备，AI PC、AI 手机、智慧汽车、机器人等高效率端侧计算设备，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。公司的芯片设计平台可以极大地帮助客户降低设计风险和加快产品上市时间。以芯原的高性能 SoC 平台和超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台为例：

高性能 SoC 平台：该平台基于高性能总线架构和全新的先进内存方案（终极内存/缓存技术），为高性能计算、笔记本电脑、平板电脑、移动计算、自动驾驶等提供一个全新的实现高性能、高效率 and 低功耗的计算平台，并可显著地降低系统总体成本。公司设计的该处理器的样片，从定义到流片只用了约 12 个月的时间，回片的当天就顺利点亮，相关的操作系统、应用软件都在这个平台上快速得到了顺利运行。这个项目不仅对先进内存方案（终极内存/缓存技术）成功进行了首次验证，还充分证明了公司拥有设计国际领先的高端应用处理器芯片的能力，帮助公司顺利拓展了

平板电脑、笔记本电脑、服务器、自动驾驶等业务市场。

超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台：该平台采用灵活可配置的定制架构，支持多种摄像头、输出接口及可选连接方案。针对严苛的可穿戴限制，采用双芯片分布式架构（主处理器与显示处理器解耦）及 HB-PoP 封装。硬件核心包括 22 个独立电源域、无 DDR 运行、支持语音/视频唤醒的多级待机系统，极致降低功耗与发热。外围提供专用 Micro LED 驱动 ASIC 和视频处理 ASIC 等。目前基于谷歌 Gemma3-270M 轻量模型进行端侧 AI 优化，可全面支撑始终在线、超低能耗和超轻量应用（如 AI 眼镜、AI 玩具、AI 戒指）的芯片定制与量产。

此外，公司还正在面向 AIGC 和智慧出行领域推进 Chiplet 平台解决方案的研发和产业化工作。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

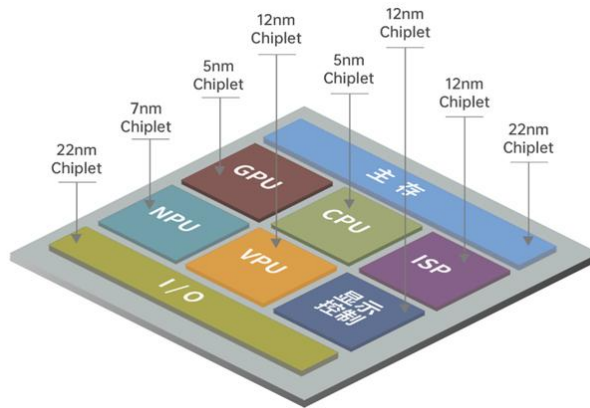
1) FinFET 和 FD-SOI 工艺技术并行，共同推动集成电路升级发展

近年来，为继续延续摩尔定律的演进，两种集成电路新工艺节点技术的诞生打破了技术瓶颈，分别是 FinFET 和 FD-SOI。FinFET 和 FD-SOI 两种技术都是晶体管进一步缩小所需要发展的核心手段。

2001 年，加州大学伯克利分校的 Chenming Hu 教授，Ts-Jae King-Liu 和 Jeffrey Brokor 提出了 FinFET 和 FD-SOI 两种解决方案，以将 CMOS 工艺技术扩展到 20nm 以下。其中 FinFET 采用 3D 架构，可大幅改善电路控制并减少漏电流，以及大幅缩短晶体管的栅长。FD-SOI 具有超薄的全耗尽通道，以实现更好的栅极控制，但其顶层硅厚度均匀性必须保证在几个原子层内。FinFET 和 FD-SOI 都是关键的先进工艺技术。FinFET 具有高计算性能的特点，适用于服务器、电脑、大规模计算等需要长时间保持较高计算性能的应用；FD-SOI 具有低功耗、低成本和可集成射频和存储的优势，适用于物联网、通信、传感器、自动驾驶等待机时间较长，偶尔需要高性能计算，但更多地强调低功耗和高集成的应用。目前 FinFET 技术在智能手机、平板电脑、高性能计算等领域已经获得了广泛的采用；而 FD-SOI 技术则在图像传感器、图像信号处理器和众多物联网相关领域拓开了市场空间。博世的汽车毫米波雷达，亚马逊的家用监控摄像头，索尼的相机摄像头，瑞萨和意法半导体的 MCU 等均已采用了 FD-SOI 技术。

2) Chiplet 技术助力高性能计算，将在 AIGC 和智慧出行领域率先落地

Chiplet（芯粒）是一种可平衡大规模集成电路的计算性能与成本，提高设计灵活度，且提升 IP 模块经济性和复用性的技术之一。Chiplet 实现原理如同搭积木一样，把一些预先在工艺线上生产好的实现特定功能的芯片裸片，通过先进的封装技术（如 2.5D、3D 封装技术等）集成封装在一起，从而形成一个系统芯片。



图：基于 Chiplet 异构架构的应用处理器示意图

Chiplet 在继承了 SoC 的 IP 可复用特点的基础上，更进一步开启了 IP 的新型复用模式，即硅片级别的 IP 复用。不同功能的 IP，如 CPU、存储器、模拟接口等，可灵活选择不同的生产工艺分别进行生产，从而可以灵活平衡计算性能与成本，实现功能模块的最优配置而不必受限于晶圆厂工艺。基于 Chiplet 模式的芯片设计具备开发周期短、设计灵活性强、设计成本低等特点；可将不同工艺节点、材质、功能、供应商的具有特定功能的商业化裸片集中封装，以解决 7nm、5nm 及以下工艺节点中性能与成本的平衡，有效缩短芯片的设计时间和降低风险，并提高供应链管理的灵活度。Chiplet 的发展演进为 IP 供应商，尤其是具有芯片设计能力的 IP 供应商，拓展了商业灵活性和发展空间。

Chiplet 主要适用于大规模计算和异构计算。以 AMD、英特尔、台积电等为代表的多家集成电路领导厂商已先后发布了相关 Chiplet 解决方案、接口协议或封装技术。2022 年 3 月 2 日，英特尔、AMD、ARM、高通、台积电、三星、日月光、Google 云、Meta（Facebook）、微软这十家行业领导企业共同成立了 Chiplet 标准联盟，正式推出了通用 Chiplet 的高速互联标准，芯原已经成为大陆首批加入 UCIE 联盟的企业之一。

Chiplet 将在 AIGC 和自动驾驶领域率先获得应用，主要由于该技术可解决 AIGC 和智慧出行领域现阶段所面临的主要痛点。

对于 AIGC 应用来说，云侧（如服务器）的训练和推理，以及端侧（如手机、汽车、物联网设备）的微调和推理，对算力的需求均正在快速增长。一方面，目前满足云端训练需求的大算力单芯片，因成本、良率、设计资源和供应等因素，必须拆分成算力相对较低的 Chiplet 模块，再通过先进封装集成为大算力芯片，以及进行后续迭代；另一方面，端侧对算力的要求较为多样化，比如汽车、智能手表等不同端侧会因为产品形态和应用场景不同，对算力的需求不尽相同，因此 Chiplet 架构的芯片更能灵活满足 AIGC 类应用的实际需求。

目前，新能源汽车正在全球范围内快速发展，其带来的先进 ADAS 和自动驾驶技术需求，使得汽车芯片在汽车中的价值和价格比重均日益增加。高端智驾芯片面临设计周期长、单芯片（大

芯片）良率较低、生产受限以及算力扩展困难等挑战，采用 Chiplet 技术可以有效解决这些问题，并已在汽车产业界达成共识，相关技术获得了积极部署。例如，2025 年 1 月，瑞萨电子与本田签署协议，利用 Chiplet 技术共同开发面向软件定义汽车的高性能 SoC，目标 AI 性能达 2000TOPS。2025 年 12 月，imec 与日本 ASRA 宣布战略合作，协调汽车 Chiplet 架构的标准化，计划于 2026 年中期发布统一的规范文档。2026 年 1 月，由博世牵头的欧洲 CHASSIS 项目正式启动，集结了宝马、雷诺、英飞凌、恩智浦、Tenstorrent 等 18 家产业巨头及研究机构，旨在建立开放的汽车 Chiplet 平台。2026 年 2 月，中国《芯粒测试规范》系列国家标准发布等。

3) 开放的 RISC-V 促进集成电路产业的繁荣与创新

RISC-V 是一个免费、开放的指令集架构，是加州大学伯克利分校图灵奖得主 David Patterson 教授及其课题组，历经三十多年研发的第五代基于 RISC 的 CPU 指令集架构。2015 年，加州伯克利大学将 RISC-V 指令集架构开源，并成立由工业界和学术界成员组成的非营利组织 RISC-V 国际基金会，来指导 RISC-V 的发展方向以及促进其在不同行业的应用。目前，RISC-V 国际基金会已经有来自 70 多个国家的 4500 多家会员，这些会员包括谷歌、英特尔、西部数据、IBM、英伟达、华为、高通、三星、腾讯等国际领军企业，以及加州大学伯克利分校、麻省理工学院、中科院计算所等顶尖学术机构。

RISC-V 的出现极大地促进了芯片设计的灵活性和商业模式的自由度。全球已有大量的芯片设计公司采用了 RISC-V 指令集进行芯片设计，如西部数据、英伟达、英特尔、兆易创新、全志科技等，这些芯片被广泛应用到消费电子、工业控制、自动驾驶、人工智能、通信、数据中心等领域。谷歌已公开表示，将把 RISC-V 架构作为 Android 操作系统的主要硬件平台，进行深度支持。

而在 AI 领域，RISC-V 已构建起从向量到矩阵的完整 AI 加速指令集体系：向量扩展（RVV 1.0）作为 AI 计算的底层支柱已获主流编译器广泛支持；面向矩阵运算，RISC-V 国际基金会正推进 IME（Integrated Matrix Extension）、VME（Vector Matrix Extension）、AME（Attached Matrix Extension）三类矩阵扩展方案的标准化。

2018 年 9 月，由上海集成电路行业协会推荐芯原股份作为首任理事长单位牵头成立了中国 RISC-V 产业联盟（CRVIC），截至 2026 年 6 月底，会员单位已达到 205 家。2024 年，芯原联合芯来科技、达摩院共同发起成立了民办非企业单位——上海开放处理器产业创新中心（SOPIC），该中心专注于推动处理器技术，特别是基于开放指令集架构（如 RISC-V）的研发、生态建设和产业化应用。

由中国 RISC-V 产业联盟和芯原共同主办的滴水湖中国 RISC-V 产业论坛已经成功召开了 4 届，每届会议集中发布 10 余款国产 RISC-V 芯片新品，现已累计推广了 40 多款，量产率达 90%，被广泛应用于消费电子、智能家居、可穿戴设备、通信、汽车、工业控制等多个领域。由上海开放处理器产业创新中心在上海主办的第五届“RISC-V 中国峰会”规模盛大，包括 1 场主论坛、9

场垂直领域分论坛、5 场研习会、11 项同期活动，以及 4500 平方米未来科技展览区，汇聚来自 17 个国家的数百家企业、研究机构及开源技术社区参会。主论坛当日共计 3000 余人线下参会，12.5 万人次线上观看论坛直播；当日媒体原创报道达 200 余篇，会后媒体原创报道总数达 425 篇；参会总人次为 8188 人。该中心还联合清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、西安交通大学、同济大学、山东大学、华东师范大学、电子科技大学、上海大学和上海科技大学这 12 所高校，历时半年精心编撰和发布了《RISC-V 导论：设计与实践》研究生选修课开源课件，助力 RISC-V 专业人才培养。

（2）所属行业在新产业方面近年来的发展情况与未来发展趋势

集成电路产业经过了数十年的发展，在技术上的不断突破带来持续的应用迭代，改变了许多传统行业，亦催生出众多新产业，如 AI PC、AI 手机、AI/AR 眼镜和 AI 戒指等可穿戴设备、AI 玩具、智慧家居、智慧出行，以及其他 AIGC 相关应用等。上述集成电路设计产业新技术的快速发展直接推动了集成电路产品的推陈出新，促成新兴产业的诞生。

1) 云侧与端侧生成式人工智能（AIGC）

人类正在步入数字化社会，所产生的数据呈指数级增长。随着信息技术的高速发展，数据价值挖掘是大势所趋，AIGC 是将这些数据转化成为高价值的重要手段。

2022 年 11 月，OpenAI 推出的聊天机器人 ChatGPT 受到了业界的广泛关注。这类基于 AI 技术的自然语言处理应用成为了 AIGC 技术的重要应用突破口，快速在各行各业取得应用。大算力支撑 AIGC 应用快速发展演进的根基。OpenAI 预估人工智能应用对算力的需求每 3.5 个月翻一倍，每年增长近 10 倍，这极大地提升了 NPU、GPU、GPGPU 和相关高性能计算技术的市场应用空间，并对其性能持续提出更高的要求。

2024 年底，本土大语言模型 DeepSeek 所取得的成就获得了全球的广泛关注。DeepSeek 采用了更优化的硬件使用策略、创新的训练方法、高效的模型压缩技术，充分符合端侧设备对 AI 模型紧凑、高效、易用的需求，将推动 AI 大语言模型在端侧的快速部署。DeepSeek 为发展端侧的“小的大模型”或者“小模型”提供了很好的技术条件：比如，DeepSeek 部署在 AI/AR 眼镜中可以很好地解决用户隐私和安全问题；DeepSeek 部署在汽车中，可以解决智驾系统的时延问题等。

在边缘人工智能终端产品中，以 AI/AR 眼镜、AI 戒指为代表的智慧可穿戴设备被认为是继智能手机之后的下一个十亿级出货量的产品，这类设备可搭载更为自然的人机交互界面和越来越强大的本地 AI 处理能力，创新人们的数字生活和社交。

AI 玩具正快速演进为儿童的“智能成长伙伴”，其核心趋势是从被动娱乐转向主动式个性化教育与情感陪伴。通过整合嵌入式 AI、多模态感知与先进计算技术，玩具能实时理解儿童的情绪状态和学习进度，提供自适应互动与内容，拓展了儿童的成长视野和帮助心智发育。AI 玩具有望逐

步成为个性启蒙和家庭教育不可或缺的刚需产品。

2) 具身智能和智能机器人

具身智能作为人工智能与机器人技术融合的前沿方向，其核心在于赋予智能体感知、行动和与物理世界交互的能力，而智能机器人正是这一理念最关键的产业落地形态。2025 年中国《政府工作报告》首次将具身智能及其关键载体智能机器人纳入未来产业重点发展方向，标志着该领域正式跃升为国家战略。

智能机器人产业正迈入技术突破与规模化商用的关键阶段。据 IDC 预测，2026 年全球智能机器人硬件市场规模将接近 300 亿美元，其中中国将引领全球市场增长，届时中国具身智能机器人市场规模将突破 110 亿美元。另据多家研究机构测算，2026 年中国具身智能整体市场规模预计达到 1.09 万亿元，年均复合增长率约为 22%至 23%，工业机器人仍占据最大份额，人形机器人增速最快。

智能机器人的爆发式增长为集成电路产业带来了显著利好——人形机器人作为具身智能的最高阶载体，其智能化程度越高，对高性能运算芯片与大容量内存的依赖就越深。2026 年人形机器人加速迈入商业量产，据工业和信息化部预测，国内全年整机产量有望突破 10 万台，相比 2025 年约 2 万台的出货量增长近 4 倍。在关键零部件成本结构中，半导体占整机 BOM 成本的 15%至 25%，由 SoC 芯片与内存组成的计算核心占据了超过 65%的半导体价值量。伴随整机成本持续下降与 AI 模型能力不断提升，人形机器人有望成为继手机与服务器之后推动半导体新一轮需求增长的关键终端应用，AI 芯片、高精度运动控制芯片、多模态传感器、功率半导体及高速连接芯片等关键器件需求将全面攀升。

3) 数据中心与高速数据传输

数据已经成为信息化时代中重要的生产要素和社会财富，甚至关乎国家安全。近年来，信息技术产业加速向万物互联、万物感知、万物智能时代演进，海量数据资源集聚增速远超摩尔定律。据 IBS 的报告，2018 年至 2030 年，数据量将成长 1455 倍，这给以数据存储和通信为核心业务的数据中心带来巨大的压力，同时也带来了巨大的市场发展潜力。

随着数据中心对网络通信速度和性能需求的不断提升，高速接口技术也迎来关键发展时期，这其中最为关键的高速 SerDes 接口 IP 已经成为了近年来研究的热点。该接口 IP 实现了高速串行通信链路的升级，提供更多带宽和更高端口密度，提升数据中心效率，为大数据的持续发展奠定了基础。

此外，AI 技术的不断演进促使对高性能计算的需求不断攀升。随着摩尔定律在晶体管微缩上的效益递减，以及以 Chiplet 为代表的相关先进封装技术的崛起，芯片内与芯片间数据通路的带宽和能效瓶颈日益凸显。SerDes 技术通过提供高带宽、降低延迟、提升能效，直接决定了多核、多

Chiplets 和异构计算架构的有效算力总和，是打破现有系统瓶颈、实现更高级别计算的关键使能技术。

4) 超高清视频

随着短视频、直播、移动办公/会议、电竞、云游戏、视频社交等应用的快速发展，以及网络影视剧内容的不断丰富，视频已经成为了重要的信息媒介。在无线通信技术、高速数据传输技术和高清显示技术的发展驱动下，超高清视频显示已经成为了投影仪、电视、电脑、手机等具备多媒体功能的设备的标配。

这类应用既需要优质的视频图像显示效果，也需要兼顾从云到端的带宽资源占用、功耗和时延等问题。上述应用将为支持超高清视频标准的视频编解码、显示处理、音/视频处理等技术开辟出广阔的市场空间。

5) 智慧出行与车联网

汽车行业正经历“电动化、网联化、智能化、无人化”的变革，智能出行时代已经到来。在上述趋势推动下，汽车电子的元件数量和价值量均得到飞速提升。中商产业研究院数据显示，2020 年汽车电子占整车成本比例为 34.32%，至 2030 年有望达到 49.55%，汽车电子行业前景广阔。IC Insights 的数据显示，汽车专用模拟 IC 和汽车专用逻辑 IC 为近年来增长最快的两个 IC 细分领域。随着汽车智能化提高、自动驾驶技术突破以及新能源汽车销量增长，预计每辆汽车的平均半导体器件价格也将提高到 550 美元以上。

车联网（V2X, Vehicle-to-Everything）是未来汽车实现自动驾驶的重要基础，其以车辆为主体，依靠通信网络互连实现车与车（V2V）、车与人（V2P）、车与网（V2N）、车与基础设施（V2I）的互通互联、信息共享，进而达到保障交通安全、提高驾驶体验、拓展智能服务等目标的智慧交通解决方案。C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything，基于蜂窝网络的车联网通信技术）是中国主推的车联网技术标准，也是目前全球车联网的唯一标准。当前我国在车联网方面走在了世界前列，未来我国有望凭借产业链领先优势，引领全球车联网产业发展，抢占 V2X 的全球市场份额。

6) 5G 与 6G 通信

5G 技术开启了物联网万物互联的新时代，已融入人工智能、大数据等多项技术，并成为了推动交通、医疗、制造等传统行业向智能化、无线化等方向变革的重要参与者。高性能、低延时、大容量是 5G 网络的突出特点，这对高性能芯片提出了海量需求，且 5G 在物联网以及消费终端的大量使用，还需要低功耗技术做支撑。目前高性能、低功耗芯片技术正处于快速发展期，5G 市场正在推动集成电路设计行业进入新一波发展高峰。根据中国信通院《5G 经济社会影响白皮书》预测，就中国市场而言，在直接产出方面，按照 2020 年 5G 正式商用算起，当年带动近 5,000 亿元的直接产出，2025 年、2030 年将分别增长至 3.3 万亿元和 6.3 万亿元，十年间的年均复合增长率

为 29%；在间接产出方面，2020 年、2025 年、2030 年，5G 将分别带动 1.2 万亿、6.3 万亿和 10.6 万亿元，年均复合增长率为 24%。

全球产业界已启动 6G 标准化工作，目标是在 2030 年前后实现商用。下一代网络将支持沉浸式体验，并为智慧城市、AI 工业基础设施等提供集成式通信。同时，量子安全通信、更环保的可持续网络也正成为重要的探索前沿。

（3）所属行业在新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

随着集成电路产业的不断发展，集成电路产业链上下游企业在运营模式上，均出现了新的变化，具体体现为半导体产业的三次转移，以及第三次转移带来的“轻设计”趋势。

始于 1960 年代的世界半导体发展至今，共发生三次转移，分别是美国到日本，从日本到韩国、中国台湾，以及从韩国、中国台湾到中国大陆的转移。第三次转移，也即向中国的转移，是在智能手机、移动互联网快速发展的契机下，全球半导体产业从韩国、中国台湾地区向中国大陆转移，而物联网、人工智能、5G、新能源汽车等应用的兴起，进一步促进了该转移。虽然近年来有国际局势、地缘政治等因素的影响，但在中国发展新质生产力的号召下，传统产业的全面数字化转型，5G 的快速部署，电动汽车和新能源产业的快速发展，快速兴起的云上/远程办公、教育、娱乐和社交，以及“人工智能+”和 AIGC 赋能的全面产业升级等，都带动了相关产业的发展。从国家和地方政策、产业基金到科创板，也都充分展示了国家发展半导体产业的意志和决心。

在产业转移的过程中，产业链的分工不断细化。因此集成电路产业正在进行轻设计（Design-Lite）这一运营模式的升级。与之前相对“重设计”的 Fabless 模式不同，在轻设计模式下，芯片设计公司将专注于芯片定义、芯片架构、软件/算法，以及市场营销等，将芯片前端和后端设计，量产管理等全部或部分外包给设计服务公司，以及更多地采用半导体 IP，减少运营支出，实现轻量化运营。在集成电路产业“轻设计”的趋势下，芯片设计公司的设计工作将更加灵活便捷，从而促进集成电路产业的快速发展。

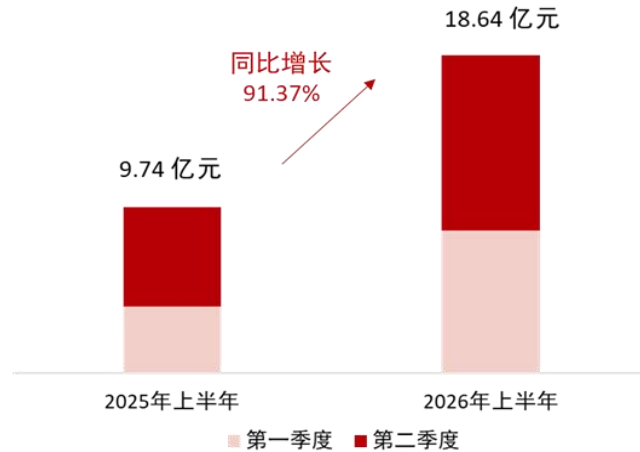
新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

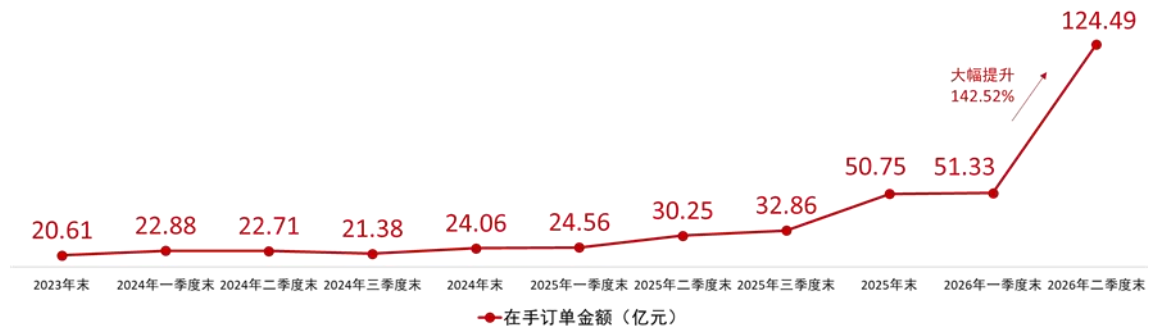
（一）报告期内主要财务表现

公司 2026 上半年实现营业收入 18.64 亿元，同比增长 91.37%。2026 年第二季度实现营业收入 10.28 亿元，较 2025 年第二季度同比增长 75.95%。



图：2026年上半年营业收入同比变化情况

截至2026年6月末，公司在手订单金额达到124.49亿元，较一季度末的51.33亿元大幅提升142.52%，且已连续11个季度保持高位。截至2026年6月末的在手订单中，量产服务业务订单超100亿元，量产服务的规模效应显著，订单的持续转化将为公司未来盈利能力逐步提升奠定坚实基础。截至2026年6月末的在手订单中，超过83%为数据处理应用领域订单且主要来自于AI ASIC。



图：公司近 11 个季度在手订单情况

2026年1月1日至2026年7月16日，公司新签订单合计146.53亿元，其中绝大部分为芯片定制解决方案服务业务订单，具体内容详见公司于2026年7月17日披露的《关于新签订单的自愿性披露公告》（公告编号：2026-040）。2026年1月1日至2026年8月17日，公司新签订单进一步增长至151.42亿元，AI算力相关订单占比90%，数据处理领域订单占比89%。上述订单具备明确转化预期，但收入转化需要一定时间周期。其中，设计服务订单通常需9-12个月设计研发周期，期间逐步实现收入转化；量产服务业务订单受客户产品出货规划、合作晶圆厂产能排期等因素影响，从签约开始通常需6-18个月完整生产交付周期，期间逐步实现收入转化。

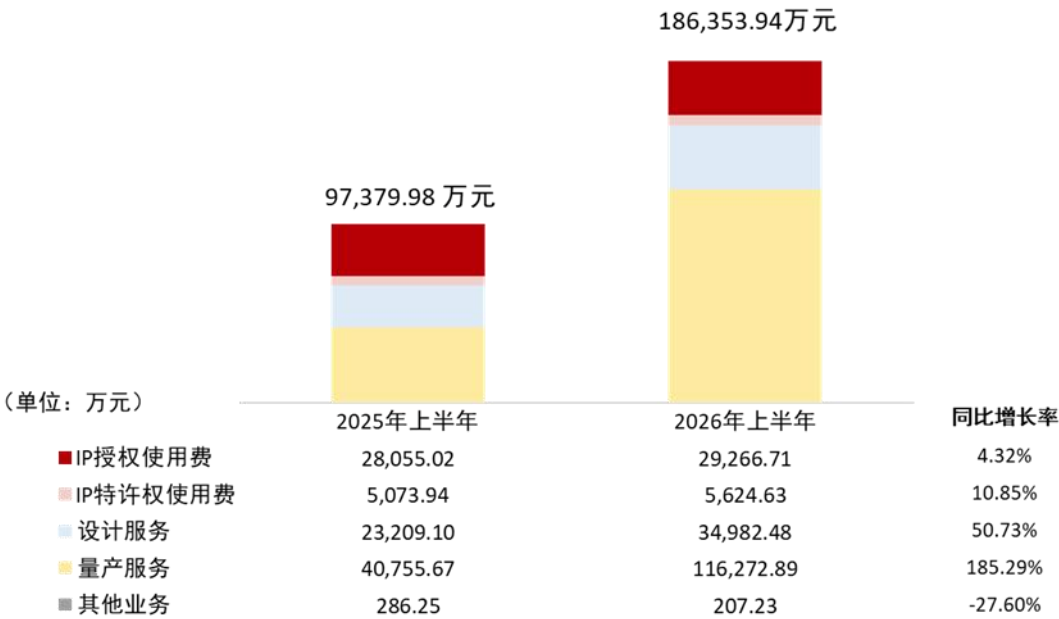
公司自2025年起新签订单爆发式增长，2025年全年新签订单59.60亿元，2026年1月1日至2026年8月17日的新签订单金额已达到2025年全年的254%。依托于业界领先的技术能力与客户认可度，公司新签订单将继续保持良好态势。

2026 年上半年，公司主要财务表现具体情况如下：

1、营业收入情况

（1）业务构成情况分析

公司 2026 年上半年实现营业收入 18.64 亿元，较 2025 年上半年增长 91.37%。具体而言，公司 2026 年上半年量产服务收入同比增长 185.29%，设计服务收入同比增长 50.73%，IP 特许权使用费收入同比增长 10.85%，IP 授权使用费收入同比增长 4.32%。



图：2026年上半年营业收入（按业务划分）构成情况

① 半导体 IP 授权服务

2026 年上半年，公司实现 IP 授权使用费收入 2.93 亿元，同比增长 4.32%；实现 IP 特许权使用费收入 0.56 亿元，同比增长 10.85%。

在芯原的核心处理器 IP 相关营业收入中，图形处理 IP、神经网络处理 IP 和视频处理 IP 收入占比较高，这三类 IP 在 2026 年上半年半导体 IP 授权服务收入（包括 IP 授权使用费收入、IP 特许权使用费收入）中占比合计近 60%，上述 IP 已获得国内外众多知名企业的广泛采用，在各应用领域发挥了重要作用。

- 芯原图形处理（GPU）IP 已经耕耘嵌入式市场超过 20 年，在多个市场领域中获得了客户的采用，包括数据中心、汽车电子、PC、可穿戴设备等，内置芯原 GPU 的芯片已在全球范围内出货超过 20 亿颗。

- 芯原神经网络处理（NPU）IP 已被 91 家客户用于其 140 余款人工智能芯片中，集成了芯原 NPU IP 的人工智能（AI）类芯片已在全球范围内出货约 2.5 亿颗，这些内置芯原 NPU 的芯

片主要应用于智能手机、平板电脑、可穿戴设备、智慧电视、智慧家居、安防监控、物联网、服务器、汽车电子、智慧医疗等 10 余个市场领域，奠定了芯原在人工智能领域全球领先的根基。

● 芯原的 Hantro 视频处理（VPU）IP 已被全球前 20 名云平台解决方案提供商中的 7 家，中国前 5 大互联网提供商中的 3 家，以及 2024 年中国造车新势力 Top 8 榜单中 5 家所采用。

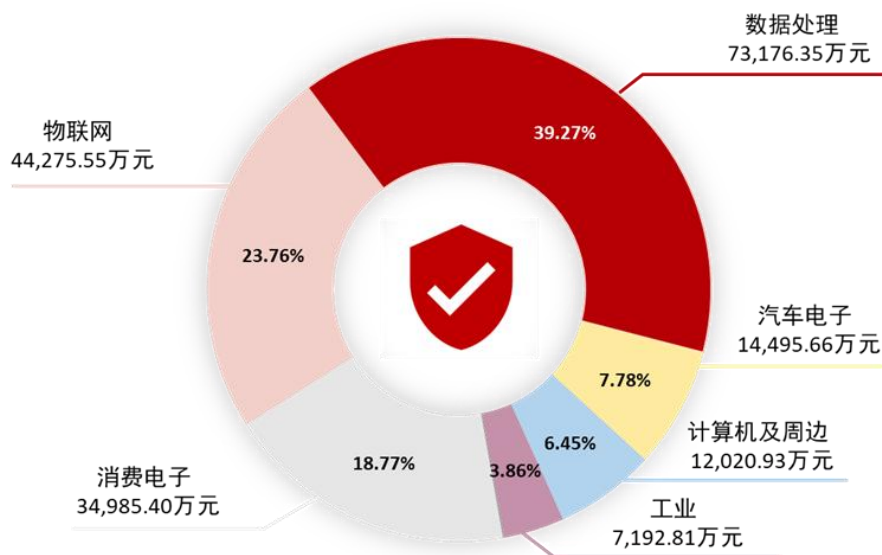
② 芯片定制解决方案服务

2026 年上半年，公司实现设计服务收入 3.50 亿元，同比增长 50.73%；其中 28nm 及以下工艺节点收入占比 96.42%，14nm 及以下工艺节点收入占比 61.94%，7nm 及以下工艺节点收入占比 36.49%。截至报告期末，公司在执行芯片设计项目 96 个，其中 28nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 62.50%，14nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 32.29%，7nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 22.92%。报告期内，公司与 AI 算力相关的设计服务收入为 1.44 亿元，占比超 41%。

2026 年上半年，公司实现量产服务收入 11.63 亿元，同比大幅增长 185.29%。报告期内，为公司贡献营业收入的量产出货芯片数量 109 款，另有 59 个现有芯片设计项目待量产。截至报告期末，公司量产服务在手订单超 100 亿元，量产服务的规模效应显著，订单的持续转化将为公司未来盈利能力逐步提升奠定坚实基础。

（2）下游应用领域分析

报告期内，公司数据处理领域实现营业收入 7.32 亿元，同比大幅提升 292.17%，该领域收入占营业收入比重为 39.27%，同比提升 20.11 个百分点。除数据处理领域外，报告期内公司物联网、消费电子领域分别实现营业收入 4.43 亿元、3.50 亿元，占营业收入比重分别为 23.76%、18.77%。



图：2026 年上半年营业收入（按下游不同行业划分）构成情况

（3）按地区构成分析

2026 年上半年，公司实现境内销售收入 13.03 亿元，同比提升 126.19%，占营业收入比重为 69.93%，较去年同期增加 10.77 个百分点；公司境外市场逐步复苏，实现境外销售收入 5.60 亿元，同比提升 40.91%，占营业收入比重为 30.07%。

（4）客户群体及数量分析

随着公司提供硬件和软件完整系统解决方案的能力不断提升，迎合了系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企等客户群体的需求，2026 年上半年来自上述客户群体的收入达到 5.55 亿元，占总收入比重约三成。

2026 年上半年，公司半导体 IP 授权服务新增客户数量 13 家，截至报告期末累计半导体 IP 授权服务客户总数量近 480 家；芯片定制解决方案服务新增客户数量 16 家，截至报告期末累计芯片定制解决方案服务客户总数量 365 家。

（5）新签订单及在手订单情况

截至2026年6月末，公司在手订单金额达到124.49亿元，较一季度末的51.33亿元大幅提升142.52%，且已连续11个季度保持高位。截至2026年6月末的在手订单中，量产服务业务订单超100亿元，量产服务的规模效应显著，订单的持续转化将为公司未来盈利能力逐步提升奠定坚实基础。截至2026年6月末的在手订单中，超过83%为数据处理应用领域订单且主要来自于AI ASIC。

2026年1月1日至2026年7月16日，公司新签订单合计146.53亿元，其中绝大部分为芯片定制解决方案服务业务订单，具体内容详见公司于2026年7月17日披露的《关于新签订单的自愿性披露公告》（公告编号：2026-040）。2026年1月1日至2026年8月17日，公司新签订单进一步增长至151.42亿元，AI算力相关订单占比90%，数据处理领域订单占比89%。上述订单具备明确转化预期，但收入转化需要一定时间周期。其中，设计服务订单通常需9-12个月设计研发周期，期间逐步实现收入转化；量产服务业务订单受客户产品出货规划、合作晶圆厂产能排期等因素影响，从签约开始通常需6-18个月完整生产交付周期，期间逐步实现收入转化。

公司自2025年起新签订单爆发式增长，2025年全年新签订单59.60亿元，2026年1月1日至2026年8月17日的新签订单金额已达到2025年全年的254%。依托于业界领先的技术能力与客户认可度，公司新签订单将继续保持良好态势。

2、盈利分析

（1）毛利及利润情况

2026 年上半年，公司实现综合毛利额（即毛利）5.84 亿元，同比提升 38.44%。公司 2026 年上半年综合毛利率 31.34%，较去年同期下降 11.98 个百分点，主要由于收入结构变化等因素导致。基于公司独特的商业模式，公司在提供芯片定制解决方案服务过程中，依托于公司拥有的 SoC 设计及验证、系统硬件设计、软件架构及开发、系统测试、项目管理等全流程人才储备，前期为客

户提供芯片设计服务，后期根据协议约定完成量产服务。在量产服务中，公司仅需以相对固定的量产管理团队支持日益增长的量产项目，无需随量产服务规模增长线性扩充人员，体现出公司可规模化商业模式特性。因此，综合毛利率并非评估公司盈利能力的唯一指标，虽然公司量产服务毛利率相对半导体 IP 授权服务较低，但量产服务产生的毛利大部分可贡献于净利润。

2026 年上半年，公司经调整后归属于上市公司股东的净利润为-4.23 亿元；公司经调整后 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）为-2.22 亿元。

（2）未来盈利展望

公司主营业务具备显著的规模效应与经营杠杆，收入规模的持续扩张可有效转化为盈利增量，带动公司盈利能力稳步提升。同时，公司依托成熟的研发团队与研发资源储备，持续加大 AI 研发工具投入，积极推动 AI 技术在研发全流程中的应用赋能，进一步提升研发产出效能，伴随订单转化节奏加快，研发资源可高效向客户项目倾斜，为业务规模扩张与盈利水平提升提供支撑。随着公司新签订单不断增长并持续转化为营业收入，公司独特商业模式下的规模效应与经营杠杆将逐步得以体现：

① 研发费用占收入比重合理下降

公司始终秉持“轻资产、高研发”的发展战略，坚持高研发投入以打造竞争壁垒，保证公司在半导体 IP 和芯片定制领域具有领先的芯片设计和技术研发实力。公司量产服务业务具备突出的规模化效应，量产服务仅需相对稳定的量产服务团队即可支撑不断扩大的业务体量，该业务产生的毛利绝大部分可直接转化为净利润；伴随量产服务业务订单持续落地、业务规模快速扩张，公司收入增速将高于研发费用增速，带动研发费用占收入比重呈合理下降态势：2026 年上半年较 2025 年上半年，经调整（非经营性或非现金性费用除外，下同）后研发费用占收入比重同比下降约 20 个百分点，预计 2026 年下半年较 2026 年上半年环比、2026 年全年较 2025 年全年同比，经调整后研发费用占收入比重都将保持下降趋势。该指标下滑并非缩减研发投入，而是业务规模放量带来的结果。

② 研发费用占毛利比重合理下降

公司持续多年对半导体 IP 技术进行布局 and 研发，在这个过程中，相关的研发成本通常被费用化。随着高毛利率的半导体 IP 授权业务、可规模化量产服务业务持续放量，公司毛利将同步提升，毛利增速将高于研发费用增速，公司经调整后研发费用占毛利比重正在合理下降：2026 年上半年较 2025 年上半年，经调整后研发费用占毛利比重同比下降约 9 个百分点；预计 2026 年下半年较 2026 年上半年环比、2026 年全年较 2025 年全年同比，经调整后研发费用占毛利比重都将保持下降趋势，充分印证公司盈利转化效率持续改善。

③ 未来盈利展望

随着公司独特商业模式下的规模效应与经营杠杆将逐步体现，公司盈利能力预计将稳步提升：公司预计 2026 年下半年实现经调整（非经营性或非现金性费用除外）后 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）转正，2027 年实现全年经调整（非经营性或非现金性费用除外）后归属于上市公司股东的净利润转正。

上述经营目标是公司基于所属行业、公司的发展现状及趋势所做出的判断，可能受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多重因素影响，请广大投资者理性投资，注意风险。

（二）报告期内经营管理主要工作

1、深入推进国际化战略，积极筹划 H 股发行上市

为满足公司业务发展的需要，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，深入推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司资本实力，公司拟发行境外上市股份 H 股股票并在香港联交所上市（以下简称“H 股发行上市”）。通过 H 股发行上市，公司将进一步拓宽融资渠道、提升综合融资能力，为公司统筹推进国内产业并购整合、海外优质资产并购及稳步落地全球化战略布局提供坚实的资本平台支撑。

报告期内，公司于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第九次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了 H 股发行上市全套配套议案。2026 年 4 月 1 日，公司正式向香港联交所递交 H 股发行上市申请，并在香港联交所网站刊登 H 股发行上市的应用资料。

本次 H 股发行上市是公司构建 A+H 双资本平台的重要举措，有利于拓宽国际化融资渠道，增强长期资本实力。通过 H 股发行上市，公司将进一步完善公司治理结构，借鉴境外资本市场成熟的监管经验与治理理念，提升公司规范化运营水平与信息披露质量，增强公司在资本市场的核心竞争力与投资价值，实现公司股东利益最大化，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础。公司将依据法律法规相关规定，根据 H 股发行上市的后继进展情况及时履行信息披露义务。

2、联合共同投资人收购逐点半导体，高效完成资源整合并交割

2025 年度，公司联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿进行投资，并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体的控制权。逐点半导体于 2004 年在张江成立，专注于移动设备视觉处理芯片、视频转码芯片和 3LCD 投影仪主控芯片及实施方案的开发和设计，是全球先进的创新视频、显示处理芯片和解决方案提供商。作为智能手机 AI 独立显示芯片引领者，逐点半导体拥有近 160 项知识产权。

本次收购事项的共同投资人包括：华芯鼎新（北京）股权投资基金（有限合伙）（大基金三期载体之一，其管理人为华芯投资）；上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）（上海三大先母基金之一）；北京屹唐元创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（亦庄国投旗下基金）；上海涵泽创业投资合伙企业（有限合

伙）（即孚腾交大科技策源基金，由上海交通大学和上海国投共同发起设立的直投资基金）。

2026 年 1 月，上述收购事项已完成交割。交割完成后，公司享有天遂芯愿的控制权，天遂芯愿持有逐点半导体 100%股份，逐点半导体纳入公司合并报表范围。本次收购强化公司视觉处理领域技术优势，进一步提升公司在端侧 AI ASIC 市场竞争力；公司将通过分布式渲染与 GPU 的结合，加强在端侧和云侧 AI ASIC 的布局。

3、持续核心技术研发，不断迭代升级

公司在持续优化迭代现有核心技术的基础上，于报告期内进一步就生成式人工智能（AIGC）、数据中心、智驾系统、智慧可穿戴设备、物联网这几个关键应用领域，以及 Chiplet 技术进行深入的技术研发和产业化推进。

（1）云侧 AIGC 和数据中心应用领域

芯原已成为全球领先云服务提供商的可信合作伙伴。根据灼识咨询的最新报告，芯原已为 2025 年全球十大云服务提供商中的七家提供了芯片定制解决方案服务和半导体 IP 授权服务。

公司基于 20 余年 Vivante GPU 的研发经验，所推出的具有自主知识产权的通用图形处理（GPGPU）IP 可以支持大规模通用计算和 AIGC 相关应用，现已被客户采用部署至各类高性能 AI 芯片中，面向数据中心、高性能计算等应用领域。通过将自有的 GPU 和 NPU 技术进行流水线级的深度融合，该 IP 可灵活支持图形渲染、通用计算以及 AI 处理，为数据中心、云游戏、边缘服务器、AIGC 相关应用提供大算力通用处理平台，并利用统一的软件接口和一体化的编译器，让用户可以使用标准编程接口来驱动不同的硬件处理单元。目前，芯原的 GPGPU IP 在全球范围内已进行了多次架构授权，在众多高性能计算产品中获得应用。

芯原的视频转码加速解决方案已获得中国前 5 名互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 名云服务提供商中的 7 家的采用。这其中，第一代视频转码平台已于 2021 年第二季度完成研发，并以 IP 授权、芯片定制等方式获得多家客户的采用并量产出货。第二代平台芯片定制项目已完成交付，平台在上一代基础上实现了技术全面升级：支持包括 AV1 在内的多格式 8K 视频转码，集成 AI 处理能力，搭载高性能多核 RISC-V CPU 与硬件加密引擎，现已成功导入国际领先芯片客户并实现量产。第三代平台已进入研发阶段，该平台定位为高性能异构计算平台，以高性能、低功耗、多场景适配为设计核心，深度融合 AI 加速、视频处理与实时控制能力，并集成 CPU、DSP、VPU、NPU、硬件加密模块及安全启动等多核心子系统，全面支撑 AI 推理、视频转码与边缘计算等复杂业务场景，同时还通过精细化电源管理及多电源域控制设计，显著优化系统能效表现。

芯原还正在进行基于 Chiplet 架构、面向 AIGC 应用的高性能计算芯片项目的研发。

（2）端侧 AIGC 应用领域

芯原全球领先的 NPU IP 已在 91 家客户的 140 余款芯片中获得采用，覆盖服务器、汽车、平

板电脑、智能手机、智能家居、可穿戴设备等 10 余个市场领域。目前集成了芯原 NPU IP 的 AI 类芯片已出货约 2.5 亿颗。芯原最新一代 NPU 架构针对 Transformer 类模型进行了优化，既能高效运行 Qwen、LLAMA 类的大语言模型，也能支撑 Stable Diffusion、MiniCPM 等 AIGC 和多模态模型。目前，芯原超低能耗 NPU 已可为移动端大语言模型推理提供超 40 TOPS 算力，并已在知名企业的手机和平板电脑中量产出货。芯原的 NPU 还与自有的众多处理器 IP 深度集成，形成包括 AI-ISP、AI-Display、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案。基于其可编程、可扩展特性，以及自有的创新 NeuroBrick 片上硬件加速解决方案，芯原的 NPU IP 还可针对不同应用场景极大优化客户芯片的 PPA 特性。目前，芯原的 AI-ISP 芯片定制方案（芯原提供架构设计、软硬协同设计和量产支持）已在知名企业的智能手机中量产出货。

公司基于第五代经硅验证的 DSP 架构的 ZSP5000 系列 IP，采用高可扩展性和低功耗的设计，针对计算机视觉、嵌入式人工智能等计算密集型应用进行了深度优化，结合架构的可配置能力，可为各类边缘设备提供兼具能效优势和计算效率的优秀解决方案。

针对 AIGC 产业所面临的安全性和隐私性等问题，芯原还与谷歌合作以支持其新推出的开源项目 Open Se Cura。该项目是一个由设计工具和 IP 库组成的开源框架，旨在加速安全、可扩展、透明和高效的人工智能系统的发展。作为该项目基础设施的一部分，芯原开发了多款面向特定应用的平台级解决方案，支持超低能耗空间计算，并提供优质、高效的 AIGC 输入（Token）。此外，芯原与谷歌基于该 Open Se Cura 开源项目合作基础，还共同打造了面向端侧大语言模型应用、基于 RISC-V 指令集的超低能耗 Coral NPU IP，这其中，谷歌提供开源技术，芯原提供企业级 IP、芯片设计及量产服务，为 AI 眼镜和 AI 戒指等可穿戴设备，以及 AI 玩具等提供“始终在线、超低能耗、超轻量”的端侧 AI 解决方案。

以智能可穿戴应用领域为例，芯原从数年前就开始与该领域领先的企业合作，利用自身低功耗技术方面的优势，积极布局蓝牙耳机、智能手表/手环和 AI/AR 眼镜，并已在芯片和终端产品中验证了芯原面向低能耗应用所打造的 nano 和 pico 系列低功耗 IP 组合。报告期内，公司推出了超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台，该平台采用灵活可配置的定制架构，支持多种摄像头、输出接口及可选连接方案；针对严苛的可穿戴限制，采用双芯片分布式架构（主处理器与显示处理器解耦）及 HB-PoP 封装；硬件核心包括 22 个独立电源域、无 DDR 运行、支持语音/视频唤醒的多级待机系统，极致降低功耗与发热；外围提供专用 Micro LED 驱动 ASIC 和视频处理 ASIC 等。公司还基于谷歌 Gemma3-270M 轻量模型进行了端侧 AI 优化，可全面支撑始终在线、超低能耗和超轻量应用的芯片定制与量产。目前，芯原已为某知名国际互联网企业提供 AR 眼镜的芯片一站式定制服务，还有数家全球领先的 AI/AR/VR 眼镜客户正在与芯原进行合作。截至报告期末，已有 20 余家核心智能手表和 MCU 芯片客户采用了芯原的 IP，市面在售的 30 余款主流智能手表和 10 余款 AI 眼镜均采用了芯原的技术。

此外，芯原以自有的低功耗 IP 为核心基础，结合自身的软件和系统平台设计能力，还推出了

一系列从芯片设计到参考应用的一体化可穿戴式健康监测平台级解决方案，可为客户提供含 BLE 协议栈、软件 SDK、算法、智能硬件和应用程序等在内的不同层级的授权和定制设计服务，助力可穿戴设备在大健康领域的广泛应用。

（3）汽车电子领域

公司已耕耘汽车电子领域多年，从座舱到自动驾驶技术均有布局。芯原的 GPU IP 已经在汽车上获得了广泛的应用，包括信息娱乐系统、仪表盘、车身环视、驾驶员状态监控系统、ADAS、自动驾驶汽车等。芯原的 VPU IP 已被 2025 年中国前八大新能源汽车厂商中的五家采用。

芯原的 ISP IP 自 2017 年正式推出以来，研发与车规认证工作同步进行，目前已有多款 ISP IP 通过车规认证，获得汽车客户的广泛采用。截至报告期末，芯原的 ISP/畸变矫正（DeWarp）处理器 IP 已被国内外 20 多家汽车电子客户所采用，已有 20 余款商用汽车集成了芯原的 ISP IP，赋能百万个汽车 ADAS 摄像头。

芯原正在加速各类车规 IP 的认证进程。目前，公司多个型号的 ISP IP，畸变矫正处理 IP，显示处理 IP DC8200-FS，NPU IP VIP9000Nano 和接口 IP MIPI C/D-PHY TX/RX IP 均获得了 ISO 26262 ASIL B 认证。公司其他 IP 也正在逐一通过各类车规认证的进程中。

公司的设计流程已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，可从芯片和 IP 的设计实现、软件开发等方面，为全球客户满足功能安全要求的车载芯片提供一站式定制服务。此外，芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，并基于该流程推出了 ADAS 功能安全方案，完整的自动驾驶软件平台框架，以及车规级高性能自动驾驶 SoC 设计平台。这其中，自动驾驶 SoC 平台衍生自公司高性能 SoC 平台，配备高性能片上网络、CPU/NPU IP 及 ASIL D 级功能安全岛，支持客户产品获得 ISO 26262 车规认证。该平台已应用于 5nm 客户项目并实现量产。下一代平台将采用更先进工艺，通过 PCIe 和 UCIe 接口增强连接性与带宽。

目前，公司正在积极推进智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深入合作。

（4）物联网领域与 FD-SOI 技术

芯原持续优化和丰富自有的物联网无线连接技术平台，尤其是拓展其在 22nm FD-SOI 工艺上的射频类 IP 产品及平台方案布局，包括支持双模蓝牙、低功耗蓝牙 BLE、NB-IoT、多通道 GNSS 及 802.11ah 等物联网连接技术。所有射频 IP 均已获得客户芯片采用，且采用芯原 802.11ah、802.15.4g 和 GNSS 射频 IP 的客户芯片已量产。上述产品被广泛应用于智能家居、智能穿戴、高精度定位等领域。

FD-SOI 技术以其低功耗、高性能、高集成度的优势，在物联网领域获得了广泛应用。公司已深入布局 FD-SOI 技术十余年。截至报告期末，公司在 22/28nm FD-SOI 工艺上开发了 60 多个模

拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等。已累计向 47 个客户授权了 330 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 49 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 40 个项目已经流片。报告期内，公司还基于 FD-SOI 的低功耗技术优势，持续开发针对如 Wi-Fi 6、BLE 6、卫星通信、毫米波雷达和助听器等应用的技术平台。

（5）Chiplet 技术

Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，公司已于五年前开始布局 Chiplet 技术的研发。目前，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制解决方案服务的产业价值，拓展市场空间。

截至报告期末，公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，目前正在推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发项目。目前公司在 Chiplet 领域取得的切实成果包括：已帮助客户设计了基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片，采用了 SiP（System in Package）先进封装技术，将高性能 SoC 和多颗 IPM 内存合封；已帮助客户的 AIGC 芯片设计了 2.5D CoWos 封装；已设计研发了针对 Die to Die 连接的 UCIe 物理层接口，并已顺利完成流片测试，相关技术已被客户采纳用于项目开发；已和 Chiplet 芯片解决方案的行业领导者合作，为其提供包括 GPGPU、NPU 和 VPU 在内的多款芯原自有处理器 IP，帮助其部署基于 Chiplet 架构的高性能人工智能芯片。此外，为了应对先进封装技术可能出现的供应和成本等问题，芯原已针对新一代面板级封装（Panel level package）技术进行了先行设计开发，为接下来的规模量产做好了准备。本土封装厂也正在积极布局该封装技术，芯原将与之携手，共同打造更具成本效益且供应安全的先进封装解决方案。

4、深化客户合作，积极开拓 RISC-V 市场并推动生态发展

报告期内，公司积极开拓 RISC-V 市场，基于芯原的半导体 IP 和芯片定制平台的技术赋能能力，持续提升芯原在相关领域中的地位与价值，并积极推动 RISC-V 产业生态的发展。

芯原已与赛昉科技、嘉楠科技、先楫半导体等多家 RISC-V 领先企业达成合作。截至报告期末，芯原的半导体 IP 已经获得 RISC-V 主要芯片供应商的 14 款芯片所采用；此外，芯原已为 26 家客户的 27 款 RISC-V 芯片提供了芯片定制解决方案服务，上述项目正陆续进入量产。同时，公司还基于 RISC-V 核推出了包含数据中心视频转码、可穿戴健康监测、物联网无线通信、带硬件安全支持的智能传感 SoC 等多个芯片设计平台，以及基于 RISC-V 核的硬件开发板，上述解决方案已获得多个客户的采用，有助于推动 RISC-V 技术的商业化进程。

2018 年 9 月，由上海集成电路行业协会推荐芯原股份作为首任理事长单位牵头成立了中国 RISC-V 产业联盟（CRVIC），截至 2026 年 6 月底，会员单位已达到 205 家。2024 年，芯原联合

芯来科技、达摩院共同发起成立了民办非企业单位——上海开放处理器产业创新中心（SOPIC），该中心专注于推动处理器技术，特别是基于开放指令集架构（如 RISC-V）的研发、生态建设和产业化应用。由中国 RISC-V 产业联盟和芯原共同主办的滴水湖中国 RISC-V 产业论坛已经成功召开了四届，每届会议集中发布 10 余款来自不同本土企业的国产 RISC-V 芯片新品，现已累计推广了 40 多款，量产率达 90%，广泛应用于消费电子、智能家居、可穿戴设备、通信、汽车、工业控制等多个领域。芯原还连续 4 年举办了基于 RISC-V 技术的“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛。大赛每年吸引来自 40 多所国内高校、累计 650 多支队伍参赛，为 RISC-V 产业发展起到了很好的人才引导和培养作用。

由上海开放处理器产业创新中心于 2025 年 7 月在上海主办的第五届“RISC-V 中国峰会”规模盛大，包括 1 场主论坛、9 场垂直领域分论坛、5 场研习会、11 项同期活动，以及 4,500 平方米未来科技展览区，汇聚来自 17 个国家的数百家企业、研究机构及开源技术社区参会。主论坛当日共计 3,000 余人线下参会，12.5 万人次线上观看论坛直播；当日媒体原创报道达 200 余篇，会后媒体原创报道总数达 425 篇；参会总人次为 8188 人。该中心还联合清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、西安交通大学、同济大学、山东大学、华东师范大学、电子科技大学、上海大学和上海科技大学这 12 所高校，历时半年精心编撰和发布了《RISC-V 导论：设计与实践》研究生选修课开源课件，助力 RISC-V 专业人才培养。

非企业会计准则财务指标变动情况分析 & 展望

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

（一）核心竞争力分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、丰富的核心半导体 IP 积累，领先的芯片设计能力

芯原的主营业务为提供半导体 IP 授权服务和芯片定制解决方案服务。通过 20 余年的高研发投入和深度积累，公司已经在半导体 IP 和芯片定制领域形成了丰富的技术池和服务经验。

公司拥有丰富的核心半导体 IP 积累，包括 GPU IP、NPU IP、VPU IP、DSP IP、ISP IP、Display Processing IP 这六类处理器 IP，以及 1,700 多个数模混合 IP、射频 IP 和接口 IP。这其中，针对广泛的物联网连接应用领域，公司在 22/28nm FD-SOI 工艺上开发了 60 多个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等；已累计向 47 个客户授权了 330 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 49 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 40 个项目已经

流片。同时，利用现有设计平台和已有项目经验，公司可根据客户需求对数模混合 IP 进行定制，并针对具体应用场景进行架构和设计的深度优化，实现客户产品的差异化定制。

芯原开发了 FLEXA 同步接口通信技术，用以高效地连接多个 IP。FLEXA 接口允许 IP 之间进行低延时、无 DDR 的数据交换，这使得芯原能够基于自有 IP 打造高效协作的 IP 子系统，实现低功耗和高性能的混合计算，以及无需 DRAM 的无 DDR 系统。目前，公司已推出包括 AI-ISP、AI-Display、AI-DSP 在内的众多 AI 加速子系统解决方案，并迅速推向市场，进一步强化了公司核心技术的市场竞争力。这其中，AI-ISP 方案已经在国内知名手机企业的旗舰机中实现量产。

根据灼识咨询的最新报告，在芯原的 IP 业务方面，截至 2025 年底，公司拥有全球最多的半导体 IP 类别，IP 总收入位列中国大陆第一、全球第八，IP 授权收入排名全球第六，且在主要专注于数字 IP 的供应商中排名全球第二。IP 授权使用费收入的全球排名高于 IP 整体收入的全球排名，反映了公司的 IP 整体业务具有很好的成长性——随着后续客户产品的逐步量产，公司将进一步获得 IP 特许权使用费收入，IP 授权业务的规模效应将进一步扩大。而拥有较为齐备的 IP 组合和较多的 IP 数量，使得芯原在产品功能和应用领域的多样性上具有了更多的扩展空间、亦给予客户较为全面的选择，体现了公司在技术上的实力、积累和可靠性。同时，由于各类 IP 均来源于公司自主研发的核心技术，且在研发时考虑了各 IP 间的内生关联和兼容性，使得其具有较强的耦合深度、可控性和可塑性。

根据灼识咨询的最新报告，在定制芯片解决方案方面，芯原是全球第四大全栈式服务商，同时在中国大陆高居榜首。2020 年，公司在科创板上市时，曾被誉为“中国半导体 IP 第一股”；随着公司业务在 AI 芯片定制领域获得快速增长，目前公司已被业界誉为“AI ASIC 龙头企业”。公司具有领先的芯片设计能力，拥有从先进的 4nm FinFET 到传统的 250nm CMOS 工艺节点芯片的设计能力。在先进半导体工艺节点方面，公司已拥有 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm/4nm FinFET 和 28nm/22nm FD-SOI 工艺节点芯片的成功流片经验，目前已实现多个 5nm SoC 项目一次流片成功并量产，4nm SoC 项目已成功流片，多个 5nm/4nm 一站式服务项目正在执行。保持多种主流技术路线共同发展，有助于公司根据不同工艺节点和不同技术路线的特点，帮助客户采用能满足其应用场景和特定需求，并能在功耗、尺寸、性能、成本等各方面指标达到平衡的最优方案。

此外，芯原的芯片设计流程也已获得 ISO 26262 汽车功能安全管理体系认证，通过这个认证将加速公司在电动汽车和智能汽车领域的战略布局。芯原还推出了功能安全（FuSa）SoC 平台的总体设计流程，并基于该流程推出了 ADAS 功能安全方案，完整的自动驾驶软件平台框架，以及车规级自动驾驶 SoC 平台。基于上述技术布局，芯原正在与一系列汽车领域的关键客户进行深度合作，以在智慧出行领域取得更好的发展机会。

基于公司丰富的 IP 积累、领先的芯片设计能力和项目实践经验，公司已针对不同终端应用，构建了众多可复用的 ASIC 芯片设计平台，包括高性能 SoC 平台、转码 SoC 平台、自动驾驶 SoC

平台、高性能 AIGC 平台、AI 图像信号处理 SoC 平台、超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台、混合信号 ASIC 平台、低功耗 BLE MCU 解决方案、芯健康（VeriHealthi）解决方案等。

2、深度布局 AI ASIC 关键应用领域，已占据有利市场地位

公司根据自身的技术、资源、客户积累，并结合市场发展趋势，已逐步在云侧 AIGC 与数据中心、端侧 AIGC 应用、汽车电子、物联网与 FD-SOI 技术这四个领域深度布局，形成了一系列优秀的平台化解决方案，并取得突出业绩和占据有利市场地位，被业界誉为“AI ASIC”龙头企业。

①云侧 AIGC 与数据中心：深化高性能 IP 布局与异构计算平台迭代

公司持续深耕数据中心与高性能计算应用，报告期内已为 2025 年全球十大云服务提供商中的七家提供芯片定制与半导体 IP 授权服务。

公司基于长期积累的 GPU 研发技术，推出具备自主知识产权的 GPGPU IP，通过自有 GPU 与 NPU 技术的流水线级深度融合，全面支持图形渲染、通用计算及 AIGC 处理，目前已在全球范围内实现多次架构授权并导入多款高性能 AI 芯片。

在视频转码加速领域，公司方案已获中国前 5 大互联网企业中的 3 家，以及全球前 20 大云服务商中的 7 家采用。其中，支持 8K 多格式转码及 AI 处理的第二代平台已完成量产交付；第三代高性能异构计算平台已进入研发阶段，全面集成 CPU、NPU 等核心子系统以支撑复杂边缘计算场景。此外，公司正稳步推进基于 Chiplet 架构、面向 AIGC 应用的高性能计算芯片项目研发。

②端侧 AIGC 应用：加速 NPU 产业化与可穿戴生态赋能

公司在全球范围内稳步推进 NPU IP 的产业化落地。截至报告期末，NPU IP 已在 91 家客户的 140 余款芯片中获准采用，累计赋能约 2.5 亿颗 AI 类芯片出货。最新一代 NPU 架构完成针对 Transformer 类大语言模型及多模态模型的深度优化，在移动端实现超 40 TOPS 的推理算力，并于主流手机及平板终端量产。

在智能可穿戴领域，公司推出采用双芯片分布式架构的超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台，并基于轻量化大模型进行端侧 AI 优化，目前已为国际头部互联网企业提供 AR 眼镜一站式芯片定制服务。报告期内，超 30 款主流智能手表及 10 余款 AI 眼镜均集成了公司技术。此外，公司积极响应 AIGC 产业的安全与隐私诉求，与谷歌就 Open Se Cura 开源项目达成合作，并共同打造基于 RISC-V 指令集的 Coral NPU IP，为端侧设备提供始终在线、超低能耗、超轻量的边缘端 AI 解决方案。

③汽车电子：深化车规级 IP 矩阵与自动驾驶 SoC 平台产业化

公司在汽车电子领域实现从智能座舱到自动驾驶的全面覆盖。报告期内，公司 VPU IP 已被 2025 年中国前八大新能源车企中的五家采用；ISP 及畸变矫正（DeWarp）处理 IP 已集成至 20 余款商用车型，赋能百万级 ADAS 摄像头。在车规安全认证方面，公司多款核心 IP（含 ISP、NPU IP、显示处理 IP、接口 IP 等）已获得 ISO 26262 ASIL B 认证，且整体设计流程已通过 ISO 26262

汽车功能安全管理体系认证。基于此，公司推出配备 ASIL D 级功能安全岛的自动驾驶 SoC 设计平台，该平台已成功应用于 5nm 客户项目并顺利进入量产阶段。目前，公司正依托核心技术优势，与关键汽车客户合作推进智慧出行领域的 Chiplet 平台研发进程。

④物联网与 FD-SOI 技术：巩固低能耗设计壁垒与无线连接方案赋能

公司依托在 FD-SOI 技术领域的长期先发优势，持续优化低能耗、高集成度物联网无线连接解决方案。截至报告期末，公司在 22/28nm FD-SOI 工艺上开发了 60 多个模拟及数模混合 IP，种类涵盖基础 IP、数模转换 IP、接口协议 IP 等。已累计向 47 个客户授权了 330 多个/次 FD-SOI IP 核；并已经为国内外知名客户提供了 49 个 FD-SOI 项目的一站式设计服务，其中 40 个项目已经流片。

公司持续完善物联网无线连接技术平台，基于 22nm FD-SOI 工艺拓展射频 IP 产品线，实现对双模蓝牙、NB-IoT 及 802.11ah 等多项连接协议的支持。目前，所有射频 IP 均已获客户采用，相关芯片已在智能家居与高精度定位等领域实现规模化量产，进一步稳固了公司在物联网底层技术领域的竞争优势。

3、稳步推进 Chiplet 技术和应用，领跑基于 Chiplet 的 AIGC 和智驾系统赛道

Chiplet 技术及产业化是芯原的发展战略之一，公司已于五年前开始布局 Chiplet 技术的研发。目前，公司正在以“IP 芯片化（IP as a Chiplet）”、“芯片平台化（Chiplet as a Platform）”和“平台生态化（Platform as an Ecosystem）”理念为行动指导方针，从接口 IP、Chiplet 芯片架构、先进封装技术、面向 AIGC 和智慧出行的解决方案等方面入手，持续推进公司 Chiplet 技术、项目的发展和产业化，持续提升公司半导体 IP 授权和芯片定制服务的产业价值，拓展市场空间。目前，公司已在基于 Chiplet 的生成式人工智能大数据处理和高端智驾两大赛道实现领跑，正在稳步推进基于 Chiplet 架构、面向智驾系统和 AIGC 高性能计算的芯片平台研发和产业化。

公司在 Chiplet 与先进封装领域已取得多项实质性产业化成果。在芯片定制端，公司成功交付基于 Chiplet 架构的 Chromebook 芯片设计，通过 SiP 技术实现高性能 SoC 与多颗 IPM 内存的异构合封；并顺利完成客户 AIGC 芯片的 2.5D CoWoS 封装设计。在核心 IP 与生态构建端，公司自主研发的面向 Die-to-Die 连接的 UCle 物理层接口 IP 已成功通过流片验证并获客户项目导入；同时，公司向 Chiplet 解决方案的行业头部客户授权 GPGPU、NPU 及 VPU 等多款自有核心处理器 IP，全面赋能其在数据中心、高性能计算及汽车领域的高性能人工智能芯片部署。此外，针对传统先进封装面临的产能受限与成本高昂等行业痛点，公司已针对新一代面板级封装（Panel level package, PLP）技术进行了先行设计开发，正积极协同封装产业链推进 PLP 技术落地。

4、领先的一站式系统级平台化服务能力，满足日益增长的终端客户需求

为更好地满足系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商和车企等终端客户群体对系统级整

体解决方案的需求，芯原已将公司服务范围从硬件拓展至软件。通过为客户提供软件开发平台、面向应用的软件解决方案、软件开发包、定制软件、软件维护与升级等服务，可大幅降低客户的研发周期和风险，帮助客户快速响应市场。软件支持服务可增强公司的议价能力，增加客户的合作粘性，扩大公司服务内容的范围，从而进一步扩大公司的业务发展空间。

通过将公司的半导体 IP、芯片定制服务和软件支持服务等有机结合，芯原可为客户提供一站式系统级平台解决方案，有效满足了系统厂商、互联网公司、云服务提供商和车企因成本、差异化竞争、创新性、掌握核心技术、供应链可控等原因，越来越多地开始内部设计芯片的需求。2026 年上半年，芯原系统级客户（非芯片设计公司）所产生的收入占比约三成。

在与大型互联网企业、云服务提供商等客户的合作中，公司的系统级平台解决方案与客户所提供的服务还可形成较为完整的按应用领域划分的生态系统，有助于为相关市场高效率地打造应用产品，提供更多的创新技术支持，并帮助合作双方搭建更好的技术和服务应用生态。

5、独特的商业模式带来业务之间的紧密协同效应

芯原的芯片定制解决方案服务业务和半导体 IP 授权服务业务之间具有较强的协同效应，有利于公司技术水平和服务能力的持续提升。两项主要业务之间的客户可互相导入，共同促进公司研发成果的价值最大化。

对于客户而言，在芯片定制解决方案服务业务中使用芯原自有 IP，与使用/集成不同第三方 IP 相比，在成本和设计效率等方面更具优势。同时，在为客户定制芯片的过程中，公司不但可收集和了解不同行业应用领域对 IP 各技术指标的需求，从而沉淀和打磨出更符合市场需求的 IP，也会根据客户需求定制新的 IP，从而持续丰富公司的 IP 资源库。

芯原在为客户提供半导体 IP 授权服务的过程中，优质的 IP 和服务逐步受到客户认可。当客户出现新的芯片定制需求时，基于已有合作基础，会优先考虑采用芯原的芯片定制解决方案服务。

6、灵活的业务模式和多元化的客户群体，市场空间广阔

芯原的业务范围包括半导体 IP 授权、IP 定制、IP 平台授权、芯片设计服务、芯片量产服务、软件定制与支持、系统平台定制等。客户可根据自己的需求选择其中一项或者多项服务，这使得芯原的业务模式具有很强的灵活性，可面向集成电路的各类应用领域，广泛服务包含成熟的芯片设计公司和 IDM、新兴的芯片设计公司、系统厂商、大型互联网公司、云服务提供商、车企在内的各种类型的企业。

类别广泛的客户群体，各自耕耘不同的应用领域，给公司带来更多的业务机会和发展空间。除了与领先的芯片公司合作开发先进的技术，帮助系统级企业强化生态建设外，公司还可通过客户合作广泛并深入了解如 AIGC、具身智能与机器人、智慧汽车、下一代消费电子和医疗健康等各种应用领域的前沿技术趋势和市场需求，将有助于公司更好地把握战略发展方向，不断拓展技术

储备、强化业务能力，以提升核心竞争力和保障可持续发展。同时，多样化的业务市场领域还可帮助公司业务降低应用市场波动带来的风险，使公司确保稳健发展，具有更高的抗风险能力，以及更好的市场风向敏锐度。

7、采用晶圆厂和封装厂中立策略，供应链管理灵活且抗风险能力强

芯原对晶圆厂和封装厂中立的设计服务模式使得公司对供应链管理更为灵活，抗风险能力更为突出，这主要表现在：①芯原对晶圆厂和封装厂中立的策略，使得芯原可以和全球所有主流的晶圆厂和封装厂合作，不受限于某一家公司的发展情况；②公司与大多数晶圆厂和封装厂拥有超过 10 年或 15 年的长期合作关系，共同发展，保持了良好的沟通；③在长期合作中，芯原建立了良好的商业信誉，供应商会按历史合作数据预留产能，保障供给；④公司可以通过打包的方式拿到产能，有自己的资源池，通过内部资源再分配，对中小型规模的客户友好；⑤不同生产工艺的产能短缺时间和程度不一样，因芯原客户多样化，可以做一定的调整和平衡。

8、SiPaaS 商业模式具有“逆周期”属性

半导体的发展有正常的波动周期。在产业下行时，芯片设计企业大多采取韬光养晦的策略，积极储备新产品等待产业复苏，但困难时期不便扩张，需要寻求优质的芯片设计服务公司来进行合作以达到储备产品的目的；此外，产业下行时期也是收购半导体 IP 和半导体 IP 公司的良好时机。因此，芯原独特的 SiPaaS 商业模式在半导体产业下行时期也有发展的潜力与机遇。

9、持续的高研发投入打造高竞争壁垒

芯原所处的集成电路设计行业，是集成电路产业的上游行业，相对产业链中其他行业而言，需要更早地进行针对性的布局 and 研发。因此集成电路设计行业呈现投资周期长，研发投入大的行业格局。近几年，全球排名前十的芯片设计公司的研发费用占营业收入比例大多维持在 20%-30%。公司持续多年对半导体 IP 技术及芯片定制技术进行布局 and 研发，近年来研发投入占营业收入的比重一直保持在 30%以上，且报告期内占比高达 87.79%的研发人员中，硕士及以上文凭的研发人员占比达 87.41%。因此，芯原的研发投入和研发能力一直保持在较高水平，以保持其半导体 IP 储备和芯片定制解决方案业务的竞争优势，打造了高竞争壁垒。

10、丰富的人才储备，夯实公司的“软实力”

坚持引进和培养优秀人才是公司生存和发展的关键，也是公司持续提高核心竞争力的基础。

结合长期技术发展战略和现有人才储备情况，在外部人才引进方面，公司不仅通过内部推荐、网络招聘等多种渠道吸纳有经验的优秀人才，也通过每年线上及线下校园招聘会、“芯原杯”全国嵌入式软件开发大赛、“芯原杯”电路设计大赛、与各大重点高校联合开展技术和就业指导讲座及企业开放日，搭建“海南大学-芯原智慧医养创新实验室”“海南大学-芯原医疗电子创新实验室”“浙江大学-芯原智能图形处理器联合研究中心”“芯原股份-天津大学智能音频信息处理技术

联合研究中心”，以及成立东南大学信息科学与工程学院、南京大学电子科学与工程学院、海南大学计算机科学与技术学院、海南大学生物医学工程学院、海南大学信息与通信工程学院、海南大学电子科学与技术学院的校外实习实训或教学基地等多种形式，吸引并招募国内外顶尖高校的毕业生，为公司持续稳定发展夯实人才储备。

在内部人才培养方面，公司持续构建并运行完善高效的培训体系与公开透明的晋升机制，通过线上线下相结合的技术与管理培训、专业技术及技术管理双通道发展等方式，全面提升员工的综合能力；积极营造良好的工作环境，从企业文化、薪酬福利、人才激励等方面增强员工的凝聚力与归属感。

截至 2026 年 6 月末，公司研发人员合计 1,883 人，研发人员的占比为 87.79%，研发人员中硕士及以上学历人员占比达 87.41%。公司中国大陆地区具有十年以上工龄的员工占比为 29.88%，员工平均年龄为 34 岁。依托上述行业及公司特征，公司的研发能力始终保持较高水平，已建成理论知识扎实、研发实力突出、实践经验丰富的研发团队，持续巩固业务竞争优势，构筑高水平竞争壁垒。

公司拥有丰富且优质的人才和技术储备，持续通过校园招聘招收优秀应届毕业生，优化人才梯队结构，为公司长远发展提供坚实保障。

2025 届校园招聘中，共 8,000 人参加了全球统一在线笔试，约 1,300 人进入面试环节，公司最终录用应届毕业生 100 余名，其中硕士毕业于 985、211 院校占比 97%，本硕均毕业于 985、211 院校占比 89%。2026 届校园招聘中，公司共录用 100 余名应届毕业生，硕士毕业于 985、211 院校占比提升至 100%，本硕均毕业于 985、211 院校占比提升至 94%。截至 2026 年 6 月 30 日，近四年入职的应届生累计申请专利 183 项。得益于公司优异的招聘质量和高效的培养体系，近年录用的应届毕业生已完成内部培训，为今年已启动和即将承接的多个芯片重大项目提供了有力的人才支撑。未来随着行业逐步复苏，公司项目数量增加，这批研发人员将在各自岗位上发挥关键作用。

公司高度重视人才发展与雇主品牌建设，已连续五年获评“芯片行业最佳雇主”，体现了公司在行业竞争中的软实力。截至 2026 年 6 月 30 日，公司在前程无忧雇主评选中蝉联“典范雇主”奖项并获评“员工关爱典范”单项大奖，并已连续两年荣获“人力资源管理杰出奖”之“杰出雇主”及“最佳培训实践”双料殊荣，同时连续两年获得“年度大学生喜爱雇主”奖项。此外，公司两次荣获猎聘“上海年度非凡雇主”、牛客“NFuture 大学生最喜爱雇主”和芯雇主“年度雇主”奖项。

得益于公司优秀的企业文化，公司保持较高的人才稳定性。报告期内，芯原中国大陆地区员工主动离职率为 1.8%，显著低于 2026 年中国大陆高科技行业整体平均主动离职率 4.4%（怡安翰威特人力资本调研数据）。

11、积极践行企业社会责任，ESG 成果突出

芯原秉持“合规管制、以人为本、芯火燎原、关爱地球”的 ESG 理念，全面深化企业社会责任践行工作，包括人才选拔、培养和激励，技术创新突破和产业生态赋能等。公司积极响应国家“双碳”战略部署，立足集成电路行业发展特性，携手供应链上下游合作伙伴，将绿色低碳理念深度融入到技术提升中。与此同时，公司还通过主办、协办多个产业高端论坛及专业大赛等形式，积极助力集成电路产业生态建设，深化产教融合，为行业高质量发展注入源源不断的活力。

芯原已连续四年披露企业社会责任报告，并于 2026 年披露 2025 年可持续发展报告。芯原连续五年获得 Wind ESG 评级 A，连续三年荣获中国 IC 风云榜“企业社会责任奖”，荣获毕马威中国 2022 年度 ESG 报告奖，入选“2023 上市公司 ESG 创新实践案例”，并获得“2024 年浦东新区中外企业可持续发展（ESG）产业生态创新大赛优秀案例”和 2024 年浦东新区中外企业可持续发展（ESG）优秀案例”。

12、发挥“桥梁”核心作用，持续扩大集成电路生态影响力

芯原立足半导体 IP、芯片设计服务及芯片设计生态系统的交汇点，三者紧密协同、相互赋能，形成高效闭环，使公司成为连接集成电路上下游的关键枢纽。凭借这一独特定位，芯原已构建覆盖全球主流晶圆厂、封测厂，并贯穿从国际科技巨头到中国各领域领军企业的深度生态合作网络。该网络具备全领域、全范围、全球化特点，构成了公司难以复制的核心竞争壁垒，持续巩固其在产业生态中的影响力与话语权。

在此基础之上，芯原积极牵头/发起并推动产业组织建设，例如牵头成立中国 RISC-V 产业联盟（CRVIC）、上海开放处理器产业创新中心（SOPIC）等关键机构，并以 RISC-V International 金牌会员、OpenHW Group 理事会成员、Chips Alliance 理事会成员、UCIe 联盟贡献者成员等多重身份，深入参与前沿技术演进与行业标准制定。同时，公司通过定期举办包括松山湖中国 IC 创新高峰论坛、滴水湖中国 RISC-V 产业论坛、南渡江智慧医疗与康复产业高峰论坛、FD-SOI 产业论坛、芯原 CEO 论坛在内的一系列高端行业论坛，有效促进行业内芯片企业、应用厂商与投资机构的对接与合作，加速芯片产业化落地与应用创新。这些举措不仅助力公司高效把握技术趋势与市场机遇，也进一步提升了其在全球集成电路生态中的引领地位。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

（三）核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术包括芯片定制技术、软件技术和半导体 IP 技术。其中，芯片定制技术主要包

括架构评估技术、大规模 SoC 验证技术、先进工艺设计技术、符合 ISO 26262 标准要求的设计流程建设；软件技术包括平台化软件开发技术、快速迭代软件开发技术、基于芯原 IP 以及软件开发包的参考应用解决方案、完善通信领域 IP 解决方案的软件技术；半导体 IP 技术主要包括图形处理技术、神经网络处理技术、视频处理技术、数字信号处理技术、图像信号处理技术、显示处理技术、智能像素处理 IP 平台，基于 FLEXA 的 IP 子系统，以及多种物联网连接（射频和基带）技术等。具体情况如下：

（1）芯片定制技术

芯片定制技术包括架构评估技术、大规模 SoC 验证技术、先进工艺设计技术以及一系列定制 ASIC 平台解决方案。

1) 架构评估技术

架构评估主要指在设计的早期，根据产品规格要求定义的应用场景，对设计结构、主要功能模块、IP 性能指标、设计指标进行定性及定量的评估，并以此为基础来定义芯片的架构。

目前芯原基于公司已有的设计经验及平台结构，综合先进的 EDA 工具和其自有功能模块性能模型，结合已有产品的实测数据，早期架构的评估精度较纸面计算已有很大提高；并已经在现有 ASIC 设计服务中利用评估平台，完成了架构设计。该技术避免了由于架构不完善导致的设计返工或过约设计，缩短了设计周期，并将在更多的项目中使用。

2) 大规模 SoC 验证技术

设计验证是芯片设计实现过程中必不可少的一环，对确保设计质量非常重要，也有利于缩短设计周期。大规模 SoC 的设计规模和设计复杂度大幅增加，导致设计验证的难度显著增加，传统的验证方法已经不能满足设计验证的需求。

结合 ASIC 仿真、FPGA 平台、硬件加速仿真器平台等多种验证方法，公司构建的大规模 SoC 验证平台可以支持超过十亿逻辑门，支持应用处理器级别复杂 SoC 的验证，同时支持驱动程序及开发套件（SDK）的早期开发及验证，满足验证完备性和验证周期的要求。

3) 先进工艺设计技术

随着制造工艺的发展，设计流程的复杂度显著增加。针对不同的晶圆厂和工艺节点，需要定义相应的设计流程、设计方法论，并通过实际流片来验证。

公司现有的设计技术既可以支持传统 28nm CMOS 及以上工艺节点，也可以支持先进的 14nm/10nm/7nm/6nm/5nm/4nm FinFET 及 28/22nm FD-SOI 工艺节点的设计和实现；在 22nm FD-SOI 上实现的自适应衬底偏置电压技术，对超低能耗 IoT 应用有显著效果。

4) 符合 ISO 26262 标准要求的设计流程建设

芯原已完成了符合 ISO 26262 标准的设计流程建设，并获得国际独立的第三方检测、检验和认证机构德国莱茵 TÜV 颁发的资格认证。芯原现可按照国际标准，遵循车载芯片的功能安全性设计流程，为客户提供满足各类汽车安全完整性等级的芯片设计服务。该设计流程建设为进一步提升芯原的芯片设计能力、拓展芯原的业务领域打下了良好的基础。

5) 定制 ASIC 平台解决方案

①高性能 SoC 平台

公司的高性能 SoC 平台系基于先进工艺节点开发的系统级芯片架构。该平台高度集成了多核 CPU 及 GPU，以全面支持高性能计算场景需求。

该架构旨在高效管理复杂的异构计算工作负载。其通过协同调配各类处理单元，在实现高吞吐量计算能力的同时，提供优化的功耗管理机制与系统可扩展性。该平台的设计结构从底层支持了高端应用处理器芯片的严苛硬件指标要求。

公司的解决方案已在研发旗舰级平板电脑及高性能计算终端的客户项目中被成功采用。依托经过硅验证的底层基础，该平台使客户能够大幅缩短产品上市时间，同时显著降低高端定制 SoC 开发过程中常见的工程化风险。



图：高性能 SoC 平台应用领域示意图

②视频转码 SoC 平台

衍生于公司高性能 SoC 平台的视频转码 SoC 平台系一种专为云数据中心量身打造的高并发、异构计算架构平台。该平台旨在积极应对由大规模视频流媒体及 AIGC 应用所驱动的日益增长的计算算力需求。

该平台将公司专有的 VPU IP 与超分辨率等先进的像素处理技术深度结合，在提供高质量视频输出表现的同时，深度优化单路视频处理的能耗指标并降低系统延迟，从而切实协助云服务提供商降低服务器运营的总体拥有成本（TCO）。

截至报告期末，已有两代转码 SoC 架构在 14nm 及 5nm 工艺节点上实现成功部署。公司提供从 SoC 架构设计到规模量产以及配套软件 SDK 的一站式定制芯片解决方案，单芯片最高支持多达 32 路高清视频流的同步编解码处理。基于更先进工艺节点且具备增强型 AI 处理能力的下一代

转码平台正在持续研发中。



图：视频转码 SoC 平台应用领域示意图

③自动驾驶 SoC 平台

源自公司高性能 SoC 平台的自动驾驶 SoC 平台，内嵌了高性能片上网络（NoC）、CPU 和 NPU IP。该平台集成了公司自主研发的、符合 ASIL D 最高安全标准的功能安全岛，可支持客户芯片顺利通过 ISO 26262 体系认证。

作为自动驾驶 SoC 平台的核心构成，公司正在持续开发全系列的车规 IP 矩阵，以满足不同汽车安全完整性等级下差异化的功能安全需求。除 ADAS SoC 硬件平台外，公司亦提供全面的软件设计服务，以全方位支持客户的汽车级芯片量产推进工作。

该平台已成功部署在基于 5 纳米先进工艺节点的客户项目中。目前正在设计的下一代自动驾驶 SoC 平台将基于更前沿的工艺节点，并通过引入 PCIe 与 UCIe 等高速接口技术实现增强的连接能力与数据带宽。



图：自动驾驶 SoC 平台应用领域示意图

④高性能 AIGC 平台

公司的高性能 AIGC 平台采用了先进的定制芯片底层架构，专为支持 AIGC 工作负载的严苛要求而设计。该平台集成了一套全面的计算技术体系，涵盖 GPGPU、NPU 及其他专用处理加速单元，以提供深度优化的 AI 算力性能。

该架构无缝结合了多样化的高带宽存储解决方案，如 LPDDR6、LPDDR5x 及 HBM。此外，

其配备了关键的高速系统互连技术，包括 PCIe 5.0、56G/112G SerDes 以及 UCIe，以确保在高度复杂的 AIGC 系统内实现高效的数据传输效能与架构可扩展性。同时，公司针对客户特定的 AIGC SoC 提供基于 Linux 操作系统的 SDK，以全面满足其模型训练及端侧推理的软件需求。

该平台已在采用先进工艺节点的多个客户项目中获得成功部署。公司正在稳步推进多个基于 5nm 和 4nm 先进工艺技术、面向前沿 AI 应用场景的芯片定制服务项目。



图：高性能 AIGC 平台应用领域示意图

⑤AI 图像信号处理 SoC 平台

通过深度整合全栈 SoC RTL、后端物理设计验证及实时 SDK，公司的 AI 图像信号处理 SoC 平台为客户提供了一套极为全面的芯片定制解决方案。这种高度集成的服务模式支持从底层硅片架构定义到上层算法工程实现的全流程芯片开发周期。

该平台的底层架构配备了专用的 NPU 及图像预处理单元，依托公司专有的 FLEXA™同步接口技术，实现了低能耗、超低延迟及无 DDR 的创新设计。该配置可减轻传统系统架构的图像处理带宽限制，并在严格的功率要求下实现了 AI 驱动的图像质量增强和自适应计算。



图：AI 图像信号处理 SoC 平台应用领域示意图

⑥超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台

鉴于 AI/AR 眼镜细分市场的多样化产品形态，公司的超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台提供了一种具备高度灵活性且可重配置的定制架构，旨在满足不同垂直市场的差异化需求。该平台原生支持多种摄像头传感配置、多类别输出接口以及可选的无线连接方案。

为应对眼镜类产品严格的可穿戴物理限制，该平台采用了创新的双芯片分布式架构（将主应用处理器与独立显示处理器解耦）以及先进的 HB-PoP 三维封装技术。其核心硬件特征包括多达 22 个独立电源域的精细化控制、无 DDR 运行模式支持，以及兼容语音与视频唤醒的多级智能待机系统，从芯片底层极大地降低了系统整体能耗和发热量。除主控 SoC 外，公司亦提供专用的 Micro LED 驱动及视频处理方案，以实现与各类前沿显示技术的无缝连接。



图：超低能耗 AI/AR 眼镜 SoC 平台应用领域示意图

⑦混合信号 ASIC 平台

依托公司丰富的基础设施 IP 与低能耗混合信号 IP 储备，芯原开发了专有的混合信号 ASIC 平台，旨在更好地支持定制化 ASIC 解决方案。

截至报告期末，该平台已在多个商业化客户项目中实现成功部署，具体应用涵盖家庭安防网络摄像头、车载自动诊断系统（OBD）以及 BLE MCU 芯片。例如，通过高度集成全套混合信号 IP（包括电源开关 PSW、环形振荡器 ROSC、低压差线性稳压器 LDO、MIPI C/D PHY 接口以及 802.11ah 射频/基带连接协议栈等），并深度结合公司的定制芯片设计服务体系，基于该平台的家庭安防摄像头 SoC 已在消费端获得显著的市场认可，相关芯片累计出货量已超过 1.2 亿颗。



图：混合信号 ASIC 平台应用领域示意图

⑧低能耗 BLE MCU 解决方案

依托公司全套的混合信号 IP 库，以及涵盖射频、基带和软件栈的完整 BLE IP 组合，公司基于 22nm FD-SOI 工艺成功开发了低能耗 BLE MCU 解决方案，并已被一家全球领先的 MCU 企业采用。

公司同步向客户提供量产级 SDK，以全面提升其终端产品的市场竞争力并大幅缩短其商用上市时间。



图：低能耗 BLE MCU 解决方案应用领域示意图

⑨“芯健康”解决方案 (VeriHealthi)

基于公司专有 IP 矩阵所打造的“芯健康”（VeriHealthi）解决方案，可提供从底层芯片设计

到参考应用开发的全链条健康监测解决方案。该平台提供多层级的授权服务模式——包括 SDK、健康算法及智能硬件方案，以及交钥匙的定制芯片设计服务，为企业级客户提供了极为灵活的技术配置选项。

截至报告期末，该平台已为全球范围内的多家客户提供了侵入式脑机接口芯片、胶囊内窥镜芯片以及可穿戴低能耗蓝牙芯片等的 ASIC 定制设计服务。

此外，公司还自主研发了逾 20 种医学健康算法，涵盖心电图检测分析、血压监测以及血糖趋势预测等领域，为医疗康复、专业健康体检和智慧养老等应用场景提供了底层技术支撑。



图：“芯健康”（VeriHealthi）解决方案应用领域示意图

（2）软件技术

1）平台化软件开发技术

公司根据不同类型客户和市场需求，设计开发了基于主流操作系统的层次化、模块化、易重用的多类型高性能应用处理器、SoC 以及 MCU 的驱动软件和中间件开发包，可满足笔记本电脑、媒体播放盒、物联网、无线蓝牙耳机以及其它可穿戴式设备的产品需求。

公司还设计开发了针对应用处理器的 Linux 软件开发包和 Chromium OS、Android 系统软件开发包，以及针对低能耗 SoC 和 MCU 的基于 FreeRTOS 的物联网系统软件平台，帮助客户快速开发应用软件，缩短产品的量产周期。

2）快速迭代软件开发技术

芯片软件开发周期长，发布速度慢，出现质量缺陷尤其是质量回归问题时难以排除，从而导致软件难以按时发布。针对此痛点，公司设计了一套完备的软件开发、自动化测试以及软件发布流程，在开发芯原 SDK 以及帮助客户设计开发软件的过程中实施，能够显著缩短软件测试与发布

周期，第一时间发现质量回归，帮助软件团队及时发现并解决软件质量问题，从而加快软件开发与迭代，及时发布高质量软件，最终帮助客户缩短芯片软件开发周期以及加快产品上市。

3) 基于芯原 IP 和 SDK 的参考应用解决方案

基于芯原自有的 IP 和物联网嵌入式软件平台，芯原设计了针对不同市场需求的参考硬件设计以及应用软件解决方案，如低能耗健康监测方案以及相关算法，可提供从芯片到系统软硬件的一体化解决方案，进一步帮助客户实现从芯片到软件方案的快速定制与量产。目前公司在低能耗蓝牙、无线蓝牙耳机以及健康监测等领域，已经累积了多项核心发明专利。

4) 完善无线通信领域 IP 解决方案的软件技术

在蓝牙、LTE Cat1 等物联网无线通信领域，完成了蓝牙主机协议栈以及 LTE 上层通信协议栈的软件设计与开发，使公司具备了从射频到基带再到软件协议栈的全套通信 IP 解决方案，进一步提升公司在通信领域的技术和市场竞争力。

（3）半导体 IP 技术

芯原的核心半导体 IP 技术主要包括图形处理技术、神经网络处理技术、视频处理技术、数字信号处理技术、图像信号处理技术，显示处理技术，AI 赋能的 IP，以及针对物联网应用所开发的支持各类通信协议标准的无线连接射频和基带 IP 等。

1) 图形处理技术（GPU IP）

公司 GPU IP 采用高度可扩展的架构设计，具备高效的图形渲染与高性能的并行计算能力。基于逾二十年的持续研发积累，该架构的应用场景已广泛覆盖超低能耗可穿戴设备以及高吞吐量 GPU 及 GPGPU 服务器等产品。

在图形处理领域，该 IP 的高能效设计赋能各类终端设备，实现复杂游戏运行、流畅用户界面呈现及高质量视觉体验。在并行计算领域，公司提供高性能的 GPU 和 GPGPU 技术，以应对服务器与数据中心工作负载，为消费电子、汽车及云基础设施等市场提供具备高度可扩展性的计算解决方案。

公司 GPU 及 GPGPU 架构已向全球多家客户实现授权，相关芯片累计出货量逾 20 亿颗。该 IP 产品被广泛应用于智能可穿戴设备，在全球智能手表市场占据重要市场份额；在汽车电子领域，该技术已成功应用于数千万辆汽车，为数字仪表盘、车载信息娱乐系统及智能座舱平台提供核心技术支撑。



图：GPU IP 应用领域示意图

2) 神经网络处理技术（NPU IP）

公司 NPU IP 采用混合架构，将 GPGPU 的可编程性与专用领域加速器（DSA）的高效性深度融合。该架构实现了高度优化的神经网络处理机制，能够高效运行包括计算机视觉、语音处理、图像增强以及大语言模型推理在内的广泛人工智能工作负载。

公司超低能耗 NPU 可提供高达 40 TOPS 的端侧 AI 算力，在满足边缘设备严苛能耗限制的前提下，有效支持复杂的大模型端侧推理任务。上述解决方案已在多家全球知名手机品牌的智能手机产品中成功部署并实现规模化量产。

截至报告期末，公司 NPU IP 在全球范围内累计出货量约 2.5 亿颗。该核心技术已被 91 家客户成功集成至逾 140 款 AI 芯片中，应用领域全面覆盖 AIoT、智能手机、智能驾驶、个人电脑及数据中心等十余个关键市场。



图：NPU IP 应用领域示意图

3) Hantro 视频处理技术（VPU IP）

依托逾二十年的持续研发投入，公司 VPU IP 可提供先进的多格式视频编解码能力。公司 VPU 技术具备高质量、高性能及低功耗的视频处理综合特性，能够充分满足消费电子、汽车电子及云端等应用场景下的严苛性能需求。

该架构具备卓越的设备级适应性。针对可穿戴市场，公司纳米级（nano-class）VPU 为资源受限设备提供了超低能耗表现与高硅片面积能效。凭借高吞吐量与高质量的视频处理技术，公司 VPU 解决方案亦针对云端及数据中心基础设施进行了深度优化，全面支持大规模视频流媒体处理、视频转码及 AI 视频计算等工作负载。

公司 VPU IP 已在业界获得广泛部署，相关芯片累计出货量约 2.5 亿颗。2025 年，在汽车电子市场，该技术已被八家新兴汽车制造商中的五家采纳，核心驱动其数字座舱、车载信息娱乐及智能显示系统；在云计算领域，该 IP 已成功部署于全球排名前 20 的云服务提供商中的 7 家，以及中国排名前 5 的互联网企业中的 3 家。



图：VPU IP 应用领域示意图

4) 数字信号处理技术（ZSP IP）

历经逾二十年的技术演进，公司 DSP IP 已发展成为一种针对复杂信号处理工作负载进行深度优化的先进架构。该架构具备高数据吞吐量与极低执行延迟特性，专为实现高效的音频、语音及通信基带处理而设计。

该高度可配置架构亦针对计算机视觉与嵌入式人工智能等计算密集型工作负载进行了深度优化，切实保障了各类多媒体、无线连接及物联网应用场景在实际运行中获得稳健的性能与能效表现。

公司最新发布的第五代 DSP IP 系列，为智能终端、汽车电子系统、可穿戴设备及 AIoT 产品提供了灵活且具备高可扩展性的解决方案。该架构致力于在边缘设备的计算能力、能效指标及芯片面积约束之间实现最优化平衡。



图：ZSP IP 应用领域示意图

5) 图像信号处理技术（ISP IP）

公司 ISP IP 作为核心图像处理引擎，致力于以超低能耗高效支持多传感器系统与高分辨率成像应用。该架构针对机器视觉、智能汽车、机器人、网络摄像头、安防监控以及 AR/VR 设备等广泛的应用领域，提供具备高度竞争力的 AI 视觉解决方案。

该架构集成了前沿图像处理技术，全面兼容并支持高动态范围（HDR）、多帧降噪、镜头畸变校正（Dewarp）以及多传感器同步等高级特性。针对自动驾驶场景，该 IP 采用超低延迟流水线设计，大幅缩短自图像采集至 AI 处理环节的数据链路时间，有力支持系统的实时决策。此外，该 IP 已顺利通过 ISO 26262 功能安全标准认证，充分满足车规级平台的可靠性及安全性要求。

截至报告期末，公司 ISP IP 已获全球近 90 家客户正式采用，其中包括 20 余家汽车电子企业。



图：ISP IP 应用领域示意图

6) 显示处理技术

公司显示处理 IP 基于内置的先进画质增强技术，可实现对各类显示屏幕像素的高效处理。该技术提供全方位的显示解决方案，应用场景从超低功耗的可穿戴设备显示终端延伸至高性能的多屏系统，最高可支持 8K@60fps 的超高清（UHD）规格输出。

该 IP 集成并涵盖了一套完整的显示处理功能矩阵，包括图像增强、超分辨率、3D LUT 色彩校正等，同时全面支持 HDR10、HDR10+ 及 HDR Vivid 等高动态范围标准，致力于为终端用户提供色彩准确且具备高对比度的视觉体验。针对汽车电子应用，该架构内置完善的功能安全机制，且已通过 ISO 26262 标准认证，从底层架构上保障其在数字座舱和车载显示系统中的稳定可靠运行。

公司显示处理 IP 已广泛渗入多个细分市场的规模量产产品中，具体涵盖可穿戴设备、智能手机、平板电脑、智能显示终端及各类高端消费电子产品。此外，通过功能安全认证的车规级显示 IP 亦已在全球范围内多款量产车型中实现规模化部署与应用。



图：显示处理技术应用领域示意图

7) AI 赋能的 IP

公司 AI 赋能的 IP 解决方案系一种跨领域的融合计算架构。依托公司自主研发的专有 FLEXA™同步接口技术，该架构成功将 ISP、VPU 及 NPU 等独立的 IP 核整合为高度紧耦合的 AI 子系统。

该架构通过在各 IP 核之间构建无需外部 DDR 内存访问的直接数据流通道，深度优化了传统的片内数据传输链路。该等子系统级创新技术旨在突破系统内存带宽瓶颈，从而为边缘 AI 应用场景提供兼具低延迟与高能效的计算处理能力。

公司 AI 赋能的 IP 解决方案（包括 AI-ISP 和 AI-Display 等子系统组合）目前已在广泛的终端市场应用中实现规模化部署。上述解决方案已被成功集成至智能手机、智能座舱、高级驾驶辅助系统、AI 个人电脑、数据中心、可穿戴设备及安防物联网等多元化终端产品中。



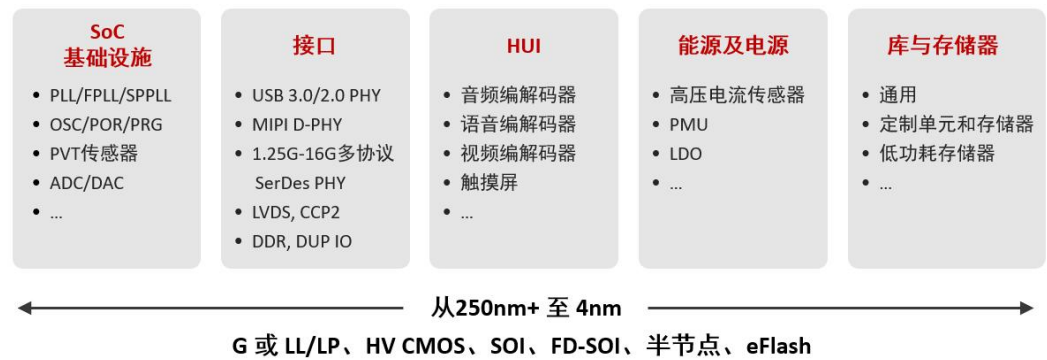
图：AI 赋能的 IP 应用领域示意图

8) 模拟与混合信号 IP

公司提供全面的模拟与混合信号 IP 组合，以全面支持定制芯片设计。该 IP 矩阵涵盖 SoC 基础 IP、接口 IP、人机界面（HUI）IP、能源与电源管理 IP 以及标准单元库与存储器 IP。

公司上述经过硅验证的 IP 矩阵高度适配全球主流晶圆厂的制造工艺，实现了从成熟工艺节点到 5nm 及 4nm 等先进工艺节点的全面覆盖。通过提供稳定可靠的底层物理构建模块，该等解决方案致力于降低客户向先进工艺节点迁移过程中的物理设计风险。

截至报告期末，公司已累计开发逾 1,700 款模拟与混合信号 IP，全面支持主要晶圆厂的广泛工艺技术。该等丰富的 IP 储备有效助力客户精简芯片开发流程，并显著缩短其产品上市周期。



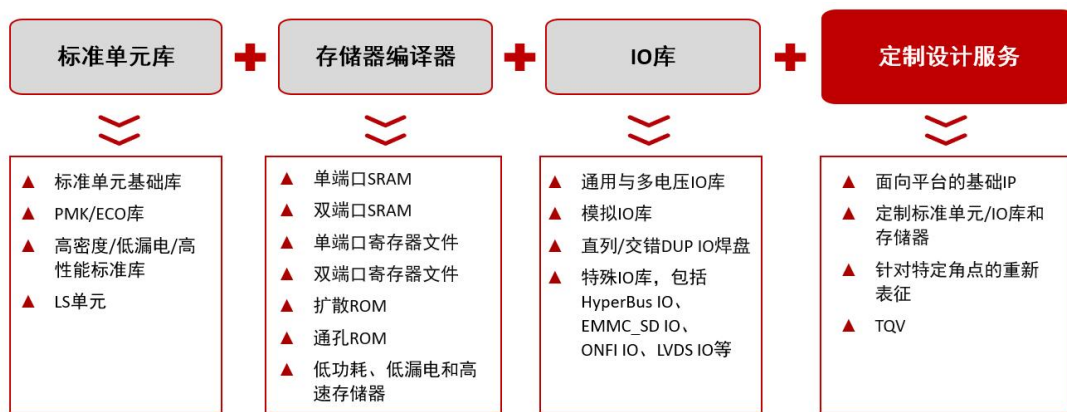
图：模拟与混合信号 IP 组合示意图

9) 基础 IP 组合

公司设计并提供全面的基础 IP（Foundation IP）组合，具体涵盖标准单元库、存储器编译器以及输入/输出（IO）库。该等关键底层物理构建模块旨在支持跨全球多家晶圆厂的广泛半导体制造工艺。

公司的核心工程能力包括对标准单元库进行定制化的重新表征（Re-characterization）。该技术流程使公司能够对物理 IP 进行精细调优，以满足特定系统级标准，并针对复杂 SoC 设计所要求的特定处理速度及严格的功耗配置进行深度优化。

截至报告期末，公司开发的标准单元及 IO 库已在广泛的工艺技术中实现规模化部署。公司经过硅验证的产品组合跨越了从 250nm CMOS 成熟节点至各主流晶圆厂 5nm 及 4nm FinFET 等先进节点，为定制芯片开发奠定了可靠的物理基础。



图：基础 IP 组合示意图

10) 射频 IP 及无线连接解决方案

公司提供涵盖射频（RF）前端、数字基带及软件协议栈的全栈式无线连接解决方案。该平台基于 22nm FD-SOI 工艺开发，为无线通信系统提供了高集成度与优化的功耗表现。此外，该产品组合亦包含已开发完成的点对点 WiFi Aware IP，其同样集成了完整的射频、基带与软件栈。

该平台全面兼容主流无线通信协议，包括 Wi-Fi 6、低功耗蓝牙（BLE）5.3、NB-IoT 及多模卫星导航技术。其内部深度集成了片上性能自适应微调与射频校准算法，以确保信号传输的稳定可靠。同时，公司的 WiFi Aware IP 具备更短的发现与连接时延，结合精简的软件架构，在设备待机及设备发现阶段实现了能耗的显著降低。

截至报告期末，该系列射频 IP 已被多家客户正式采用并投入规模量产。其能够有效支持对能耗及体积严格要求的可穿戴设备与物联网应用场景。具体而言，公司的无线解决方案已成功部署于智能手表及 AI/AR 眼镜等低功耗消费电子产品中。



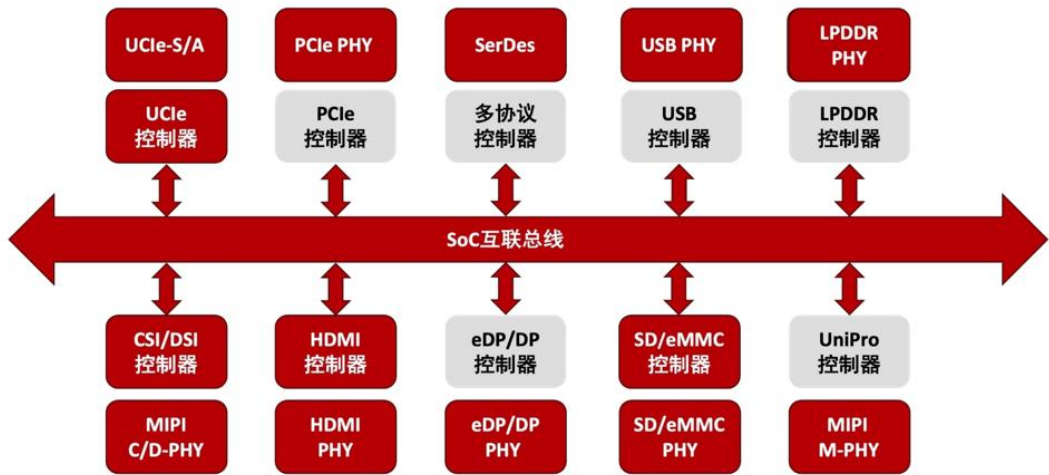
图：射频 IP 及无线连接解决方案示意图

11) 接口 IP 组合

公司提供专为高速数据传输与系统互联设计的接口 IP 组合。该产品组合涵盖 MIPI、USB、HDMI 及 PCIe 等核心行业标准，并已成功移植至 4nm 及 8nm FinFET 等先进工艺节点，以全面支持定制芯片开发工作。

该等接口 IP 兼顾了高带宽传输能力和低能耗表现，进而实现系统级芯片（SoC）内部及外部设备间的高效数据交互，同时还能满足企业级服务器与汽车级应用的严苛可靠性要求。作为关键的互连组件，其为异构计算及智能汽车架构的构建提供了核心支撑。

目前，公司正系统性地推进混合信号 IP 矩阵的功能安全认证工作。通过将符合 ISO 26262 标准认证的芯片设计流程与车规级 IP 组合深度结合，公司持续在汽车电子领域部署接口 IP 解决方案，以强力支持新一代汽车电子平台的研发与量产。



图：接口 IP 组合示意图

12) 定制化混合信号 IP 组合

公司提供模拟与混合信号 IP 定制服务，业务涵盖高性能模数转换器（ADC）、数模转换器

（DAC）及其他专用功能模块。该等服务旨在根据客户特定的系统架构需求，提供量身定制的 IP 解决方案。

公司的定制化流程深度融合了模拟设计专业技术与目标应用场景需求。该方法致力于攻克标准通用 IP 难以满足的特定性能指标及功耗目标，确保 IP 模块在芯片底层达成高精度的运行参数。

上述定制化能力构成了公司“芯片设计平台即服务（SiPaaS）”商业模式的重要基石。通过提供量身定制的模拟与混合信号解决方案，公司切实支持客户实现差异化的芯片设计，并有效加速其特定半导体产品的开发周期。



图：定制化混合信号 IP 组合示意图

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☒适用 ☐不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
芯原科技	国家级专精特新“小巨人”企业	2025 年	/
逐点半导体	国家级专精特新“小巨人”企业	2024 年	/

2、报告期内获得的研发成果

报告期内，公司新增 93 件发明专利申请、5 件商标注册申请，共获得 54 件发明专利授权、13 件商标注册核准、21 件集成电路布图设计专有权授权。截至报告期末，公司累计获得有效授权

知识产权为 432 件发明专利、3 件实用新型专利、2 件外观设计专利、13 软件著作权、176 件商标及 296 件集成电路布图设计专有权。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	93	54	1,431	432
实用新型专利	0	0	3	3
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	0	0	13	13
其他	5	34	546	472
合计	98	88	1,995	922

注：上表“其他”内包括商标及集成电路布图设计专有权；“累计数量”内包含公司报告期内收购的控股子公司逐点半导体累计申请数/获得数；累计获得数已扣除报告期内期满失效的数量（商标为公司评估后不续展）。

3、研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	880,197,697.00	612,004,691.23	43.82
资本化研发投入	60,754,573.18	27,848,401.51	118.16
研发投入合计	940,952,270.18	639,853,092.74	47.06
研发投入总额占营业收入比例（%）	50.49	65.71	减少 15.22 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	6.46	4.35	增加 2.11 个百分点

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用
主要由于公司股份支付费用增加及人员费用增加及所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	面向数据中心和 GPU-AI 计算的	60,617.21	8,370.56	42,001.33	-3D GPU 总体架构文档，详细架构文档，设计文档编写已完成	-支持 16~32 TFLOPs FP32 算力 -支持 20~120 TFLOPs FP16 算力	国际先进	-大规模并行计算 -桌面显卡

	高性能图形处理器技术				-验证环境搭建，验证方案编写，验证用例开发已完成 -性能模型和功能模型代码编写，Benchmark 性能分析已完成 -硬件代码编写已完成 -后端实现方案架构设计已完成 -硬件设计完成，验证已完成 -软件代码开发完成，测试完成 90%	-支持 40~240 TFLOPs FP8 算力 -支持 40~240 TOPs INT8 算力 -支持 128~1536 Texel/cycle 纹理处理能力 -支持 32~384 Pixel/cycle 像素填充能力 -支持 Tensor engine -支持 DX12 FL12 -支持 CUDA9.0 和 CUDA12.0 -支持 Windows 操作系统	-车载信息娱乐 -工业显示 -物联网及可穿戴设备
2	支持先进视频格式和 AI 视频的视频处理器技术	29,222.37	3,564.18	19,051.85	-新一代视频编码基础架构已在 H.264、H.265、AV1 上实现，编码质量和性能有了良好的提升，已被多家大型互联网公司和一家新势力车企选用 -完成新一代视频标准 AV2 的解码设计	-针对数据中心，建立新一代的视频编解码架构，提升编解码质量和性能，支持更高标准的视频编解码格式 -视频编码新增 VVC 标准支持 -视频解码新增 AV2 标准支持 -满足更广泛的视频领域需要：支持 YUV444/422 12bit 以及 LC-EVC 等编解码格式和规范 -针对 IoT、监控市场对高性价比编解码 IP 的基础需求，建立新一代 Nano 系列编解码 IP -全面优化设计，让国产手机芯片编解码 PPA 和视频编解码质量达到和超越国际先进水平	国际先进 -数据中心的图像分析卡 -视频转码卡 -监控终端设备 -视频播放和记录设备，包括手机、平板电脑、汽车、无人机、智慧物联网等 -自动驾驶方案的视频处理单元
3	面向数据中心和边缘服务器端高性能 AIGC 应用的神经网络处理器技术	32,895.71	3,427.26	19,222.22	-规划新一代架构更新	-支持基于 PyTorch 和 Tensorflow 的推理和训练 -支持 INT4/INT8/INT16/FP8/FP16/BF16 等多种数据格式 -高效支持基于 Transformer 架构的大模型	国际先进 -人工智能服务器 -人工智能边缘计算 -智能家居与智能监控 -语音及视觉处理 -物联网及可穿戴设备

						-支持 2:4 结构化稀疏，并提升模型压缩比 -单核算力支持 0.5-200 TOPS，多核架构支撑更大算力		
4	ZSP5x00 异构多核及 Vippico AI DSP 软硬件开发	34,800.33	1,043.72	1,043.72	-完成 ZSPNanoUltra/ZSP NanoUltraHD DSP 核的设计与配套 FFT/数学函数/滤波函数等深度优化基础计算库 -完成 ZSP5400H 核的设计与多核调度驱动并在仿真器与 FPGA 板上完成验证	ZSPNanoUltraHD -支持 8 个 INT16 MAC -支持 4 个 INT32MAC -支持 4 个 FP32 MAC,可选配 -针对 int32 和 int16 蝶形运算的指令加速 -支持最大 72bit 累加器位宽，支持高清语音算法 -内存子系统支持 DTCM/ITCM/DCACHE/ICACHE，并且 size 可配 -支持 bitstream 指令，加速 codec 算法 -支持协处理器扩展（ZTurbo） -支持 32 个中断 -支持 RTOS 系统 ZSP5400H 多核系统 -单核最大支持 256 个 INT16 MAC -单核最大支持 32 个 FP32 MAC -多核系统最大支持 32 个核心 -硬件集成了多核通信系统来加速核间通信 -支持通过硬件锁机制实现某个硬件资源的原子访问 -最大支持 64bit 地址区间 -多核带宽根据实际应用灵活可配，包括对外的 axi 总线位宽和个数	国际先进	-计算机视觉，如图像识别、VSLAM 等 -5G 及其它宽带无线通信的基带信号处理，如卫星通信基带芯片等 -人工智能语音处理
5	AI- 图像信号处理器技术	29,605.17	3,622.27	22,136.86	-AI-ISP 产品规格的定义 -AI 降噪算法的研究	-支持 AI 处理引擎的集成 -支持 AI 降噪算法 -支持 AI-WDR	国际先进	-安防监控 -汽车辅助驾驶 -智慧家庭

					-AI-ISP 的架构研究 -AI 降噪/WDR 算法和硬件实现 -AI-ISP 的架构设计和硬件集成	-高性能 Camera 子系统的设计		-AIoT 等含摄像头的产品
6	高画质 AI 显示处理器技术	13,285.32	1,629.13	8,250.86	-算法研发 -方案设计 -IP 设计实现 -硬件设计完成，验证完成 50% -软件代码开发完成，测试完成 60%	-基于深度学习的低功耗、低成本超分辨率解决方案 -云端到边缘端的高画质解决方案(面向云桌面、云游戏、网络会议等应用) -低功耗显示 IP 技术和系统解决方案	国际先进	-AIoT -智能手机 -平板电脑 -桌面显卡 -桌面显示器 -电视领域 -智能座舱
7	基于 FLEXA 的子系统技术	11,905.98	1,139.85	11,905.98	-已经完成基于 FLEXA 的 DDR-less 方案并完成多个 MCU 和可穿戴项目	-面向可穿戴市场的低功耗、低延迟多媒体处理子系统 DDRless 技术方案	国际先进	-MCU/MPU -AR 眼镜和可穿戴设备
8	数模混合 IP-超低功耗 Audio CODEC 单电感多输出 BUCK-BOOST 开关电源 (SIMO DC/DC)	11,187.64	375.49	375.49	-已完成所有项目 (Audio CODEC 和 SIMO DC/DC) 在 SMIC28HKE 工艺上的可行性调研，以及系统架构设计与模型仿真。 -已完成各关键模块的架构选型、噪声分析与模型设计 (涵盖 ADC 的 PGA/Σ-Δ 调制器/抽取滤波器，DAC 的 IDAC/RDAC/Class D 调制器/输出级/插值升采样及数字调制器，SIMO DCDC 的驱动与控制逻辑)，并完成模拟/子模块电路设计与仿真 -针对 SIMO DCDC，已解决能量转换方式、驱动选型、多路控制逻辑、LDMOS 耐压、串扰抑制、防倒灌及 ESD 配套等设计难点。	-开发出具有超高性能的面向消费电子应用的模拟 IP 平台 -多通道 ADC/DAC 性能指标 ADC SNR > 110dB, DAC SNR > 115dB -整体性能达到国内领先 -开发出具有超低功耗的面向消费电子应用的模拟 IP 平台 -多通道 ADC/DAC 功耗 100uW/通道，性能指标 ADC/DAC SNR > 92dB -整体功耗达到国内领先 -开发出单电感多路电压输出的 SIMO DCDC -整体面积及效率达到国内领先	国内先进	-助听器芯片 -智能语音唤醒芯片 -多媒体芯片 -高端耳机

					-当前正在进行： ADC 的抽取滤波器 电路设计与模拟顶层仿真，DAC 的 数字滤波器电路设计 与模拟顶层仿真，以及 SIMO DCDC 的 Top 仿真			
9	物联网连接 技术- 低功耗 蓝 牙 IP 研发	12,241.3 6	1,424.0 1	12,026.82	-更新 BLE 射频电 路设计，完成 IP 功 耗面积优化，IP DK 通过 QA 达到 发布交付状态 -继续开展数字基带 系统架构优化，完 成工作时钟频率降 低和硬件设计更 新，以及 BQB 验 证测试工作	-IP 核心工作电压降 低至 0.65v，射频 IP 面积进一步缩减 30%，并进一步提升 抗干扰特性 -重构数字基带系 统，进一步降低工作 时钟和占用存储，优 化功耗和面积	国际 先进	-广域物联网 -智慧城市 -智能交通 -智慧农业等
10	4G Cat1 射 频 IP 研发	6,745.42	800.65	5,800.02	-完成测试芯片功能 及性能验证，完成 与基带芯片集成测 试，通过了 3GPP FDD/TDD 相关用 例测试以及实际网 络外场测试 -完成 RF 实时控制 驱动开发集成，实 现对 RF 测试芯片 的动态实时控制	-支持 3GPP R14，符 合 36.101 射频规格 定义 -支持 FDD 和 TDD 模式，单天线接收 -集成完整的发射和 接收链路以及时钟电 源模块 -采用 22nm 工艺， 工作电压 0.8v，可与 数字基带单芯片集成	国内 先进	-广域物联网 -智慧城市 -智能交通 -智慧农业等
11	物联网连接 技术 -多通 道 GNSS 射 频 IP 研发	3,141.68	94.77	2,783.08	-集成 IP 的 SoC 完 成测试，逐步进入 量产阶段,支持商用 模组的性能调试 -集成低功耗版本 IP 的 SoC 完成测 试，优化后进行了 full mask 流片， SoC 开始进入试产	-支持全球 4 种导航 卫星制式：GPS、北 斗、Galileo、 Glonass -支持单通道、双通 道及多通道多种配置 -采用 22nm FD-SOI 工艺，工作电压低至 0.8v 并保持高性能， 通过设计优化降低功 耗 -集成大带宽高精度 ADC，提供可靠抗 干扰能力	国际 先进	-高精度导航 -智慧农业 -智能驾驶
12	芯片定制技 术	47,763.2 4	10,169. 02	39,675.35	-进一步扩容了硬件 仿真器和 FPGA 原 型系统的容量规 模，支撑不同类型 客户的复杂 SoC 芯 片验证	-结合现有的硬件仿 真器/FPGA 原型系 统，进一步强化软硬 件整合能力 -进一步升级现有硬 件仿真器和 FPGA 原	国际 先进	-消费电子 -汽车电子 -计算机及周边 -工业 -数据处理

					-在已有设备能力的基础上，扩充了 Chiplet 验证的相关软硬件能力，满足多芯粒 Chiplet 芯片验证 -已基于当前多种硬件仿真器和 FPGA 原型系统，完成多个客户的芯片验证和早期软件版本的交付 -重点引进了高端固定资产 PLD Z3。该笔重大投入已快速转化为研发动能，在关键工艺测试中发挥重要作用，有效提升了研发效率与精度，标志着项目从理论验证迈入实质化推进新阶段	型系统的容量规模，支撑更大规模 SoC，多芯粒 Chiplet 的芯片验证工作		-物联网
13	Cat1.bis IP 系统	14,890.36	1,071.53	14,890.36	-基带芯片 V1 已完成全部功能验证，达到设计目标 -基带芯片 V1 已完成第三方一致性测试 -射频、基带一体化子系统规划完成，已进行多轮外场测试，性能持续优化中 -基带芯片 V2 完成 RTL 设计，综合面积优化约 30% -基带芯片 V2 软件协议栈优化已基本实现，并基于 FPGA 完成基本 Case 验证 -LWIP(TCP/IP)移植到协议栈软件中 -已完成项目研发成果	-优化数据路径中的基带硬件设计，以减少逻辑闸门数量和内存使用，实现下行 10Mbps/上行 5Mbps 吞吐量 -升级接收器算法以支持单输入单输出 (SISO)处理 -基于自有 ZSP G5 核完成物理层固件和高层协议栈执行，实现更好的性能和更低的功耗 -基于自有 ZSP G5 核，根据优化 PPA 的新目标，调整基带时钟频率 -优化协议栈软件，并在 ZSP G5 核上运行，减少代码/数据大小，减少内存使用 -升级节电机制，减少休眠模式下的漏电 -Modem 软件支持 TCP/IP	国内领先	-车辆/资产追踪 -移动支付 POS 机 -共享设备的管理 -基础设施的远程控制

						-Modem 带 bootrom，支持多种 boot 方式和灵活的更新协议栈软件方案		
14	接口类 IP	12,075.97	2,013.04	10,161.97	-UCIe PHY 在 14nm/4nm 已回片完成硅验证，性能达到预期，已经和 UCIe 控制器 IP 一起导入客户的项目。8nm 版本已完成流片。 -UCIe 控制器 IP 已经搭配第二版 UCIe 物理层 IP 一起进行回片测试，目前控制器功能正常，整个子系统性能和稳定性压力测试正在进行中。 -启动车规级的 UCIe 物理层 IP 研发，计划年度完成流片。 - HSS_DSP_SERDES 已经于 2025 年 12 月完成流片，正在进行封装和测试 PCB 制板。第二版改进版正在进行中，并计划于年底完成流片。 -车规级 MIPI CD -PHY IP：已经取得 TUV NORD ASIL-B 功能安全证书 -车规级 MIPI CSI-2 Host 和 Device 控制器 IP 功能安全设计已经基本完成，功能安全工作成果正在进行内部审核。 -A-PHY Source 和 Sink IP：规划 A-PHY Source 和 Sink IP 的功能安全设计已经基本完成，功	-为构建复杂 SoC 或 Chiplet 提供可靠的接口技术，包括 UCIe 物理层和控制器、LPDDR 物理层和控制器、I3C 接口，以及高速 HSS_DSP_SERDES 解决方案等 -车规级 UCIe 物理层和控制器 IP 取得功能安全 ASIL-B 证书 -车规级 MIPI CSI-2 Host and Device 控制器 IP 取得功能安全设计 ASIL-B 证书 -A-PHY Source 和 Sink IP：完成 IP 相关的可靠性测试；完成 IP 的一致性测试；取得功能安全设计 ASIL-B 证书	国内领先	-Chiplet 应用 -数据中心 -ADAS 和自动驾驶 -AIGC 相关应用等 -车载视频传输 -工业视频长距离传输

					能安全工作成果正在进行内部审核。 -LPDDR4X 和 LPDDR6 物理层 IP 开发已启动，目前 LPDDR4X 的电路设计已经基本完成，版图设计正在进行中，LPDDR6 正在进行架构设计。			
合计	/	320,377.76	38,745.48	209,325.90	/	/	/	/

5、研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量（人）	1,883	1,805
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	87.79	89.31
研发人员薪酬合计	70,419.62	60,066.97
研发人员平均薪酬	37.40	33.28

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例(%)
博士	28	1.49
硕士	1618	85.93
大学本科	227	12.06
大专及以下	10	0.53
合计	1,883	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量（人）	比例(%)
30 岁以下（不含 30 岁）	867	46.04
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	688	36.54
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	254	13.49
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	63	3.35
60 岁及以上	11	0.58
合计	1,883	100.00

6、其他说明

☐适用 ☒不适用

四、风险因素

☒适用 ☐不适用

（一）业绩大幅下滑或亏损的风险

1、经营业绩无法按计划增长的风险

2026年上半年，公司实现营业收入18.64亿元，较上年同期增长91.37%。公司2026年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为-6.12亿元，归属于母公司所有者扣除非经常损益后净利润-6.22亿元。

若未来出现宏观经济下行、行业竞争加剧、上游原材料供应紧张或涨价、下游市场需求继续减少、重要客户或供应商与公司合作关系变动等对公司经营构成不利影响的变化，而公司未能采取有效应对措施，则可能存在经营业绩无法按计划增长或出现下滑的风险。

（二）核心竞争力风险

1、研发失败、产品或服务无法得到客户认同的风险

公司能否顺利开展研发活动并形成满足客户需求的产品或服务，对其正常经营乃至未来实现持续盈利具有重要作用，公司研发活动面临的风险主要包括研发方向与行业未来发展方向不一致的风险、集成电路设计研发风险、技术升级迭代风险等，详见本节之“（二）核心竞争力风险、（五）行业风险”相关内容。如出现上述风险从而导致研发活动失败，公司的产品或服务将难以满足客户需求、无法得到客户认同的风险，进而对其经营产生不利影响。

2、集成电路设计研发风险

公司的集成电路设计研发风险主要由于公司设计服务技术含量较高、持续时间较长，可能面临研究设计未能达到预期效果、流片失败、客户研究方向或市场需求改变等不确定因素而导致公司签署的服务合同存在较预期提前终止或延期支付的风险，可能会对公司未来的收入和盈利能力产生一定程度的影响。

3、技术升级迭代风险

集成电路设计行业下游需求不断变化，产品及技术升级迭代速度较快，芯片制程不断向28nm、14nm、7nm、5nm、4nm等先进制程演变。该行业仍在不断革新之中，且研发创新存在不确定性，公司在新技术的开发和应用上可能无法持续取得先进地位，或者某项新技术的应用导致公司现有技术被替代，将导致公司行业地位和市场竞争力下降，从而对公司的经营产生不利影响。

（三）经营风险

1、研发人员流失风险

集成电路设计行业属于技术密集型产业，对技术人员的依赖度较高。截至报告期末，公司拥有研发人员1,883人，占员工总人数的87.79%。未来，如果公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实、或人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行等，将难以引进更多的高端技术人才，甚至导致现有骨干技术人员流失，将对公司生产经营产生不利影响。

2、技术授权风险

半导体 IP 指已验证的、可重复利用的、具有某种确定功能的集成电路模块，EDA 工具为芯片设计所需的自动化软件工具。公司在经营和技术研发过程中，视需求需要获取第三方半导体 IP 和 EDA 工具供应商的技术授权。报告期内，公司半导体 IP 和 EDA 工具供应商主要为新思科技和铿腾电子，如果由于国际政治经济局势剧烈变动或其他不可抗力因素，上述供应商均停止向公司进行技术授权时，将对公司的经营产生不利影响。

3、半导体 IP 授权服务持续发展风险

公司目前拥有 GPU、NPU、VPU、DSP、ISP、Display Processing 六类处理器 IP、1,700 多个数模混合 IP 和射频 IP。报告期内，公司半导体 IP 授权服务业务收入为 3.49 亿元，占营业收入总额比例为 18.72%。公司未来半导体 IP 授权服务业务能否持续增长不仅取决于能否成功拓展新客户和继续与存量客户维持合作，还取决于公司拥有及未来将要研发的半导体 IP 在性能、用途等方面能否满足客户需求。若无法满足上述条件，则半导体 IP 授权服务存在难以持续发展的风险。

4、与芯思原利益冲突的风险

芯思原为公司的联营公司，与公司同属于集成电路行业企业，且公司的董事及高级管理人员 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、汪志伟同时在公司和芯思原处担任职务。随着公司和芯思原的业务拓展，如未来因此导致公司与芯思原主营业务出现重大利益冲突，或芯思原在资产、人员、财务、机构、业务等方面不再具备独立性，亦或 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、汪志伟在同时担任公司及芯思原职务时未能适当履职，均将会导致公司的利益受到损害。

5、海外经营风险

公司在美国、欧洲、日本、中国香港、中国台湾等地区设有分支机构并积极拓展海外业务。报告期内，公司来源于境外的收入金额为 5.60 亿元，占公司营业收入总额的 30.07%。海外市场受政策法规变动、政治经济局势变化、知识产权保护等多种因素影响，随着公司业务规模的不断扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，若公司不能及时应对海外市场环境的变化，会对海外经营的业务带来一定的风险。

（四）财务风险

1、商誉减值风险

截至报告期末，公司因 2004 年 9 月收购上海众华电子有限公司 100%股权、2016 年 1 月收购图芯美国 100%股权，2026 年 1 月以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体控制权，合计形成商誉 6.07 亿元。公司至少每年对收购形成的商誉执行减值测试，如果被收购公司未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值的风险，可能对公司的当期盈利水平产生不利影响。

2、应收账款余额较大及发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款账面余额为 14.52 亿元，占当期期末流动资产的比例为 22.96%。随着公司经营规模的不断扩大，业务拓展的不断加快，应收账款金额可能进一步增加。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化从而导致个别客户财务状况恶化，则公司亦存在应收账款难以收回而导致发生坏账的风险。

3、芯片定制业务毛利率波动风险

报告期内，公司芯片定制解决方案服务业务收入为 15.13 亿元，占当期营业收入比例为 81.17%。报告期内，公司芯片定制解决方案服务业务毛利率 17.03%。随着技术的发展和市场竞争的加剧，公司必须根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化、技术实力停滞不前或行业地位下降，将导致公司芯片定制解决方案服务业务毛利率出现下降的风险。

4、所得税优惠政策变动的风险

报告期内，公司被认定为高新技术企业，享受 15%的所得税优惠税率；公司控股子公司芯原成都被认定为西部地区鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税；公司控股子公司图芯上海、芯原北京、芯原广州、天遂芯愿因满足小型微利企业的要求，对年应纳税所得额不超过 100 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过 100 万但不超过 300 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；公司控股子公司芯原海南被认定为高新技术企业，享受 15%的所得税优惠税率；公司控股子公司芯原南京被认定为高新技术企业，享受 15%的所得税优惠税率；公司控股子公司芯原科技被认定为临港新片区 2023 年第二批重点产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税；公司控股子公司逐点半导体被认定为高新技术企业，享受 15%的所得税优惠税率；公司控股子公司逐点珠海因满足小型微利企业的要求，对年应纳税所得额不超过 100 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过 100 万但不超过 300 万的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。如果未来上述企业不能继续享受所得税优惠税率，或未来国家主管税务机关对上述所得税的税收优惠政策作出调整，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

（五）行业风险

1、研发方向与行业未来发展方向不一致的风险

集成电路设计企业需要根据行业发展趋势进行前瞻性的研发设计，研发方向与行业未来发展方向是否一致较为重要，若公司未来不能紧跟行业主流技术和前沿需求，将有可能使公司技术研发方向与行业发展方向及需求存在偏差，无法满足下游客户的需求，从而对公司的经营产生不利影响。

2、行业增长趋势减缓或行业出现负增长的风险

根据 IBS 报告，全球半导体市场在 2025 年市场规模为 6,726 亿美元，人工智能、大数据、云计算、5G 通信、物联网、智慧汽车和新能源等应用的快速发展将驱动着该市场在 2035 年达到 16,341 亿美元。未来如果行业增长趋势减缓或行业出现负增长，可能会在存量市场中出现竞争加剧、产品需求下降等导致行业参与者销售收入降低的情形。公司所处行业发生不利变化将有可能直接影响公司的业务收入，从而对公司的经营产生不利影响。

（六）宏观环境风险

1、国际贸易摩擦风险

近年来，伴随着全球产业格局的深度调整，国际贸易摩擦不断，逆全球化思潮出现。部分国家通过贸易保护的手段，对中国相关产业的发展造成了客观不利影响，中国企业将面对不断增加的国际贸易摩擦和贸易争端。报告期内，公司来源于境外的收入占比较高，若未来与中国相关的国际贸易摩擦持续发生，可能会对公司的经营产生不利影响。

2、汇率波动风险

目前，公司在境外设立了多个分支机构，业务已覆盖美国、欧洲、日本、中国香港、中国台湾等境外市场。报告期内，公司来源于境外的收入金额为 5.60 亿元，占公司营业收入总额的 30.07%。如在未来期间汇率发生较大变动或不能及时结算，且公司不能采取有效措施，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。

（七）其他重大风险

1、法律风险

（1）知识产权风险

公司的核心技术为芯片定制技术和半导体 IP 技术，公司通过申请专利、集成电路布图设计专有权、软件著作权等方式对自主知识产权进行保护，该等知识产权对公司未来发展具有重要意义，但无法排除关键技术被竞争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，并在需要时取得第三方知识产权授权，避免侵犯他人知识产权，但无法排除竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略，阻碍公司正常业务发展的风险。

若中美贸易摩擦持续恶化，美国政府将公司及境内子公司列入美国商务部工业安全局编制的实体清单，则芯原开曼、图芯美国无法向公司及境内子公司销售含有美国注册专利技术的产品；若美国政府将中国境内客户列入实体清单，则芯原开曼、图芯美国无法向中国境内客户销售有美国注册专利技术的产品。若上述两种情况发生，则会导致芯原开曼、图芯美国的美国注册专利所涉及的相关技术在相关客户产品上的使用受到一定限制，会对公司经营业绩造成一定影响。

（2）非专利技术和技术秘密等泄露风险

公司通过不断积累和演化已形成了较为丰富的非专利技术和技术秘密，其对公司发展具有重要意义。公司制定的相关技术保密制度、与员工签署的《保密协议》等无法完全防范技术泄露问题，不能排除未来因员工违反相关制度和协议、员工离职等因素导致的非专利技术和技术秘密泄露的风险。

（3）台湾分公司未完成投资者身份变更登记的风险

台湾分公司作为公司在中国台湾地区的销售与客户联络处，尚待取得台湾地区经济部投资审议司关于陆资投资者身份变更登记的许可，未取得该等许可可能会招致罚款、要求撤回投资、撤销或废止外国公司认许或登记等处罚。

2、内控风险

（1）股权分散、无控股股东和实际控制人的风险

公司股权相对分散，不存在控股股东和实际控制人。截至报告期末，公司第一大股东 VeriSilicon Limited 持股比例为 11.39%。公司经营方针及重大事项的决策由股东会和董事会按照公司议事规则讨论后确定，但不排除存在因无控股股东、无实际控制人导致公司决策效率低下的风险。同时，分散的股权结构导致公司上市后有可能成为被收购的对象，从而导致公司控制权发生变化，给公司生产经营和业务发展带来潜在的风险。

（2）子公司控制的风险

截至报告期末，公司共有 10 家境内控股子公司，10 家境外控股子公司，且业务范围覆盖境内外多个国家或地区，地域较为分散，公司可能存在对控股子公司管理不善而导致的内控风险。

（3）公司规模扩张带来的管理风险

自 2020 年公司首次公开发行股票并在科创板上市后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，员工人数将相应增加，需要公司在资源整合、市场开拓、技术研发与质量管理、内部控制等诸多方面进行调整优化，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。公司经营决策、组织管理、风险控制的难度也随之加大，公司存在因经营规模扩大导致的经营管理风险。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 18.64 亿元，同比增长 91.37%，经调整后归属于上市公司股东的净利润-4.23 亿元，经调整后 EBITDA（息税折旧及摊销前利润）-2.22 亿元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 90.60 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 29.25 亿元。公司报告期内经营情况分析请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

(一) 主营业务分析**1、 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,863,539,395.68	973,799,834.20	91.37
营业成本	1,279,465,095.96	551,912,841.72	131.82
销售费用	85,681,139.60	62,458,562.68	37.18
管理费用	133,367,306.27	58,636,060.05	127.45
财务费用	67,203,699.19	18,075,760.20	271.79
研发费用	880,197,697.00	612,004,691.23	43.82
经营活动产生的现金流量净额	625,794,918.53	-365,199,793.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,440,050,702.58	81,941,428.50	-1,857.41
筹资活动产生的现金流量净额	-115,765,550.25	1,915,368,923.69	-106.04

营业收入变动原因说明:营业收入的增长分析详见本节“二、经营情况的讨论与分析”相关内容。

营业成本变动原因说明:受量产服务业务增加影响,本期营业成本增加。

销售费用变动原因说明:主要由于公司股份支付费用增加及本期公司收购逐点导致的人员费用增加及所致。

管理费用变动原因说明:主要由于股份支付费用增加影响,本期管理费用较上年增加。

财务费用变动原因说明:主要由于汇兑损益影响所致。

研发费用变动原因说明:主要由于公司股份支付费用增加及人员费用增加及所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加,主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净流出额增加,主要由于购买交易性金融资产金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净流出额增加,主要由于偿还债务支付的现金增加。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,060,369,671.27	11.70	2,007,513,935.38	26.01	-47.18	主要由于报告期内完成逐点半导体

						收购交割，导致现金流出。
交易性金融资产	1,382,506,109.06	15.26	923,813,258.56	11.97	49.65	主要由于公司本期购置结构性存款及银行理财产品所致。
应收票据	137,423.65	0.00	5,825,164.95	0.08	-97.64	由于应收票据到期承兑所致。
预付款项	1,098,750,706.31	12.13	467,228,533.99	6.05	135.16	主要由于本期量产服务业务增加，公司对部分量产供应商预付晶圆等货款所致。
其他应收款	1,732,470.65	0.02	2,962,092.62	0.04	-41.51	由于应收代垫款下降所致。
存货	686,895,025.40	7.58	497,982,733.57	6.45	37.94	由于本期量产服务业务增加，公司存货相应增加。
长期股权投资	1,541,995.62	0.02	1,147,548.56	0.01	34.37	长期股权投资增加是主要由于公司增加联营公司投资所致。
在建工程	478,947.96	0.01	789,635.23	0.01	-39.35	主要为子公司装修工程完工所致。
无形资产	911,059,150.78	10.06	561,755,088.29	7.28	62.18	主要为公司本期收购中产生的无形资产。
开发支出	96,789,958.61	1.07	36,035,385.43	0.47	168.60	由于公司某研发项目本期支出增加。
商誉	606,688,065.60	6.70	177,705,875.93	2.30	241.40	主要为公司在本期收购中形成的商誉所致。
其他非流动资产	128,711,251.79	1.42	205,347,944.25	2.66	-37.32	其他非流动资产随某开发支出项目

						预付材料款在 本期收货而下降。
合同负债	3,156,830,128.68	34.84	1,258,496,354.53	16.31	150.84	主要由于量 产服务业务 增加，本期 末预收货款 较上期末增 加。
应付职工薪酬	130,807,092.77	1.44	200,821,014.04	2.60	-34.86	应付职工薪 酬余额随上 年度奖金发 放而下降。
应交税费	35,867,622.47	0.40	51,795,370.44	0.67	-30.75	随本期税金 支付，应交 税费较上年 末下降。
其他流动负债	19,903,878.03	0.22	61,735,275.67	0.80	-67.76	主要由于待 结算的开发 支出项目材 料款在本期 结算完毕， 因此其他流 动负债余额 下降。
长期应付款	21,949,416.24	0.24	39,392,798.49	0.51	-44.28	随着分期付 款采购无形 资产的款项 的支付，长 期应付款减 少。

其他说明
无

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产26.75（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为29.52%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明
无。

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有人民币 9.73 亿元资产受限，主要系公司抵押临港研发中心固定资产及子公司股权以获取银行借款以及海关进口关税、信用证保证金。

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

(五) 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
93,678.80（注）	0.00	/

注：2025 年内，公司联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿进行投资，并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体的控制权。2026 年 1 月，天遂芯愿根据相关交易协议约定向逐点半导体相关原股东支付收购价款，各方根据交易协议约定完成交割。交割完成后，公司享有天遂芯愿的控制权，天遂芯愿持有逐点半导体 100%股权，逐点半导体纳入公司合并报表范围。报告期投资额中，93,048.80 万元为报告期内并购逐点半导体所涉及的投资金额。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
逐点半导体	专注于移动设备视觉处理芯片、视频转码芯片和 3LCD 投影仪主控芯片及实施方案的开发和设计	收购	95,048.80（注）	公司持有天遂芯愿 40.00% 股权并享有其控制权，天遂芯愿持有逐点半导体 100% 股权，逐点半导体纳入公司合并报表范围。	自有资金、自筹资金	已完成收购	收购完成后，逐点半导体纳入公司合并报表范围，因此不适用。	详情请查阅公司分别于 2025 年 10 月 16 日、2026 年 1 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于联合投资人共同对外投资暨收购逐点半导体（上海）股份有限公司控制权的公告》（公告编号：2025-062）、《关于联合投资人共同

								对外投资暨收购逐点半导体交割完成的公告》（公告编号：2026-001）
合计	/	/	95,048.80	/	/	/		/

注：该投资金额包含公司于 2021 年 8 月对逐点半导体的投资款项 2,000 万元。

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品	35,697.36	31.98	-	-	45,600.00	-45,200.00	-	36,129.34
结构性存款	56,683.96	37.32	-	-	402,800.00	-357,400.00	-	102,121.28
其他非流动金融资产	23,248.37	-2,260.37	-	-	600.00	-	-2,000.00	19,588.00
合计	115,629.69	-2,191.07	-	-	449,000.00	-402,600.00	-2,000.00	157,838.62

证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	处置损益	期末账面价值	会计核算科目

境内外股票	CV.O	CAPSOVISION	1,689.45	自有资金	3,890.33	-1,217.32	-	-	-	-	2,673.01	其他非流动资产
合计	/	/	1,689.45	/	3,890.33	-1,217.32	-	-	-	-	2,673.01	/

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(4) 私募股权投资基金投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例（%）	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）	2026年3月3日	获取投资回报及产业链投资布局机会	2,000.00	600.00	600.00	有限合伙人	2.91	否	其他非流动资产	否	未上市公司股权	-	-
合计	/	/	2,000.00	600.00	600.00	/	/	/	/	/	/	-	-

其他说明

无

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芯原开曼	子公司	控股主体，无实质业务	5万美元	74,591.91	25,149.89	-	-9,032.84	-9,032.84
芯原美国	子公司	IP授权业务、芯片定制业务、技术研发	2,215.8831万美元	65,423.61	5,795.16	13,389.58	2,692.04	2,202.62
芯原香港	子公司	芯片定制业务	20万港币	197,512.15	12,447.59	111,272.54	726.01	174.00
图芯美国	子公司	IP授权业务、技术研发	1,699.7356万美元	28,116.71	28,059.28	3,799.66	-417.80	-421.94
芯原成都	子公司	技术研发	2,000万元	20,878.62	15,095.87	26,068.39	-596.66	-580.17
芯原南京	子公司	IP授权业务、芯片定制业务、技术研发	10,000万元	23,548.95	59.39	18,943.74	-485.08	-478.68
芯原科技	子公司	IP授权业务、芯片定制业务、技术研发	70,000万元	87,909.82	46,859.58	15,631.91	-3,000.08	-2,973.88
天遂芯愿	子公司	控股主体，无实质业务	95,000万元	95,053.54	94,980.94	-	4.17	4.17
逐点半导体	子公司	量产服务业务、技术研发	37,230.192万元	28,857.97	18,069.73	3,230.03	-6,173.69	-6,175.16

芯思原	联营公司	技术研发及IP授权服务	13,333.33万元	1,905.15	-5,419.24	1,909.78	236.79	236.78
-----	------	-------------	-------------	----------	-----------	----------	--------	--------

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
逐点半导体及其相关主体	收购	公司于2026年1月完成对逐点半导体的收购，具体情况请查阅本报告“第四节（四）投资状况分析”。本次收购强化了公司视觉处理领域技术优势，进一步提升公司在端侧和云侧AI ASIC市场竞争力；通过分布式渲染与GPU的结合，加强公司在端侧和云侧AI ASIC的布局。
VeriSilicon Microelectronics (Hong Kong) Limited	注销	对公司整体生产经营和业绩无重大影响

其他说明

□适用 √不适用

（八）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司核心技术人员的认定情况说明

☒适用 ☐不适用

公司的核心技术人员需同时满足以下三项条件：（1）拥有深厚且与集成电路行业相匹配的学历背景及从业经历；（2）担任公司研发部门、技术部门或管理部门的主要负责人；（3）主持或参与公司核心技术相关的研发项目及专利申请，并起到核心及关键作用。

基于上述标准，截至报告期末，公司共有核心技术人员 5 名，分别为：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、汪志伟、张慧明、杨海。报告期内，公司核心技术人员未发生变化。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
2026 年 1 月 26 日，公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票完成归属登记手续，归属股票数量 57,000 股，上市流通时间 2026 年 2 月 2 日。	上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（公告编号： 2026-005）

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

立足国家乡村振兴总体战略，公司将消费帮扶作为履行社会责任的重要举措，精准助力县域乡村产业长效发展。报告期内，公司定向采购四川眉山仁寿县、甘孜德格县等地特色助农产品，采购总额达 32.83 万元。相关助农产品用作员工福利发放，既丰富了职工的福利体系，落实了人文关怀，又拓宽了当地农户农产品销路，带动了农户增收，同步实现了社会效益落地与企业人文关怀建设的双重成效。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	VeriSilicon Limited	1、公司实现盈利后，本企业方可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但该等减持应当遵守承诺函的其他承诺及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的其他规定。2、本企业减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	2019 年 9 月 10 日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用
	股份限售	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）	1、离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首发前股份，也不由公司回购该等股份。2、公司实现盈利后，本人方可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但该等减持应当遵守承诺函的其他承诺内容及《上市规则》的其他规定。3、在本人担任公司董事或高级	2019 年 9 月 10 日	是	本人担任公司董事或高级管理人员期间和离职	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%。若本人不再担任公司董事或高级管理人员，则自不再担任上述职位之日起半年内，本人将不转让本人持有的公司股份。4、本人减持公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人已作出的各项承诺。5、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。			后 6 个月内；持有公司股份期间			
	其他	香港富策、国家集成电路基金、兴橙投资方及国开基金、共青城原厚、共青城原德、VeriVision LLC	1、本企业减持所持有的公司股份的方式将遵守相关监管规则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。2、本企业减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	2019 年 9 月 10 日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用
	其他	共青城原天	1、本企业减持所持有的公司股份的方式将符合相关监管规则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。2、本企业减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的	2019 年 9 月 10 日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			各项承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份锁定或减持有新的规定，则本企业在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。						
	其他	Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、陈晓飞、范灏成、钱哲弘、汪洋、David Jarmon、石雯丽、张慧明	1、公司实现盈利后，本人自当年年度报告披露后次日起方可减持首发前股份，但该等减持应当遵守承诺函的其他承诺内容及《上市规则》的其他规定。2、若本人在前述期间内因离职、职务变动等原因不再担任公司的董事、监事、高级管理人员和/或核心技术人员，本人亦将继续遵守前述承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对上市公司股份锁定或减持有新的规定，则本人在锁定或减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	张慧明：2022年9月10日、其他：2020年8月16日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、香港富策、兴橙投资方	1、截至承诺函出具之日，本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与公司或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事相关业务。2、本企业/本人及本企业/本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会：（1）单独或与第	2019年9月10日	是	自2019年9月10日至承诺方不再是单独或与关联方合计持	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			三方以任何形式直接或间接从事与公司或其下属企业目前及今后进行的主营业务构成具有重大不利影响的同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动（以下简称“竞争业务”）； （2）不会直接或间接控股、收购从事竞争业务的企业（以下简称“竞争企业”），或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、股权或权益。3、承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业/本人不再是单独或与关联方合计持有公司 5%以上股份的股东或其一致行动人；（2）公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对承诺函项下某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。4、“下属企业”：就承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行股份或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，或（3）有权控制董事会之组成或以其他方式控制的任何其他企业或实体（无论是否具有法人资格），以及该其他企业或实体的下属企业。			有公司 5%以上股份的股东或其一致行动人、公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外），或国家规定对承诺函项下某项承诺的内容无要求时，相			

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
						应部分自行终止			
	解决同业竞争	国家集成电路基金	1、截至承诺函出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外直接或间接从事与公司或其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。2、本企业及本企业直接或间接控制的下属企业承诺将不会：不会通过设立或收购等方式直接或间接取得竞争企业的控制权，或以其他方式拥有竞争企业的控制性股份、控股性股权或控制性权益。3、承诺函自出具之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：（1）本企业不再是公司 5%以上股份的股东或其一致行动人；（2）公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因任何原因暂停买卖除外）；（3）国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。4、“下属企业”：就承诺函的任何一方而言，指由其（1）持有或控制 50%或以上已发行的股本或享有 50%或以上的投票权（如适用），或（2）有权享有 50%或以上的税后利润，以及该其他企业或实体的下属企业。	2019 年 9 月 10 日	是	自 2019 年 9 月 10 日至承诺方不再是单独或与关联方合计持有公司 5%以上股份的股东或其一致行动人、公司的股票终止在任何证券交易所上市（但公司的股票因	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
						任何原因暂停买卖除外），或国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止			
	解决关联交易	VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、国家集成电路基金、香港富策、兴橙投资方及国开基金	1、在不对公司及其他股东的利益构成不利影响的前提下，本企业/本人将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。2、对于正常经营范围内或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业/本人将与公司依法签订规范的交易协议，并按照有关法律、法规、规范性文件和届时有有效的《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定履行批准程序，并保证该等关联交易均将严格遵照公允定价的原则实施。3、本企业/本人将严格按照相关规定履行必要的关联方回避表决等义务，履行批准关联交易的法定审批程序和信息披露义务。4、保证	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			不利用关联交易非法转移公司的资金、利润或从事其他损害公司或其他股东、债权人利益的行为。						
	分红	公司	公司承诺将严格执行 2018 年年度股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配政策的规定，实施积极地利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	Jovial、浦东新兴	1、本企业减持所持有的公司股份的方式将符合相关监管规则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。2、本企业减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本企业已作出的各项承诺。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股份减持有新的规定，则本企业在减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。	2019 年 9 月 10 日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用
	其他	Margaret Tsai Cheng	1、本人减持所持有的公司股份的方式将符合相关监管规则的规定，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。2、本人减持所持有的公司股份的价格将根据当时的二级市场价格确定，并符合监管规则的规定以及本人已作出的各项承诺（如有）。3、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时，相应部分自行终止。如果监管规则对公司股	2019 年 9 月 10 日	是	持有公司股份期间	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			份减持有新的规定，则本人在减持公司股份时将执行届时适用的最新监管规则。						
	其他	公司	1、公司向中国证监会、证券交易所及其他证券监管部门提交的本次发行上市的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在中国证监会等有权部门对违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。3、公司愿意承担违背上述承诺而产生的全部法律责任。	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司首次申报时的董事、监事、高级管理人员	1、公司向中国证监会、证券交易所及其他证券监管部门提交的本次发行上市的申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在中国证监会等有权部门对违法事实作出最终认定后依法赔偿投资者损失。3、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，如经中国证监会或人民法院等有权部门作出公司构成	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			欺诈发行或重大信息披露违法的最终认定或生效判决且本人对该等违法负有个人责任的，本人将在该等认定或判决作出后五个工作日内按照《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》的规定及中国证监会等有关部门的决定采取补救措施，承担相应的法律责任。						
	其他	公司	1、公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在监管部门认定的有关违法事实的当日进行公告，并在5个交易日内根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施。	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	VeriSilicon Limited	1、公司不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。2、若因公司本次发行上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将督促公司在证监会或人民法院等有关部门作出公司存在上述违法事实的最终认定或生效判决后五个工作日内启动股份购回程序，根据《科创板上市公司持续监管办法	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			（试行）》《上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定召开董事会、拟定股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并报相关主管部门批准或备案；督促公司依法回购本次公开发行的全部新股，回购价格将按照发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转赠股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规及《公司章程》等规定的程序实施。同时，本企业将根据上述股份回购措施的规定，依法购回公司上市后本企业减持的原限售股份，回购价格为市场价格或经证券监督管理部门认可的其他价格。在实施上述股份回购时，如相关法律、法规及《公司章程》等另有规定的，从其规定。						
	其他	公司	若公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在监管部门认定的有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施，具体回购方案如下：1、在监管部门认定的有关违法事	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			实之日起 5 个交易日内，公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知、进行公告；公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；2、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；3、回购数量：首次公开发行的全部新股；4、回购价格：公司股票已发行但尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司股票已上市的，回购价格不低于相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价及首次公开发行股票时的发行价格（发生派发股利、转增股本等除息、除权行为的，上述发行价格亦将作相应调整）。其中，前 10 个交易日公司股票交易均价计算公式为：相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易均价=相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总额/相关董事会决议公告日前 10 个交易日公司股票交易总量。						
	其他	公司	公司承诺将加强募集资金的管理和运用，确保募集资金效益；扩大业务规模，全面提升公司的综合实力和核心竞争力，降低财务风险，增强公司盈利能力，充分保护中小投资者的利益，采用多种措施防范即期回报被摊薄的风险，	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			提高回报能力，具体承诺如下：1、积极实施募集资金投资项目，进一步加强研发投入，尽快获得预期投资回报公司已对本次发行上市的募集资金投资项目进行可行性研究论证，符合行业发展趋势和公司未来发展规划，若本次募集资金投资项目顺利实施，将有利于提高公司的盈利能力。公司将积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资回报，降低上市后即期回报被摊薄的风险。2、大力拓展现有业务，开拓新市场和新领域公司自成立以来，专注于为客户提供一站式芯片定制和半导体 IP 授权服务。未来公司将进一步扩大现有业务的市场规模，开拓新市场和新领域，并不断开发新技术新产品，使公司产品在技术水平上保持国内领先水平，从而持续提升公司的盈利能力。3、加强经营管理和内部控制，降低公司运营成本，提升经营效率公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面控制公司经营和管控风险。同时，公司在日常经营中细化项目预算的编制，降低公司运营成本，提升公司业绩。4、优化投资回报机制公司将建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	董事孙国栋：2021年8月30日、高级管理人员汪志伟：2021年2月1日、其他董事、高级管理人员：2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	1、如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序，下同）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；（4）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（5）如违反相关承诺给投资者造成损失并经中国证监会等有权部门	2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			认定应承担赔偿责任的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，公司将继续履行该等承诺。2、如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。						
	其他	国家集成电路基金	1、如本企业非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（3）不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（4）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（5）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。如该等已违反的	2019 年 9 月 10 日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			承诺仍可继续履行，本企业将继续履行该等承诺。2、如本企业因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。						
	其他	董事、作出承诺的时任监事、高级管理人员、VeriSilicon Limited、香港富策、兴橙投资方、浦东新兴、Jovial、共青城原天、共青城原厚、共青城原德、VeriVision LLC、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Margaret Tsai	1、如本企业/本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）本企业/本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）及时、充分披露相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（3）对该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员调减或停发薪酬或津贴；（4）不得转让公司的股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（5）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并同意将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（6）如违反相关承诺给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者的损失。	张慧明：2022年9月10日、董事孙国栋：2021年8月30日、高级管理人员汪志伟：2021年2月1日、其他主体：2019年9月10日	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		Cheng、张慧明、范灏成	如该等已违反的承诺仍可继续履行，本企业/本人将继续履行该等承诺。2、如本企业/本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。						
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由公司董事或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2023 年 12 月 22 日	否	长期	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺（注）	其他	公司	公司承诺于终止重大资产重组公告披露之日起至少一个月 内不再筹划重大资产重组。	2025 年 12 月 13 日	是	于终止重大资产重组公告披露之日起	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
						至少一个 月内			

注：2025 年 12 月 13 日，公司披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2025-078），公司董事会同意终止公司拟通过发行股份及支付现金方式向胡振波等 31 名交易对方购买其合计持有的芯来智融半导体科技（上海）有限公司 97.0070%股权并募集配套资金的事项。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十次会议暨 2025 年年度董事会，并于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》。详情请查阅公司于 2026 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

报告期内，预计的日常关联交易发生额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	报告期内发生金额
向关联人购买原材料	芯思原	6,500.00	1,828.39
	Alphawave	3,000.00	930.03
	威视芯	700.00	-
	湖南越摩先进半导体有限公司	2,000.00	1,033.63
	Silicon Box Pte Ltd	15,000.00	114.44
	鹏瞰	4,000.00	-

	至成微	3,000.00	-
	迈矽科	1,500.00	-
	小计	35,700.00	3,906.49
向关联人销售产品、商品	芯思原	2,500.00	0.62
	迈矽科	3,000.00	-
	至成微	2,500.00	139.24
	兆易创新（注 1）	3,500.00	21.48
	广州增芯科技有限公司	2,000.00	-
	上海华力集成电路制造有限公司	4,000.00	162.49
	鹏瞰	2,500.00	-
	上海开放处理器产业创新中心	500.00	-
	华虹半导体（无锡）有限公司	1,000.00	-
	FLC Tecnology Group Inc.	1,000.00	-
	小计	22,500.00	323.83
	合计	58,200.00	4,230.32

注 1：公司原监事 Zhiwei Wang（王志伟）在过去 12 个月内曾担任兆易创新董事，自 2026 年 6 月 10 日起，其离任兆易创新董事将超过 12 个月，在此之后，公司与兆易创新发生的交易不包括在对其的预计额度及发生金额内。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0							
公司及其子公司对子公司的担保情况															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保			
芯原股份	公司本部	芯原香港、芯原开曼	全资子公司	1,000万美元	2020年10月30日	2020年10月30日	至芯原香港、芯原开曼的订单履行完毕或担保人在本担保项下担保人的总付款额达到担保限额	连带责任担保	否	否	/	否			
芯原股份	公司本部	芯原香港	全资子公司	1,300万美元	2021年4月20日	2021年4月20日	不适用	连带责任担保	否	否	/	否			

芯原股份	公司本部	芯原南京	全资子公司	30万元人民币	2021年4月15日	2021年4月15日	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年	连带责任担保	否	否	/	否
芯原股份	公司本部	芯原科技	全资子公司	25,000万元人民币	2022年7月4日	2022年7月4日	借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年	连带责任担保	否	否	/	否
芯原股份	公司本部	芯原海南	全资子公司	1,300万美元	2024年2月27日	2024年3月1日	2027年2月28日	连带责任担保	否	否	/	否
芯原股份	公司本部	芯原香港	全资子公司	300万美元	2024年12月1日	2024年12月1日	主合同所约定的债务履行期届满之日起两年	连带责任担保	否	否	/	否
报告期内对子公司担保发生额合计						-						
报告期末对子公司担保余额合计（B）						5.16						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）						5.16						
担保总额占公司净资产的比例(%)						17.64						
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						-						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						1.77						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						-						
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1.77						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无						
担保情况说明						无						

注：直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保（D）均为公司向全资子公司提供的担保。

(三)其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、 募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额（1）	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2）	超募资金总额（3）=（1）-（2）	截至报告期末累计投入募集资金总额（4）	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5）	截至报告期末募集资金累计投入进度（%）（6）=（4）/（1）	截至报告期末超募资金累计投入进度（%）（7）=（5）/（3）	本年度投入金额（8）	本年度投入金额占比（%）（9）=（8）/（1）	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2025 年 6 月 20 日	180,685.69	178,026.21	180,685.69	-	67,310.98	-	37.81	-	10,402.91	5.84	-
合计	/	180,685.69	178,026.21	180,685.69		67,310.98	-	/	/		/	-

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	AIGC 及智慧出行领域 Chiplet 解决方案平台研发项目	研发	是	否	107,158.50	6,473.21	35,326.12	32.97	2029年4月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
向特定对象发行股票	面向 AIGC、图形处理等场景的新一代 IP 研发及产业化项目	研发	是	否	70,867.71	3,929.70	31,984.86	45.13	2029年4月	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	/	/	/	178,026.21	10,402.91	67,310.98	/	/	/	/	/	/	/	/	

注 1：表格中募集资金计划投资总额以扣减发行费用后的募集资金净额列示。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

2025 年 7 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高公司运营管理效率、加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换。

2026 年 1-6 月，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，置换金额为 7,638.51 万元，募集资金置换已按照公司内部流程执行，并均在自有资金支付后六个月内实施，符合相关法律法规的规定。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的 有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否 超出授权额度
2026 年 3 月 30 日	100,000 (含)	2026 年 3 月 30 日	董事会审议通过之日起 12 个月内或至公司董事会/股东会（视届时审批权限）审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准）	84,000	否

其他说明

无

4、 其他

□适用 √不适用

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

□适用 √不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

□适用 √不适用

十三、 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	525,858,273	100.00				57,000	57,000	525,915,273	100.00
1、人民币普通股	525,858,273	100.00				57,000	57,000	525,915,273	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	525,858,273	100.00				57,000	57,000	525,915,273	100.00

2、 股份变动情况说明

☒适用 ☐不适用

2026 年 2 月 2 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划下 57,000 股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的归属登记工作并上市流通，该部分股份为无限售条件流通股份，公司新增股本 57,000 股，公司股本总数增加至 525,915,273 股，详情请查阅公司于 2026 年 1

月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-005）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

（二）限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	53,346
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

存托凭证持有人数量

☐适用 ☒不适用

（二） 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

☐适用 ☒不适用

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股 份数 量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
VeriSilicon Limited	0	59,907,001	11.39	0	0	无	0	境外 法人
富策控股有限公司	0	34,454,307	6.55	0	0	无	0	境外 法人
国家集成电路产业 投资基金股份有限 公司	-7,933,831	26,790,441	5.09	0	0	无	0	国有 法人

香港中央结算有限公司	-1,072,500	11,416,541	2.17	0	0	无	0	境外法人
嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）	-9,994,900	10,511,010	2.00	0	0	无	0	其他
DAI, WAYNE WEI-MING	0	8,742,507	1.66	0	0	无	0	境外自然人
嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）	-8,302,350	8,733,072	1.66	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	-6,640,241	7,754,243	1.47	0	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	-2,013,359	6,353,648	1.21	0	0	无	0	其他
上海浦东新兴产业投资有限公司	-5,200,000	5,502,140	1.05	0	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
VeriSilicon Limited	59,907,001	人民币普通股	59,907,001					
富策控股有限公司	34,454,307	人民币普通股	34,454,307					
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	26,790,441	人民币普通股	26,790,441					
香港中央结算有限公司	11,416,541	人民币普通股	11,416,541					
嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）	10,511,010	人民币普通股	10,511,010					
DAI, WAYNE WEI-MING	8,742,507	人民币普通股	8,742,507					
嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）	8,733,072	人民币普通股	8,733,072					
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	7,754,243	人民币普通股	7,754,243					
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,353,648	人民币普通股	6,353,648					
上海浦东新兴产业投资有限公司	5,502,140	人民币普通股	5,502,140					
前十名股东中回购专户情况说明	无							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、嘉兴时兴创业投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动人； 2、VeriSilicon Limited 与 DAI, WAYNE WEI-MING 构成一致行动人； 3、未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
汪志伟	高级管理人员、核心技术人员	209,263.00	221,763.00	12,500.00	第二类限制性股票归属

张慧明	核心技术人员	124,566.00	94,426.00	-30,140.00	二级市场交易
-----	--------	------------	-----------	------------	--------

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1、 股票期权

☐适用 ☒不适用

2、 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3、 第二类限制性股票

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

六、特别表决权股份情况

☐适用 ☒不适用

七、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,060,369,671.27	2,007,513,935.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,382,506,109.06	923,813,258.56
衍生金融资产			
应收票据	七、4	137,423.65	5,825,164.95
应收账款	七、5	1,452,039,246.55	1,202,723,032.12
应收款项融资			
预付款项	七、8	1,098,750,706.31	467,228,533.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	1,732,470.65	2,962,092.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	686,895,025.40	497,982,733.57
其中：数据资源			
合同资产	七、6	370,276,543.98	353,328,001.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	272,666,126.06	224,758,317.40
流动资产合计		6,325,373,322.93	5,686,135,069.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,541,995.62	1,147,548.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	195,879,966.12	232,483,651.33
投资性房地产			

固定资产	七、21	708,182,998.06	711,517,557.22
在建工程	七、22	478,947.96	789,635.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	57,468,108.14	74,742,039.12
无形资产	七、26	911,059,150.78	561,755,088.29
其中：数据资源			
开发支出		96,789,958.61	36,035,385.43
其中：数据资源			
商誉	七、27	606,688,065.60	177,705,875.93
长期待摊费用	七、28	28,324,675.57	29,897,884.59
递延所得税资产	七、29		
其他非流动资产	七、30	128,711,251.79	205,347,944.25
非流动资产合计		2,735,125,118.25	2,031,422,609.95
资产总计		9,060,498,441.18	7,717,557,679.75
流动负债：			
短期借款	七、32	89,045,269.45	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	411,991,356.88	325,871,180.57
预收款项			
合同负债	七、38	3,156,830,128.68	1,258,496,354.53
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	130,807,092.77	200,821,014.04
应交税费	七、40	35,867,622.47	51,795,370.44
其他应付款	七、41	80,389,080.67	74,821,858.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	594,406,065.61	553,152,361.60
其他流动负债	七、44	19,903,878.03	61,735,275.67
流动负债合计		4,519,240,494.56	2,526,693,415.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	970,876,322.35	1,124,313,358.07
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	30,140,318.96	39,651,622.64
长期应付款	七、48	21,949,416.24	39,392,798.49

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债	七、52	592,800,000.00	570,000,000.00
非流动负债合计		1,615,766,057.55	1,773,357,779.20
负债合计		6,135,006,552.11	4,300,051,194.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	525,915,273.00	525,858,273.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	6,046,130,516.99	5,910,988,929.57
减：库存股	七、56	24,836,121.01	24,836,121.01
其他综合收益	七、57	-65,442,385.95	-50,354,217.62
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-3,556,275,393.96	-2,944,150,379.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,925,491,889.07	3,417,506,484.87
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,925,491,889.07	3,417,506,484.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,060,498,441.18	7,717,557,679.75

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：赵春蓉 会计机构负责人：沙乐

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		872,738,095.70	867,353,979.19
交易性金融资产		1,382,506,109.06	891,800,594.69
衍生金融资产			
应收票据		137,423.65	5,825,164.95
应收账款	十九、1	1,858,892,477.25	1,775,803,698.37
应收款项融资			
预付款项		840,842,404.95	475,424,178.91
其他应收款	十九、2	1,441,786.03	1,430,087.80
其中：应收利息			
应收股利			
存货		135,779,495.81	173,680,293.62
其中：数据资源			

合同资产		290,729,795.93	271,401,723.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		228,009,996.00	196,230,621.87
流动资产合计		5,611,077,584.38	4,658,950,342.94
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	1,730,888,777.95	1,442,984,776.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		169,149,817.94	193,580,341.86
投资性房地产			
固定资产		52,325,797.28	58,560,658.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,065,673.80	33,738,154.61
无形资产		335,553,147.22	363,930,212.59
其中：数据资源			
开发支出		96,789,958.61	36,035,385.43
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		4,465,893.00	5,407,700.21
递延所得税资产			
其他非流动资产		111,520,674.13	105,593,005.34
非流动资产合计		2,521,759,739.93	2,239,830,235.34
资产总计		8,132,837,324.31	6,898,780,578.28
流动负债：			
短期借款		50,029,305.56	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		399,874,941.96	387,108,857.54
预收款项			
合同负债		2,452,819,944.58	873,707,807.78
应付职工薪酬		49,095,332.65	83,300,579.39
应交税费		4,963,289.12	26,843,232.90
其他应付款		42,370,271.69	49,097,275.69
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		464,439,218.00	406,185,264.29
其他流动负债		13,850,041.62	53,827,149.19
流动负债合计		3,477,442,345.18	1,880,070,166.78
非流动负债：			
长期借款		850,547,653.78	965,588,044.19
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,962,172.80	13,846,363.39
长期应付款		7,013,140.74	15,433,102.75
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
衍生金融负债		258,923,972.58	216,798,128.61
非流动负债合计		1,124,446,939.90	1,211,665,638.94
负债合计		4,601,889,285.08	3,091,735,805.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		525,915,273.00	525,858,273.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,511,949,201.79	4,376,807,614.37
减：库存股		24,836,121.01	24,836,121.01
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-1,482,080,314.55	-1,070,784,993.80
所有者权益（或股东权益）合计		3,530,948,039.23	3,807,044,772.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,132,837,324.31	6,898,780,578.28

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）

主管会计工作负责人：赵春蓉

会计机构负责人：沙乐

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		1,863,539,395.68	973,799,834.20
其中：营业收入	七、61	1,863,539,395.68	973,799,834.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,450,591,597.44	1,307,328,028.06
其中：营业成本	七、61	1,279,465,095.96	551,912,841.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,676,659.42	4,240,112.18
销售费用	七、63	85,681,139.60	62,458,562.68
管理费用	七、64	133,367,306.27	58,636,060.05
研发费用	七、65	880,197,697.00	612,004,691.23
财务费用	七、66	67,203,699.19	18,075,760.20
其中：利息费用		46,688,865.21	20,804,567.35
利息收入		3,228,833.17	6,398,490.25
加：其他收益	七、67	24,954,580.56	28,445,465.14
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	8,766,573.10	846,911.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-97,829.48	-320,785.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-21,910,834.71	-214,044.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-19,471,465.04	-5,166,785.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-2,719,489.76	663,330.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-1,076.67	1,583.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-597,433,914.28	-308,951,733.80
加：营业外收入	七、74	574,205.13	607,025.26
减：营业外支出	七、75	94,504.24	34,365.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-596,954,213.39	-308,379,073.86
减：所得税费用	七、76	15,170,801.50	11,469,493.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-612,125,014.89	-319,848,567.48
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-612,125,014.89	-319,848,567.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-612,125,014.89	-319,848,567.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-15,088,168.33	64,571.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-15,088,168.33	64,571.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-15,088,168.33	64,571.39
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-627,213,183.22	-319,783,996.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-627,213,183.22	-319,783,996.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-1.16	-0.64
（二）稀释每股收益（元/股）		-1.16	-0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）

主管会计工作负责人：赵春蓉

会计机构负责人：沙乐

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	1,050,373,540.74	567,178,602.59
减：营业成本	十九、4	656,496,353.43	338,968,107.35
税金及附加		641,942.30	421,903.71
销售费用		30,729,506.64	32,403,222.50
管理费用		78,516,618.95	28,096,714.76
研发费用		620,367,090.52	465,643,154.04
财务费用		39,068,246.43	13,426,932.15

其中：利息费用		19,313,494.46	13,995,966.56
利息收入		1,544,260.46	3,890,064.14
加：其他收益		22,922,271.13	18,850,289.95
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	8,620,980.35	733,661.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-97,829.48	-320,785.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-51,850,853.52	-82,459.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,052,728.41	-5,257,189.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,931,432.40	299,651.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-406,737,980.38	-297,237,477.61
加：营业外收入		-53,950.00	0.00
减：营业外支出		9,119.46	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-406,801,049.84	-297,237,477.61
减：所得税费用		4,494,270.91	1,546,339.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-411,295,320.75	-298,783,816.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-411,295,320.75	-298,783,816.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-411,295,320.75	-298,783,816.91
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）

主管会计工作负责人：赵春蓉

会

计机构负责人：沙乐

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,670,369,278.00	1,041,721,298.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,159,836.67	615,419.13
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	33,955,875.36	27,136,196.61
经营活动现金流入小计		3,705,484,990.03	1,069,472,913.76
购买商品、接受劳务支付的现金		1,980,970,913.46	575,849,955.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		861,881,928.29	680,004,569.27
支付的各项税费		55,170,887.36	45,190,476.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	181,666,342.39	133,627,706.22
经营活动现金流出小计		3,079,690,071.50	1,434,672,707.62
经营活动产生的现金流量净额		625,794,918.53	-365,199,793.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	七、78	8,544,417.40	1,167,696.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,460.01	1,583.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	4,076,000,000.00	851,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,084,558,877.41	852,169,279.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	80,680,249.07	96,227,851.12
投资支付的现金	七、78	6,300,000.00	0.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	七、78	883,629,330.92	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	4,554,000,000.00	674,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,524,609,579.99	770,227,851.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,440,050,702.58	81,941,428.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,196,210.00	1,826,031,444.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		278,900,000.00	321,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		281,096,210.00	2,147,031,444.73
偿还债务支付的现金		311,845,017.36	160,708,581.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	85,016,742.89	70,953,939.52

筹资活动现金流出小计		396,861,760.25	231,662,521.04
筹资活动产生的现金流量净额		-115,765,550.25	1,915,368,923.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,385,969.71	-3,041,044.53
五、现金及现金等价物净增加额		-947,407,304.01	1,629,069,513.80
加：期初现金及现金等价物余额		2,006,424,465.77	642,835,328.05
六、期末现金及现金等价物余额		1,059,017,161.76	2,271,904,841.85

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：赵春蓉 会计机构负责人：沙乐

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,641,880,761.77	490,466,168.71
收到的税费返还		0.00	615,419.13
收到其他与经营活动有关的现金		25,447,479.98	20,042,916.34
经营活动现金流入小计		2,667,328,241.75	511,124,504.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,105,014,340.28	455,036,459.21
支付给职工及为职工支付的现金		297,713,025.58	279,275,293.19
支付的各项税费		15,155,567.48	9,254,926.92
支付其他与经营活动有关的现金		429,587,361.16	300,892,442.32
经营活动现金流出小计		1,847,470,294.50	1,044,459,121.64
经营活动产生的现金流量净额		819,857,947.25	-533,334,617.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,073,824.65	1,054,446.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,840,000,000.00	770,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,848,073,824.65	771,054,446.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,812,547.36	77,404,106.76
投资支付的现金		211,300,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,350,000,000.00	625,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,605,112,547.36	702,404,106.76
投资活动产生的现金流量净额		-757,038,722.71	68,650,339.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,196,210.00	1,826,031,444.73
取得借款收到的现金		248,910,000.00	321,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		251,106,210.00	2,147,031,444.73
偿还债务支付的现金		264,318,612.49	128,501,212.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		44,121,017.66	26,922,793.76
筹资活动现金流出小计		308,439,630.15	155,424,006.01
筹资活动产生的现金流量净额		-57,333,420.15	1,991,607,438.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-101,749.20	-1,489,717.77
五、现金及现金等价物净增加额		5,384,055.19	1,525,433,443.29
加：期初现金及现金等价物余额		867,351,676.83	480,892,970.34
六、期末现金及现金等价物余额		872,735,732.02	2,006,326,413.63

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）
 会计机构负责人：沙乐

主管会计工作负责人：赵春蓉 会

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、 上年 期末 余额	525,858,273.0 0				5,910,988,929.5 7	24,836,121.0 1	- 50,354,217.62				- 2,944,150,379.07		3,417,506,484.87
加： 会计 政策 变更													
前 期差 错更 正													
其 他													
二、 本年 期初 余额	525,858,273.0 0				5,910,988,929.5 7	24,836,121.0 1	- 50,354,217.62				- 2,944,150,379.07		3,417,506,484.87
三、 本期 增减 变动	57,000.00				135,141,587.42		- 15,088,168.33				-612,125,014.89		-492,014,595.80

金额 （减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额						15,088,168.33 ⁻				-612,125,014.89		627,213,183.22 ⁻		627,213,183.22 ⁻
（二）所有者投入和减少资本	57,000.00				135,141,587.42							135,198,587.42		135,198,587.42
1. 所有者投入的普通股	57,000.00				2,412,069.00							2,469,069.00		2,469,069.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所					132,537,241.88							132,537,241.88		132,537,241.88

有者 权益 的金 额															
4. 其 他					192,276.54								192,276.54		192,276.54
（三） 利 润分 配															
1. 提 取盈 余公 积															
2. 提 取一 般风 险准 备															
3. 对 所有 者 （或 股 东） 的分 配															
4. 其 他															
（四） 所 有者 权益															

内部 结转															
1. 资 本公 积转 增资 本 （或 股 本）															
2. 盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本）															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结															

									准 备					
一、上年期末 余额	500,355,082.00				4,089,816,091.73		-51,516,446.79				-2,416,337,051.78		2,122,317,675.16	2,122,317,675.16
加：会计政策 变更														
前期差错 更正														
其他														
二、本年期初 余额	500,355,082.00				4,089,816,091.73		-51,516,446.79				-2,416,337,051.78		2,122,317,675.16	2,122,317,675.16
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	25,358,191.00				1,774,602,143.83		64,571.39				-319,848,567.48		1,480,176,338.74	1,480,176,338.74
（一）综合收 益总额							64,571.39				-319,848,567.48		-319,783,996.09	-319,783,996.09
（二）所有者 投入和减少资 本	25,358,191.00				1,774,602,143.83								1,799,960,334.83	1,799,960,334.83
1. 所有者投入 的普通股	25,358,191.00				1,774,082,242.06								1,799,440,433.06	1,799,440,433.06
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					196,262.09								196,262.09	196,262.09
4. 其他					323,639.68								323,639.68	323,639.68
（三）利润分 配														
1. 提取盈余公 积														

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	525,713,273.00				5,864,418,235.56		-51,451,875.40				-2,736,185,619.26		3,602,494,013.90		3,602,494,013.90

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）

主管会计工作负责人：赵春蓉

会计机构负责人：沙乐

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	525,858,273.00				4,376,807,614.37	24,836,121.01				-1,070,784,993.80	3,807,044,772.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	525,858,273.00				4,376,807,614.37	24,836,121.01				-1,070,784,993.80	3,807,044,772.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	57,000.00				135,141,587.42					-411,295,320.75	-276,096,733.33
（一）综合收益总额										-411,295,320.75	-411,295,320.75
（二）所有者投入和减少资本	57,000.00				135,141,587.42						135,198,587.42
1．所有者投入的普通股	57,000.00				2,412,069.00						2,469,069.00
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					132,537,241.88						132,537,241.88
4．其他					192,276.54						192,276.54
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											

（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	525,915,273.00				4,511,949,201.79	24,836,121.01				1,482,080,314.55	3,530,948,039.23

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	500,355,082.00				2,555,634,776.53					-633,678,365.66	2,422,311,492.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	500,355,082.00				2,555,634,776.53					-633,678,365.66	2,422,311,492.87

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,358,191.00				1,774,602,143.83					-298,783,816.91	1,501,176,517.92
（一）综合收益总额										-298,783,816.91	-298,783,816.91
（二）所有者投入和减少资本	25,358,191.00				1,774,602,143.83						1,799,960,334.83
1. 所有者投入的普通股	25,358,191.00				1,774,082,242.06						1,799,440,433.06
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					196,262.09						196,262.09
4. 其他					323,639.68						323,639.68
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	525,713,273.00				4,330,236,920.36					-932,462,182.57	3,923,488,010.79

公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）

主管会计工作负责人：赵春蓉

会计机构负责人：沙乐

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“本公司”或“芯原上海”), 原名为思略微电子(上海)有限公司。思略微电子(上海)有限公司系由美国思略科技有限公司于 2001 年 8 月 21 日投资设立的有限责任公司(外国法人独资), 中华人民共和国外商投资企业批准证书编号为商外资沪张独资字(2001)1512 号。本公司于 2001 年 8 月 21 日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为 310115400082864(浦东)企业法人营业执照。2002 年 7 月, 母公司变更为开曼群岛设立的 VeriSilicon Holdings Co., Ltd (以下简称“VeriSilicon Cayman”)并更名为芯原微电子(上海)股份有限公司。2016 年 7 月份本公司再次发生股权变更, 母公司由 VeriSilicon Cayman 变更为 VeriSilicon Limited, 并于 2016 年 8 月取得统一社会信用代码为 91310115703490552J 的企业法人营业执照。本公司注册地址为中国(上海)自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A, 法定代表人为戴伟民先生, 注册资本为美元 9,500,000.00 元, 实收资本为美元 9,500,000.00 元, 经营期限为 30 年。截至 2026 年 6 月 30 日, 本公司注册资本变更为人民币 525,915,273.00 元, 累计实收股本为人民币 525,915,273.00 元。芯原上海、VeriSilicon Cayman 以及其所属子公司合称为芯原集团或本集团。

根据本公司于 2019 年 8 月 20 日召开的股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议, 并于 2020 年 7 月 22 日取得中国证监会同意注册(证监许可[2020]1537 号)文件。本公司于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板首发上市, 公开发行 4,831.9289 万股人民币普通股股票, 本公司变更注册资本为人民币 483,192,883.00 元。本次发行价格为每股人民币 38.53 元, 募集资金总额为人民币 1,861,742,205.17 元, 扣除本次发行费用后, 增加股本人民币 48,319,289.00 元, 增加资本公积人民币 1,625,707,530.43 元。

根据本公司于 2024 年 1 月 10 日召开的第一次临时股东大会会议及 2024 年 12 月 25 日召开的第三次临时股东大会会议审议通过的向特定对象发行 A 股股票的相关议案, 并于 2025 年 3 月 20 日取得中国证监会同意注册(证监许可[2025] 561 号)文件。本公司于 2025 年 6 月 20 日向特定对象发行 24,860,441 股人民币普通股股票, 本公司变更注册资本为人民币 525,713,273.00 元。本次发行价格为每股人民币 72.68 元, 募集资金总额为人民币 1,806,856,851.88 元, 扣除本次发行费用后, 增加股本人民币 24,860,441.00 元, 增加资本公积人民币 1,755,401,684.56 元。

本公司实际控制人情况详见附注十四。

本集团实际从事的主要经营活动为集成电路的设计、调试、维护, 为集成电路制造和设计厂商提供建模和建库服务, 转让自有研发成果, 并提供相关技术咨询和技术服务。

本集团合并财务报表范围参见附注十“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2026 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

详见以下章节。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

□适用 √不适用

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

6.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

6.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关的管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

7.1 控制的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

7.2 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团未发生共同经营的情形。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

10.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益中的“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入所有者权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量(金融资产和金融负债的公允价值的确定

方法参见附注二中记账基础和计价原则的相关披露)。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产和其他非流动资产。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期(或无固定期限)且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

11.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止

确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。除上述情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确认利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

11.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产、其他非流动资产和合同资产等项目以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收账款、应收票据和合同资产等项目，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

11.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

(1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

(2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。

(3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(4) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。

(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(6) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(7) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(8) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30 日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

11.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

(1) 发行方或债务人发生重大财务困难；

(2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

(3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

(4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

11.2.3 预期信用损失的确定

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产和租赁应收款，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

11.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

11.3 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

11.3.1 金融负债的分类、确认及计量

本集团金融负债初始确认时全部划分为以摊余成本计量的金融负债，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

11.3.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

12、应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团基于信用风险特征将应收票据划分为不同组合：

组合类别	确定依据
组合 1	承兑人为信用评级较高的银行的应收票据。

组合 2	承兑人为信用评级较低的银行的应收票据。
组合 3	国内企业承兑的应收票据

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团以共同风险特征为依据将应收账款分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处区域等。

本集团基于信用风险特征将应收账款划分为不同组合：

组合类别	确定依据
R1	中国大陆大客户
R2	美国大客户
R3	中国台湾大客户
R4	欧洲大客户
R5	东亚大客户
R6	所有中小客户
R7	集团内关联方
R8	高风险客户

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

本集团对单项金额重大且债务人发生严重财务困难的应收账款因信用风险显著不同而单项评估信用风险。

14、应收款项融资

□适用 √不适用

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本集团以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处区域等。

本集团基于信用风险特征将其他应收款划分为不同组合：

组合类别	确定依据
正常	信用风险自初始确认后并未显著增加
关注	信用风险自初始确认后已显著增加
损失	已发生信用减值

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

本集团对单项金额重大且债务人发生严重财务困难的其他应收款因信用风险显著不同而单项评估信用风险。

16、存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

16.1 存货的分类

本集团的存货主要包括在产品和产成品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

16.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用移动加权平均法确定发出存货的实际成本。

16.3 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、合同资产

☒适用 ☐不适用

合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

合同资产是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

本集团以共同风险特征为依据将合同资产分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处区域等。

本集团基于信用风险特征将合同资产划分为不同组合：

组合类别	确定依据
R1	中国大陆大客户
R2	美国大客户
R3	中国台湾大客户
R4	欧洲大客户
R5	东亚大客户
R6	所有中小客户
R7	集团内关联方
R8	高风险客户

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

本集团对单项金额重大且债务人发生严重财务困难的合同资产因信用风险显著不同而单项评估信用风险。

18、持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

19.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权利，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他一方共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

19.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

19.3 后续计量及损益确认方法

19.3.1 按成本法核算的长期股权投资

本公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

19.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

20、投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法
不适用

21、固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20~44	-	2.27~5
电子设备、机器设备	年限平均法	2~10	-	10~50
器具及家具	年限平均法	2~5	-	20~50

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

22、在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产、无形资产或长期待摊费用。各类在建工程结转为固定资产、无形资产以及长期待摊费用的标准和时点如下：

类别	结转为固定资产、无形资产或长期待摊费用的标准和时点
软件安装	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
装修工程	初步验收合格并达到预定可使用状态或合同规定的标准

23、借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

24、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒ 适用 ☐ 不适用

无形资产包括非专利技术、第三方授权许可、客户关系、专利权、软件使用权、商标和内部开发技术。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内除客户关系采用双倍余额递减法之外其余采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。除了商标外，其他无形资产均系使用寿命有限的无形资产，其预计使用寿命及残值明细如下：

类别	摊销年限(年)及确定依据	残值率(%)
非专利技术	15，根据预期受益年限确定	-
第三方授权许可	1~10，根据合同约定期限确定	-
客户关系	12~15，根据预期受益年限确定	-
软件使用权	1~10，根据合同约定期限确定	-
专利权	5~20，根据专利权有效期限确定	-
内部开发技术	2~5，根据预期受益年限确定	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将无法预见该资产为集团带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为来源于合同性权利或其他法定权利，

但合同规定或法律规定无明确使用年限，综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为本集团带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，由管理层进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团研发支出的归集范围包括直接从事研发活动人员的工资薪金和福利费用、折旧及摊销费用、使用权资产摊销费用、通讯费用、研发项目外部服务费用等。本集团以验证测试通过，生成测试报告作为划分研究阶段和开发阶段的具体标准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命确定的无形资产、长期待摊费用是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法划分到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组，如包含分摊的商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组的商誉的账面价值，再根据资产组中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括租入固定资产改良支出等。长期待摊费用按预计使用寿命以及合同期限并考虑续租期限后孰短进行摊销。

29、合同负债

√适用 □不适用

合同负债是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、预计负债

√适用 □不适用

当与亏损合同、未决诉讼等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

32、股份支付

√适用 □不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付全部为以权益结算的股份支付。

32.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

32.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

33、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

34、收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

业务类型	业务内容
量产服务收入	系本集团芯片产品销售而取得的收入。
设计服务收入	系本集团根据客户对芯片在功能、性能、功耗、尺寸及成本等方面的要求进行芯片规格定义和 IP 选型，通过设计、实现及验证，逐步转化为能用于芯片制造的版图，并委托晶圆厂根据版图生产芯片样片(即样片流片)，最终将经过公司技术人员验证过的样片及相关技术信息交付给客户而取得的收入。
IP 授权使用费收入	系本集团向客户提供一次性或者多次授权使用本集团的知识产权产生的收入。
IP 特许权使用费收入	系客户使用本集团的知识产权授权生产及销售产品，按规定费率支付使用费产生的收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该

项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

本集团在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于 IP 授权使用费收入，尽管部分业务合同中约定了验收条款，但因本集团在相关产品以电子方式被放置于本集团加密的 FTP(文件传输协议)服务器中以供客户下载且密钥以电子方式发送给客户时，已将商品的控制权转移给客户，对其并无继续管理权及实施有效控制的能力，且相关经济利益很可能流入企业，因此在该时点按照相关合同或协议约定的金额确认收入。

对于 IP 特许权使用费收入，当本集团每季度从被许可方收到生产量及销量报告，且相关经济利益很可能流入企业时，按照合同或协议规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

对于设计服务收入，因其满足本集团所产出的商品具有不可替代的用途且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，故在一段时间内确认收入，采用投入法确定履约进度，即根据本集团为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

客户额外购买选择权包括针对未来商品或服务的其他折扣等，对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权，本集团将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接

观察的，本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：(一)本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；(二)本集团能够主导第三方代表本企业向客户提供服务；(三)本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他商品整合成某组合产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，本集团没有仅局限于合同的法律形式，而是综合考虑所有相关事实和情况，这些事实和情况包括：(一)本集团承担向客户转让商品的主要责任；(二)本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；(三)本集团有权自主决定所交易商品的价格；(四)其他相关事实和情况。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

35、合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

35.1 取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

35.2 履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满

足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

35.3 与合同成本有关的资产的减值损失

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后，对于与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：(1)本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

与合同成本相关的资产计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

36.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分摊计入当期损益。

36.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，与本集团日常活动相关的，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用的期间，冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)且不导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对房屋和机器设备等短期租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项

租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

39、其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 √不适用

其他说明
无

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、其他

□适用 √不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况
√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本公司为增值税一般纳税人，应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额。	6%(适用现代服务业下的研发和技术服务)以及 13%(产品销售)
消费税		
营业税		
城市维护建设税	已缴流转税额	5%或 7%
企业所得税	应纳税所得额，应纳税所得额系按有关税法规定对本年税前	0%~43%

	会计利润作相应调整后得出的应纳税所得额乘以法定税率计算。	
教育费附加/地方教育费附加	已缴流转税额	3%/2%/1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
芯原微电子(上海)股份有限公司	15%
芯原微电子(北京)有限公司	20%
芯原微电子(成都)有限公司	15%
图芯芯片技术(上海)有限公司	20%
VeriSilicon Cayman	0%
VeriSilicon (Hong Kong) Limited. (“VeriSilicon Hong Kong”)	16.5%
VeriSilicon Kabushiki Kaisha (“VeriSilicon Japan”)	43%
VeriSilicon, Inc. (注 1)	8.84%/21%
VeriSilicon EURL	26.5%
Vivante Corporation (“Vivante US”) (注 1)	8.84%/21%
芯原微电子(南京)有限公司	15%
芯原微电子(海南)有限公司	15%
芯原科技(上海)有限公司 (“芯原科技”) (附注五、2)	15%
VeriSilicon Vietnam Company Limited (“Verisilicon Vietnam”)	20%
芯原微电子(广州)有限公司 (注 2)	25%
天遂芯愿 (注 3)	25%
逐点半导体（上海）股份有限公司	15%
逐点半导体（珠海）有限公司	20%
ViXS Systems, Inc.	26.5%
Pixelworks Hong Kong Limited （逐点香港）	16.5%
Pixelworks Japan Inc. （逐点日本）	37.87%

2、 税收优惠

√适用 □不适用

芯原上海于 2023 年 12 月 12 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202331004387)，有效期 3 年。

芯原上海、芯原成都、芯原南京及芯原海南根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税[2023]17 号)，芯原上海及芯原成都自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，芯原南京及芯原海南自 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，按照当期可抵扣进项税额的 15%，计提当期加计抵减额。

芯原南京根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2022 年 12 月 12 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202232015872)，被认定为高新技术企业，自

2022 年 12 月 12 日起执行 15%的企业所得税率，有效期 3 年；根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局于 2025 年 12 月 19 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202532014708)，被认定为高新技术企业，自 2025 年 12 月 19 日起执行 15%的企业所得税率，有效期 3 年。

芯原北京根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

图芯上海根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据《《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。芯原成都由成都高新技术产业开发区国家税务局认定为西部地区鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。

芯原海南根据海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局于 2024 年 12 月 3 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202446000271)，被认定为高新技术企业，自 2024 年 12 月 3 日起执行 15%的企业所得税率，有效期 3 年。

根据财政部、税务总局《关于中国(上海)自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》(财税〔2020〕38 号)、《中国(上海)自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税优惠资格认定管理办法》(沪财发〔2020〕12 号)和《关于中国(上海)自由贸易试验区临港新片区重点产业企业实质性生产或研发活动有关问题的公告》(2023 年第 1 号)有关要求，芯原科技由上海市经济和信息化委员会认定为临港新片区 2023 年第二批重点产业企业，自 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日减按 15%的税率征收企业所得税。

逐点半导体根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于 2023 年 12 月 12 日颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202331006676)，被认定为高新技术企业，自 2023 年起执行 15%的企业所得税率，有效期 3 年。

逐点珠海根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号),自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,696.39	80,110.94
银行存款	1,058,989,465.37	2,006,344,354.83
其他货币资金	1,352,509.51	1,089,469.61
存放财务公司存款		
合计	1,060,369,671.27	2,007,513,935.38
其中：存放在境外的款项总额	117,142,243.95	99,950,318.49

其他说明

上述其他货币资金系海关进口关税、信用证保证金。

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,382,506,109.06	923,813,258.56	/
其中：			
理财产品	361,293,355.64	356,973,596.46	/
结构性存款	1,021,212,753.42	566,839,662.10	/
合计	1,382,506,109.06	923,813,258.56	/

其他说明：

☒适用 ☐不适用

理财产品系本集团从银行购买的短期浮动收益类型产品。

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	137,423.65	994,731.00
商业承兑票据		4,830,433.95
合计	137,423.65	5,825,164.95

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	137,470.00	100.00	46.35	0.03	137,423.65	5,827,537.97	100.00	2,373.03	0.04	5,825,164.95
其中：										
组合 1	137,470.00	100.00	46.35	0.03	137,423.65	279,550.01	4.80	93.77	0.03	279,456.24
组合 2						715,917.49	12.29	642.73	0.09	715,274.76
组合 3						4,832,070.47	82.92	1,636.52	0.03	4,830,433.95
合计	137,470.00	/	46.35	/	137,423.65	5,827,537.97	/	2,373.02	/	5,825,164.95

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收票据组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收票据组合计提坏账准备	137,470.00	46.35	137,423.65
合计	137,470.00	46.35	137,423.65

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

作为本集团信用风险管理的一部分, 本集团对应收票据进行内部风险等级评估, 并基于信用风险特征将其分为 3 种风险等级, 包括承兑人为信用评级较高的银行的应收票据(组合 1)、承兑人为信用评级较低的银行的应收票据(组合 2)、国内企业承兑的应收票据(组合 3)确定各组合应收票据的预期损失率。于 2026 年 6 月 30 日, 本集团基于减值矩阵确认应收票据的预期信用损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	未发生信用减值	已发生信用减值	合计数
2025 年 12 月 31 日	2,373.02	-	2,373.02
本期计提	46.35	-	46.35
本期转回	2,373.02	-	2,373.02
2026 年 6 月 30 日余额	46.35	-	46.35

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	2,373.02	46.35	2,373.02			46.35
合计	2,373.02	46.35	2,373.02			46.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明：
无。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☒适用 ☐不适用
无。

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,481,960,112.94	1,199,312,466.50
小于 6 个月	1,415,082,527.69	1,184,687,851.16
6 个月至 1 年	66,877,585.25	14,624,615.34
1 至 2 年	7,768,318.37	23,262,607.97
2 至 3 年	50,691,647.25	105,121,531.90
3 年以上		
3 至 4 年	92,029,597.47	36,086,355.22
4 至 5 年	3,756,924.56	52,242,812.15
5 年以上	52,153,136.69	5,547,267.09
合计	1,688,359,737.28	1,421,573,040.83

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	99,668,447.36	5.90	99,668,447.36	100	-	101,428,754.19	7.13	101,428,754.19	100	-
其中：										
单 项 计 提	99,668,447.36	5.90	99,668,447.36	100	-	101,428,754.19	7.13	101,428,754.19	100	-
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,588,691,289.92	94.10	136,652,043.37	8.60	1,452,039,246.55	1,320,144,286.64	92.87	117,421,254.52	8.89	1,202,723,032.12
其中：										
R 1	1,166,946,821.66	69.13	36,062,505.89	3.09	1,130,884,315.77	902,437,579.91	63.48	28,304,108.59	3.14	874,133,471.32
R 2	245,908,387.76	14.56	695,396.52	0.28	245,212,991.24	226,861,738.30	15.96	569,471.02	0.25	226,292,267.28
R 3	16,906,030.70	1.00	52,221.79	0.31	16,853,808.91	21,713,046.04	1.53	72,633.47	0.33	21,640,412.57
R 4	11,725,987.69	0.69	24,154.05	0.21	11,701,833.64	19,709,436.57	1.39	46,784.81	0.24	19,662,651.76
R 5	6,159,940.06	0.36	11,263.09	0.18	6,148,676.97	8,377,498.80	0.59	18,787.43	0.22	8,358,711.37
R 6	5,383,279.68	0.32	3,054,831.15	56.75	2,328,448.53	4,425,384.65	0.31	2,494,702.09	56.37	1,930,682.56
R 8	135,660,842.37	8.04	96,751,670.88	71.32	38,909,171.49	136,619,602.37	9.61	85,914,767.11	62.89	50,704,835.26
合 计	1,688,359,737.28	/	236,320,490.73	/	1,452,039,246.55	1,421,573,040.83	/	218,850,008.71	/	1,202,723,032.12

按单项计提坏账准备：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收账款单项计提坏账准备	99,668,447.36	99,668,447.36	100.00	集团认为存在重大财务困难的客户相应的应收账款以及存在重大逾期的应收账款已发生信用减值，并单项计提了减值准备。
合计	99,668,447.36	99,668,447.36	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：应收账款组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
R1	1,166,946,821.66	36,062,505.89	3.09
R2	245,908,387.76	695,396.52	0.28
R3	16,906,030.70	52,221.79	0.31
R4	11,725,987.69	24,154.05	0.21
R5	6,159,940.06	11,263.09	0.18
R6	5,383,279.68	3,054,831.15	56.75
R8	135,660,842.37	96,751,670.88	71.32
合计	1,588,691,289.92	136,652,043.38	8.60

按组合计提坏账准备的说明：

☒适用 ☐不适用

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团对客户进行内部风险等级评估，并结合客户所在地区将其分为 8 种风险等级，包括中国大陆大客户(R1)、美国大客户(R2)、中国台湾大客户(R3)、欧洲大客户(R4)、东亚大客户(R5)、所有中小客户(R6)、集团内关联方(R7)及高风险客户(R8)确定各评级应收账款的预期损失率。本集团基于减值矩阵确认应收账款的预期信用损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减 值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减 值)	合计数
2025 年 12 月 31 日	29,011,785.32	189,838,223.39	218,850,008.71
收购新增	742,272.25		742,272.25
本期转入已发生信用减值	-90,643.97	90,643.97	-

本期计提预期信用损失	7,182,127.74	12,110,388.78	19,292,516.52
本期转回预期信用损失		564,757.03	564,757.03
本期核销预期信用损失		141,509.43	141,509.43
汇率变动的影响		-1,858,040.29	-1,858,040.29
2026 年 6 月 30 日	36,845,541.34	199,474,949.39	236,320,490.73

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	218,850,008.71	19,292,516.52	564,757.03	141,509.43	-1,115,768.04	236,320,490.73
合计	218,850,008.71	19,292,516.52	564,757.03	141,509.43	-1,115,768.04	236,320,490.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	141,509.43

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	其他非流动资产-应收知识产权授权费年末余额	应收账款、合同资产、其他非流动资产-应收知识产权授权费年末余额	占应收账款、合同资产、其他非流动资产-应收知识产权授权费年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	224,759,700.00	-	-	224,759,700.00	10.40	7,045,681.12
客户二	101,916,100.00	-	23,519,100.00	125,435,200.00	5.80	3,932,094.68
客户三	121,252,308.86	20,466,963.20	-	141,719,272.06	6.55	4,443,117.05
客户四	86,279,019.24	-	-	86,279,019.24	3.99	2,704,641.70
客户五	59,366,889.52	23,923,773.35	-	83,290,662.87	3.85	59,003,343.21
合计	593,574,017.62	44,390,736.55	23,519,100.00	661,483,854.17	30.59	77,128,877.76

其他说明
无。

其他说明：
☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

目	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	405,158,884.48	34,882,340.50	370,276,543.98	385,286,042.35	31,958,041.14	353,328,001.21
合计	405,158,884.48	34,882,340.50	370,276,543.98	385,286,042.35	31,958,041.14	353,328,001.21

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4,937,451.87	1.22	4,937,451.87	100.00	-	5,122,951.87	1.33	5,122,951.87	100.00	-
其中：										
单项计提	4,937,451.87	1.22	4,937,451.87	100.00	-	5,122,951.87	1.33	5,122,951.87	100.00	-
按组合计提坏账准备	400,221,432.61	98.78	29,944,888.63	7.48	370,276,543.98	380,163,090.48	98.67	26,835,089.27	7.06	353,328,001.21
其中：										
R1	296,286,763.01	73.13	9,312,509.04	3.14	286,974,253.97	273,444,297.93	70.97	8,579,249.00	3.14	264,865,048.93

R 2	69,729,43 0.73	17. 21	175,035. 64	0.25	69,554,39 5.09	72,292,34 7.44	18. 76	181,469. 13	0.25	72,110,87 8.31
R 3	4,013,197 .91	0.9 9	13,424.7 6	0.33	3,999,773 .15	3,234,651 .18	0.8 4	10,820.4 0	0.33	3,223,830 .78
R 4						999,752.9 7	0.2 6	2,373.14	0.24	997,379.8 3
R 8	30,192,04 0.96	7.4 5	20,443,9 19.19	67.7 1	9,748,121 .77	30,192,04 0.96	7.8 4	18,061,1 77.60	59.8 2	12,130,86 3.36
合 计	405,158,8 84.48	/	34,882,3 40.50	/	370,276,5 43.98	385,286,0 42.35	/	31,958,0 41.14	/	353,328,0 01.21

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合同资产单项计提坏账准备	4,937,451.87	4,937,451.87	100	集团认为存在重大财务困难的客户相应的合同资产以及存在重大逾期的合同资产已发生信用减值, 并单项计提了减值准备。
合计	4,937,451.87	4,937,451.87	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 合同资产组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
R1	296,286,763.01	9,312,509.04	3.14
R2	69,729,430.73	175,035.64	0.25
R3	4,013,197.91	13,424.76	0.33
R8	30,192,040.96	20,443,919.19	67.71
合计	400,221,432.61	29,944,888.63	7.48

按组合计提坏账准备的说明

√适用 □不适用

作为本集团信用风险管理的一部分, 本集团对客户进行内部风险等级评估, 并结合客户所在地区将其分为 8 种风险等级, 包括中国大陆大客户(R1)、美国大客户(R2)、中国台湾大客户(R3)、欧洲大客户(R4)、东亚大客户(R5)、所有中小客户(R6)、集团内关联方(R7)及高风险客户(R8)确定各评级合同资产的预期损失率。本集团基于减值矩阵确认合同资产的预期信用损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计数
2026 年 1 月 1 日余额	8,773,911.67	23,184,129.47	31,958,041.14
本期计提预期信用损失	733,232.38	2,197,241.59	2,930,473.97
本期核销			
汇率变动的影响	(6,174.61)		-6,174.61
2026 年 6 月 30 日	9,500,969.44	25,381,371.06	34,882,340.50

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		本期计提	本期 收回 或转 回	本期 转销/ 核销	其他变 动		
合同资产 坏账准备	31,958,041.14	2,930,473.97			-6,174.61	34,882,340.50	
合计	31,958,041.14	2,930,473.97			-6,174.61	34,882,340.50	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(5) 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☐适用 ☒不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用**8、预付款项**

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,086,436,253.08	98.88	445,990,135.45	95.45
1 至 2 年	2,963,575.83	0.27	11,269,809.84	2.41
2 至 3 年	4,750.00	0.00	4,750.00	0.01
3 年以上	9,346,127.40	0.85	9,963,838.70	2.13
合计	1,098,750,706.31	100.00	467,228,533.99	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2026 年 6 月 30 日本集团预付款项中账龄超过一年的主要款项是由于预定产能而向采购供应商支付的预付款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	805,064,480.97	73.27
第二名	109,310,249.97	9.95
第三名	64,849,848.13	5.90
第四名	50,400,660.00	4.59
第五名	22,861,465.41	2.08
合计	1,052,486,704.48	95.79

其他说明：

无。

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,732,470.65	2,962,092.62
合计	1,732,470.65	2,962,092.62

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(6) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(7) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(9) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(10) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(11) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,115,461.01	1,666,727.21
小于 6 个月	825,942.07	1,594,253.43
6 个月至 1 年	289,518.94	72,473.78
1 至 2 年	189,198.49	121,632.20
2 至 3 年	102,002.05	178,121.89
3 年以上		
3 至 4 年	132,542.87	116,697.70
4 至 5 年	65,949.00	51,425.00
5 年以上	184,825.87	957,515.83
合计	1,789,979.29	3,092,119.83

(12) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收押金、备用金及暂支款	1,124,352.49	961,036.02
应收代垫款		947,520.00
应收采购返利折让款		796,890.69
其他	665,626.80	386,673.12
合计	1,789,979.29	3,092,119.83

(13) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	80,012.06	50,015.15	-	130,027.21

收购新增	110,802.65			110,802.65
本期计提	28,174.55	765,250.04		793,424.59
本期转回	161,480.62			161,480.62
本期转销				
本期核销		784,555.48		784,555.48
其他变动		-30,709.71		-30,709.71
2026年6月30 日余额	57,508.64	0.00	-	57,508.64

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(14) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	130,027.21	793,424.59	161,480.62	784,555.48	80,092.94	57,508.64
合计	130,027.21	793,424.59	161,480.62	784,555.48	80,092.94	57,508.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
无

(15) 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	784,555.48

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(16) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	185,800.13	10.38	其他	6 个月至 1 年	7,504.71
第二名	148,134.40	8.28	应收押金、备用金及暂支款	6 个月至 2 年	5,983.34
第三名	119,500.00	6.68	应收押金、备用金及暂支款	小于 6 个月至 5 年以上	4,826.76
第四名	105,000.00	5.87	应收押金、备用金及暂支款	1 年至 4 年	4,241.09
第五名	90,000.00	5.03	应收押金、备用金及暂支款	5 年以上	27.01
合计	648,434.53	36.23	/	/	22,582.91

(17) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品	453,816,908.76	14,750,584.12	439,066,324.64	462,540,824.89	4,309,347.09	458,231,477.80
库存商品	251,765,019.39	3,936,318.63	247,828,700.76	42,166,623.81	2,415,368.04	39,751,255.77
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	705,581,928.15	18,686,902.75	686,895,025.40	504,707,448.70	6,724,715.13	497,982,733.57

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	企业合并	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	4,309,347.09	675,316.34	11,017,674.15	1,138,959.24	112,794.22	14,750,584.12
库存商品	2,415,368.04	156,454.78	1,648,015.66	240,114.37	43,405.48	3,936,318.63
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	6,724,715.13	831,771.12	12,665,689.81	1,379,073.61	156,199.70	18,686,902.75

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

闲置库存报废。

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付短期租赁费	94,065.35	96,022.32
待摊费用	19,575,557.71	26,407,679.97
待抵扣增值税进项税	119,667,817.78	123,538,920.78
预缴税金	20,819,077.27	7,738,298.41
知识产权授权采购额度	17,074,149.19	16,690,312.59
预付港股发行相关费用	25,056,499.86	-
大额存单	70,378,958.90	50,287,083.33
合计	272,666,126.06	224,758,317.40

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无。

14、债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无。

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无。

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币												
被投资单位	期初 余额（账面 价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额（账面 价值）	减值准 备期末 余额
			追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
芯思原微 电子有限 公司	-				- 192,276.54		192,276.54				-	
上海芯展 科技有限 公司	1,147,548.56				94,496.58						1,242,045.14	
上海微镁 科技有限 公司	-		300,000.00		-49.52						299,950.48	
小计	1,147,548.56		300,000.00		-97,829.48		192,276.54				1,541,995.62	
合计	1,147,548.56		300,000.00		-97,829.48		192,276.54				1,541,995.62	

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

2018年9月，本公司以现金方式认缴人民币5,600万元，与新思投资(中国)有限公司、上海吉麦企业管理中心(有限合伙)、西藏长乐投资有限公司共同成立芯思原微电子有限公司(以下简称“芯思原”)。芯思原注册地在合肥市高新区，法定代表人为戴伟民，注册资本为人民币一亿元。本公司分别于2018年9月和2019年3月支付认缴资本人民币600万元和5,000万元。截至2022年12月31日持股比例为56%。

2023年5月，芯思原签署增资协议，其中嘉兴芯谷投资合伙企业(有限合伙)新增认缴注册资本人民币333.33万元，合肥市天使投资基金有限公司新增认缴注册资本人民币333.33万元，共青城如愿投资合伙企业(有限合伙)新增认缴注册资本人民币2,666.67万元，三名股东共计新增认缴注册资本人民币3,333.33万元。增资后，本公司对芯思原的持股比例被稀释至42%，并相应调整长期股权投资的账面价值人民币2,581,865.46元。2026年1至6月，芯思原因实施股权激励确认股份支付费用及相应资本公积，本公司按照持股比例计算应享有的份额，并相应调整长期股权投资的账面价值人民币192,276.54元。截至2026年6月30日，芯思原董事会席位共五名，其中本公司占两席。对于公司主要经营事项的决策，需要由董事会全体董事过半数通过，本公司对其有重大影响，因此芯思原为本公司的联营企业并采用权益法核算。

2024年9月，本公司以现金方式认缴人民币100万元，与上海孚腾私募基金管理有限公司、上海临港科创投资管理有限公司、上海华虹投资发展有限公司、长鑫芯聚股权投资(安徽)有限公司、上海兆芯集成电路股份有限公司、西藏远识创业投资管理有限公司共同成立上海芯展科技有限公司(以下简称“芯展科技”)。芯展科技注册地在上海市普陀区，法定代表人为毕尚禹，注册资本为人民币1,000万元。本公司于2024年11月支付认缴资本人民币100万元。截至2026年6月30日持股比例为10%。芯展科技股权分布松散，董事会席位共七名，其中本公司占一席。对于公司主要经营事项的决策，需要由董事会全体董事过半数通过，本公司对其有重大影响，因此芯展科技为本公司的联营企业并采用权益法核算。

2024年12月，本公司以现金方式认缴人民币30万元，与上海集成电路研发中心有限公司、上海华东师范大学教育发展基金会等股东共同成立上海微镁科技有限公司(以下简称“微镁科技”)。微镁科技注册地在上海市普陀区，法定代表人为陈寿面，注册资本为人民币250万元。本公司于2026年6月支付认缴资本人民币30万元。截至2026年6月30日持股比例为12%。微镁科技股权分布松散，董事会席位共八名，其中本公司占一席。对于公司主要经营事项的决策，需要由董事会全体董事过半数通过，本公司对其有重大影响，因此微镁科技为本公司的联营企业并采用权益法核算。

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非上市公司股权投资	169,149,817.94	193,580,341.86
上市公司股权投资	26,730,148.18	38,903,309.47
合计	195,879,966.12	232,483,651.33

其他说明：

本集团将持股比例低，无重大影响的非上市公司股权投资以公允价值计量且其变动计入当期损益。上述股权投资预期持有超过一年，列示于其他非流动金融资产。

集团持有的某公司股份于 2025 年 7 月起在美国证券市场上市流通，以资产负债表日的收盘价作为公允价值计量的依据。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	708,182,998.06	711,517,557.22
固定资产清理		
合计	708,182,998.06	711,517,557.22

其他说明：
无。

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	器具及家具	电子设备、机器设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	676,631,954.49	25,988,796.25	253,251,128.29	955,871,879.03
2.本期增加金额	0.00	1,969,424.23	28,379,123.34	30,348,547.57
（1）购置	0.00	1,986,244.02	8,683,713.03	10,669,957.05
（2）在建工程转入	0.00	44,247.79	0.00	44,247.79
（3）企业合并增加	0.00	56,796.81	20,036,696.11	20,093,492.92
（4）汇率变动的影响	0.00	-117,864.39	-341,285.80	-459,150.19

3.本期减少金额	0.00	308,427.81	3,231,279.32	3,539,707.13
(1) 处置或报废	0.00	308,427.81	3,231,279.32	3,539,707.13
4.期末余额	676,631,954.49	27,649,792.67	278,398,972.31	982,680,719.47
二、累计折旧				
1.期初余额	47,827,969.83	17,803,506.80	178,722,845.18	244,354,321.81
2.本期增加金额	8,053,620.45	1,393,079.67	24,156,504.50	33,603,204.62
(1) 计提	8,053,620.45	1,501,295.55	24,462,873.54	34,017,789.54
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 汇率变动的影响	0.00	-108,215.88	-306,369.04	-414,584.92
3.本期减少金额	0.00	240,513.67	3,219,291.35	3,459,805.02
(1) 处置或报废	0.00	240,513.67	3,219,291.35	3,459,805.02
4.期末余额	55,881,590.28	18,956,072.80	199,660,058.33	274,497,721.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	620,750,364.21	8,693,719.87	78,738,913.98	708,182,998.06
2.期初账面价值	628,803,984.66	8,185,289.45	74,528,283.11	711,517,557.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
临港研发中心部分房产	44,905,908.20

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

固定资产清理
☐适用 ☒不适用

22、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	478,947.96	789,635.23
工程物资		
合计	478,947.96	789,635.23

其他说明：
无。

在建工程

(1) 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装修工程	478,947.96		478,947.96	789,635.23		789,635.23
合计	478,947.96		478,947.96	789,635.23		789,635.23

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

装修工程	12,314,158.2 2	789,635.2 3	2,736,056.6 4	44,247.7 9	3,002,496.1 2	478,947.9 6	98.5 8	进行中				自有
合计	12,314,158.2 2	789,635.2 3	2,736,056.6 4	44,247.7 9	3,002,496.1 2	478,947.9 6	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产**(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无。

25、使用权资产**(1) 使用权资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	电子设备、机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	133,191,538.70	2,443,605.71	135,635,144.41
2.本期增加金额	4,668,688.72	0.00	4,668,688.72
(1) 增加	2,736,244.49	0.00	2,736,244.49
(2) 企业合并增加	2,705,570.24	0.00	2,705,570.24
(3) 汇率变动的影响	-773,126.01	0.00	-773,126.01
3.本期减少金额	6,030,041.75	1,357.17	6,031,398.92
(1) 减少	6,030,041.75	1,357.17	6,031,398.92
4.期末余额	131,830,185.67	2,442,248.54	134,272,434.21
二、累计折旧			
1.期初余额	59,230,307.09	1,662,798.20	60,893,105.29
2.本期增加金额	19,539,551.20	272,640.71	19,812,191.91
(1)计提	19,924,535.44	272,640.71	20,197,176.15
(2) 汇率变动的影响	-384,984.24	0.00	-384,984.24
3.本期减少金额	3,900,971.13	0.00	3,900,971.13
(1)处置	3,900,971.13	0.00	3,900,971.13
4.期末余额	74,868,887.16	1,935,438.91	76,804,326.07
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	56,961,298.51	506,809.63	57,468,108.14
2.期初账面价值	73,961,231.61	780,807.51	74,742,039.12

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

本集团租赁了多项资产，主要为办公室租赁，租赁期为 2-10 年。

本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 1,441,914.42 元。低价值资产租赁费用为人民币 57,282.30 元。

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 20,251,884.13 元。

于 2026 年 6 月 30 日，本集团的短期租赁组合与上述租赁费对应的短期租赁相类似。

截至 2026 年 6 月 30 日止，除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外，租赁协议不附加任何其他担保条款。租入资产不可被用于借款担保。

于 2026 年 6 月 30 日，本集团无尚未达到租赁期开始日的租赁。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	非专利技术	第三方授权许可	客户关系	软件使用权	专利权	商标	内部开发技术	合计
一、账面原值								
1.期初余额	41,009,185.34	351,141,216.43	70,143,432.20	356,314,446.35	130,680,371.97	34,801,758.13	202,630,521.85	1,186,720,932.27
2.本期增加金额	729,965.00	47,240,966.31	164,525,649.98	6,618,409.29	249,724,173.53	873,297.56	-	466,505,936.55
(1)购置	-	49,242,980.00	-	4,361,012.46	-	-	-	53,603,992.46
(2)收购新增	-	1,058,955.73	166,442,352.55	2,753,340.26	253,824,513.15	-	-	424,079,161.69
(3)汇率变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减	0.00	0.00	0.00	11,726,756.00	0.00	0.00	0.00	11,726,756.00

少金 额								
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	11,726,756.00	0.00	0.00	0.00	11,726,756.00
4.期 末余 额	40,279,220.34	398,382,182.74	234,669,082.18	351,206,099.64	380,404,545.50	33,928,460.57	202,630,521.85	1,641,500,112.82
二、 累计 摊销								
1.期 初余 额	33,191,981.38	135,002,150.49	67,886,594.94	176,481,106.48	101,642,749.96	-	110,761,260.73	624,965,843.98
2.本 期增 加金 额	273,907.19	13,613,859.31	9,794,944.12	52,963,689.45	22,803,513.34	-	17,751,960.65	117,201,874.06
(1) 计提	772,718.47	14,948,708.85	11,650,410.19	53,274,833.75	26,093,932.08	-	17,751,960.65	124,492,563.99
(2) 收购 新增	-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 汇率 变动 的影 响	-498,811.28	-1,334,849.54	-1,855,466.07	-311,144.30	-3,290,418.74	-	-0.00	-7,290,689.93
3.本 期减 少金 额	0.00	0.00	0.00	11,726,756.00	0.00	0.00	0.00	11,726,756.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	11,726,756.00	0.00	0.00	0.00	11,726,756.00
4.期 末余 额	33,465,888.57	148,616,009.80	77,681,539.06	217,718,039.93	124,446,263.30	-	128,513,221.38	730,440,962.04
三、 减值 准备								
1.期 初余 额								

2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	6,813,331.77	249,766,172.94	156,987,543.12	133,488,059.71	255,958,282.20	33,928,460.57	74,117,300.47	911,059,150.78
2.期初账面价值	7,817,203.96	216,139,065.94	2,256,837.26	179,833,339.87	29,037,622.01	34,801,758.13	91,869,261.12	561,755,088.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例8.14%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

使用寿命不确定的商标，每年均进行减值测试。商标的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的未来5年的财务预算确定，2025年12月31日减值测试时采用18.50%折现率，超过5年的现金流量按照递增的增长率2.00%为基础计算。该递增的增长率基于相关行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键参数还有：基于该商标过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计预计销售额和毛利。公司管理层认为上述关键参数发生的任何合理变化均不会导致商标的账面价值合计超过其可收回金额，故未计提任何减值准备。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、商誉**(1) 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置	汇率变动	
众华收购——芯 片设计业务	2,981,092. 50					2,981,092. 50
Vivante收购—— 图形处理器业务	174,724,7 83.43				- 5,416,647. 27	169,308,1 36.16
逐点收购——视 觉处理器业务 (注)		434,398,83 6.94				434,398,8 36.94
合计	177,705,8 75.93	434,398,83 6.94			- 5,416,647. 27	606,688,0 65.60

注：逐点指逐点半导体及其合并范围内的所有主体，下同

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
众华收购——芯片设计业务	-					-
Vivante 收购——图形处理器业务	-					-
逐点收购——视觉处理器业务						-
合计	-					-

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
图形处理器业务——资产组 A	根据收购时产生商誉的业务资产将其分配至相关资产组，资产组中包含固定资产、无形资产等	图形处理器业务	是
芯片设计业务——资产组 B	根据收购时产生商誉的业务资产将其分配至相关资产组，资产组中包含固定资产、无形资产等	芯片设计业务	是
视觉处理器业务——资产组 C	根据收购时产生商誉的业务资产将其分配至相关资产组，资产组中包含固定资产、无形资产等	视觉处理器业务	本期收购形成

资产组或资产组组合发生变化

√适用 □不适用

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
逐点收购——视觉处理器业务	无	逐点收购商誉	2026 年 1 月，公司收购逐点形成商誉。

其他说明

□适用 √不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	减值金 额	预测期 的年限	预测期的 关键参数 （增长 率、利润 率等）	预测期 内的参 数的确 定依据	稳定期 的关键 参数 （增长 率、利 润率、 折现率 等）	稳定期的关 键参数的确 定依据
图形处理 器业务— —资产组 A	690,860,752.00	-	5 年	收入增长 率毛利率 折现率： 18.50%	收入增 长率和毛 利率：基 于该资 产组过 去的业 绩和管 理层对 市场发 展的预 计估计 预计销 售额和 毛利折 现率： 基于资 本资产 定价模 型	现金流 量增长 率： 2.00% 折现 率： 18.50%	现金流量增 长率：基于 相关行业的 增长预测确 定，并且不 超过该行业 的长期平均 增长率折 现率：基于 资本资产定 价模型
芯片设计业 务——资产 组 B	399,074,177.60	-	5 年	收入增长 率毛利率 折现率： 18.50%	收入增 长率和毛 利率：基 于该资 产组过 去的业 绩和管 理层对 市场发 展的预 计估计 预计销 售额和 毛利折 现率： 基于资 本资产 定价模 型	现金流 量增长 率： 2.00% 折现 率： 18.50%	现金流量增 长率：基于 相关行业的 增长预测确 定，并且不 超过该行业 的长期平均 增长率折 现率：基于 资本资产定 价模型

视觉处理器 业务——资 产组 C	/	/	/	/	/	/	/
合计			/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

视觉处理器业务——资产组 C 由公司 2026 年对逐点的收购形成。公司将于 2026 年末对该收购形成的商誉进行减值测试。

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	汇率影响	期末余额
装修费	29,897,884.59	3,826,676.18	5,538,185.31	138,300.11	28,324,675.57
合计	29,897,884.59	3,826,676.18	5,538,185.31	138,300.11	28,324,675.57

其他说明：

无。

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	3,824,415.40	726,097.50	3,741,839.59	782,751.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	442,838,551.55	68,841,689.22	58,377,417.75	12,211,903.80
预提费用	4,468,396.93	848,362.82	4,274,468.48	894,171.07
递延收益	3,967,857.69	753,331.23	4,198,712.56	878,323.77
租赁负债	13,954,105.21	2,505,665.74	3,744,208.56	783,246.61
其他	7,690,348.97	1,460,077.59	3,644,509.61	762,390.71
合计	476,743,675.75	75,135,224.10	77,981,156.55	16,312,787.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
非同一控制企业合并资产公允价值调整	462,789,570.54	72,629,558.35	72,224,296.16	15,108,516.11
使用权资产	13,954,105.21	2,505,665.75	5,756,860.39	1,204,270.90
合计	476,743,675.75	75,135,224.10	77,981,156.55	16,312,787.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	75,135,224.10	0.00	16,312,787.01	0.00
递延所得税负债	75,135,224.10	0.00	16,312,787.01	0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,502,836,388.75	1,243,559,567.01
可抵扣亏损	5,123,190,429.51	3,756,531,147.72
合计	6,626,026,818.26	5,000,090,714.73

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026		-	
2027	2,888,147.72	2,888,147.72	
2028	-	3,376,559.55	
2029	104,530,522.11	106,154,683.96	
2030	203,309,722.27	213,174,593.72	
2031	327,856,775.62	3,426,597,836.70	
2032 及以后	4,484,605,261.79		

无限期(注)	-	4,339,326.07	
合计	5,123,190,429.51	3,756,531,147.72	/

其他说明：

√适用 □不适用

本集团预计未来是否能取得足够的应纳税所得额以抵扣上述可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损具有不确定性，故本集团未确认相应的递延所得税资产。

根据本集团部分境外子公司所在国家地区的税法规定，企业可抵扣亏损没有抵扣时效，可以无限期抵扣。

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
租赁合同押金	11,958,713.50	482,882.19	11,475,831.31	11,562,635.98	467,029.90	11,095,606.08
预付开发支出项目材料费				89,968,640.00		89,968,640.00
预付无形资产采购款	8,000,000.00		8,000,000.00	7,456,888.00		7,456,888.00
预付固定资	10,000,000.00		10,000,000.00			

产 采 购 款						
平台技术 服务保 证金	12,678,998.00	512,121.21	12,166,876.79	10,000,000.00	403,913.00	9,596,087.00
应 收 知 识 产 权 授 权 费	68,579,385.13	2,149,800.34	66,429,584.79	68,984,237.70	2,164,363.82	66,819,873.88
一 年 以 上 到 期 的 大 额 存 单	20,638,958.90		20,638,958.90	20,410,849.29		20,410,849.29
合 计	131,856,055.53	3,144,803.74	128,711,251.79	208,383,250.97	3,035,306.72	205,347,944.25

补偿性资产相关信息
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无。

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项 目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受 限 类	受 限 情	账面余额	账面价值	受 限 类	受 限 情

			型	况			型	况
货币资金	1,352,509.51	1,352,509.51	冻结	海关进口关税、信用证保证金	1,089,469.61	1,089,469.61	冻结	海关进口关税、信用证保证金
应收票据								
存货								
其中：数据资源								
固定资产	611,683,667.20	611,683,667.20	抵押	长期借款抵押	619,413,477.04	619,413,477.04	抵押	长期借款抵押
无形资产								
其中：数据资源								
子公司股权	360,000,000.00	360,000,000.00	抵押	长期借款质押	360,000,000.00	360,000,000.00	抵押	长期借款质押
合	973,036,176.7	973,036,176.7	/	/	980,502,946.6	980,502,946.6	/	/

计	1	1			5	5		
---	---	---	--	--	---	---	--	--

其他说明：
无。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	89,045,269.45	-
合计	89,045,269.45	-

短期借款分类的说明：
无。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☐适用 ☒不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付采购款	411,991,356.88	325,871,180.57
合计	411,991,356.88	325,871,180.57

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1)预收款项列示**

□适用 √不适用

(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1)合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算未实现收入及预收货款	3,156,830,128.68	1,258,496,354.53
合计	3,156,830,128.68	1,258,496,354.53

(2)账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

大部分的合同负债将于一年内确认为收入。

39、应付职工薪酬**(1)应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	企业合并增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	193,641,707.96	714,923,509.81	2,981,740.88	788,347,038.83	123,199,919.82
二、离职后福利-设定提存计划	7,179,306.08	58,754,266.69		58,326,399.82	7,607,172.95
三、辞退福利					
四、一年内到期的其他福利		10,657,249.75		10,657,249.75	
合计	200,821,014.04	784,335,026.25	2,981,740.88	857,330,688.40	130,807,092.77

(2)短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	企业合并增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	185,553,813.67	629,683,772.29	2,981,740.88	703,942,044.75	114,277,282.09
二、职工福利费					
三、社会保险费	4,329,730.84	41,494,968.35		41,023,484.28	4,801,214.91
其中：医疗保险费	4,242,708.95	40,390,939.16		39,960,957.50	4,672,690.61
工伤保险费	87,021.89	838,804.33		797,301.92	128,524.30
生育保险费	-	265,224.86		265,224.86	-
四、住房公积金	3,082,255.52	34,505,203.16		34,142,775.69	3,444,682.99
五、工会经费和职工教育经费	675,907.93	9,239,566.01		9,238,734.11	676,739.83
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					

合计	193,641,707.96	714,923,509.81	2,981,740.88	788,347,038.83	123,199,919.82
----	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,961,751.35	56,771,590.07	56,356,688.86	7,376,652.56
2、失业保险费	217,554.73	1,982,676.62	1,969,710.96	230,520.39
3、企业年金缴费				
合计	7,179,306.08	58,754,266.69	58,326,399.82	7,607,172.95

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团按各公司所在地当地政策按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,361,638.45	24,592,138.93
消费税		
营业税		
企业所得税	5,989,706.19	4,983,022.17
个人所得税	11,059,709.73	13,994,604.60
城市维护建设税		
其他	12,456,568.10	8,225,604.74
合计	35,867,622.47	51,795,370.44

其他说明：

无。

41、其他应付款**(1) 项目列示**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,389,080.67	74,821,858.83
合计	80,389,080.67	74,821,858.83

(2) 应付利息

□ 适用 √ 不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购置固定资产款	1,751,217.72	1,875,767.19
应付购置无形资产款	38,054,234.94	34,804,600.75
代收代付的人才奖励补贴		3,710,000.00
专业服务费	9,590,025.08	12,509,257.03
应付保证金	1,422,818.39	2,817,689.87
应付网络设备费	14,495,767.19	12,625,941.22
其他	15,075,017.35	6,478,602.77
合计	80,389,080.67	74,821,858.83

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	510,861,306.88	442,886,322.98
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	29,925,348.73	35,430,085.50
一年内到期的应付无形资产 采购款项	53,619,410.00	74,835,953.12
合计	594,406,065.61	553,152,361.60

其他说明：

无。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收代垫款	1,414,081.50	47,381,640.00
待执行的亏损合同	17,971,292.79	10,356,083.57

政府补助	518,503.74	2,291,009.24
员工赔偿	-	1,706,542.86
合计	19,903,878.03	61,735,275.67

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

涉及政府补助的项目：

人民币元

项目	2026 年 1 月 1 日	收购新增	本期新增 补助金额	本期冲减 成本费用或 记入其他收 益金额	2026 年 6 月 30 日	与资产 相关/ 与收益 相关
促进高质量发展项目	-		750,000.00	750,000.00	-	与收益 相关
南京市重大科技专项项目			400,000.00	8,000.00	392,000.00	与收益 相关
高质量发展专项项目 EDA 与 IP 补贴		318,938.36		192,434.62	126,503.74	与资产 相关
MIPI 接口 IP 核项目	2,291,009.24			2,291,009.24	-	与收益 相关
合计	2,291,009.24	318,938.36	1,150,000.00	3,241,443.86	518,503.74	

45、长期借款

(1) 长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	999,301,219.39	1,043,457,446.07
保证及抵押借款	482,436,409.84	523,742,234.98
减：一年内到期的长期借款	-510,861,306.88	-442,886,322.98
合计	970,876,322.35	1,124,313,358.07

长期借款分类的说明：

无。

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	60,065,667.69	75,081,708.14
减：计入一年内到期的非流动负债	-29,925,348.73	-35,430,085.50
合计	30,140,318.96	39,651,622.64

其他说明：

无。

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,949,416.24	39,392,798.49
专项应付款		
合计	21,949,416.24	39,392,798.49

其他说明：

无。

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付无形资产采购款	65,592,786.26	105,142,503.34
减：一年内到期的应付无形资产采购款	53,619,410.00	74,835,953.12
小计	11,973,376.26	30,306,550.22
其他	9,976,039.98	9,086,248.27
合计	21,949,416.24	39,392,798.49

其他说明：
无。

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
少数股东股权回购义务	592,800,000.00	570,000,000.00
合计	592,800,000.00	570,000,000.00

其他说明：

2025 年 10 月 10 日，本公司新设立天遂芯愿，本集团持股 100%。2025 年 12 月 12 日，本公司与其他投资方签订天遂芯愿相关的增资协议和股东协议，于 2025 年 12 月 31 日增资完成后，本公司持股 40%，是天遂芯愿单一第一大股东，享有对天遂芯愿的控制权。天遂芯愿相关的股东协议明确，自增资交割日 12 个月届满之日起至 36 个月届满之日，本公司有权自行或指定第三方通过现金和/或发行股份购买资产和/或以可转债等方式，依据中国法律法规及监管机构的要求，按照

与其他投资方协商一致的价格与条件收购其他投资方所持全部天遂芯愿股权。若前述收购未能完成，自增资交割日 36 个月届满之日起，其他投资方可以书面形式要求本公司以本金加固定利率的价格以现金收购其他投资方所持全部或部分天遂芯愿股权。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司与其他投资方已实缴对天遂芯愿的出资，并将其他股东的出资及利息确认为其他非流动负债。

53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	525,858,273.00	57,000.00				57,000.00	525,915,273.00

其他说明：

根据 2020 年 12 月 25 日董事会审议通过 2020 年限制性股票激励计划(“2020 限制性股票计划”), 截至 2026 年 6 月 30 日, 2020 限制性股票计划实际行权增加的投资款人民币 2,196,210.00 元。行权后增加股本人民币 57,000.00 元, 增加资本公积人民币 2,139,210.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

55、资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,830,378,700.03	2,412,069.00		5,832,790,769.03
其他资本公积	80,610,229.54	133,002,377.42	272,859.00	213,339,747.96
合计	5,910,988,929.57	135,414,446.42	272,859.00	6,046,130,516.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

投资者投入资本本期增加系限制性股票员工行权导致资本溢价。员工行权的投资款增加资本公积人民币 2,139,210.00 元，以及员工行权对应其他资本公积转入资本溢价人民币 272,859.00 元。

以权益结算的股份支付本期增加系权益结算的股份支付在等待期内摊销导致，其中人民币 132,810,100.88 元计入资本公积。

其他本期增加系本年联营企业芯思原实施股权激励确认股份支付费用及相应资本公积，对公司资本公积的影响金额为 192,276.54 元。

本期减少主要系员工行权对应其他资本公积转入资本溢价人民币 272,859.00 元。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	24,836,121.01			24,836,121.01
合计	24,836,121.01			24,836,121.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、								

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期计入其他 综合收益当期 转入损益	减： 前期计入其他 综合收益当期 转入留存收益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少数股 东	
不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划								

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期计入其他综合收益当期转入损益	减： 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于少数股东	
变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资								

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期计入其他 综合收益当期 转入损益	减： 前期计入其他 综合收益当期 转入留存收益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少数股 东	
公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类	- 50,354,217.62	- 15,088,168.33				- 15,088,168.33		- 65,442,385.95

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期计入其他 综合收益当期 转入损益	减： 前期计入其他 综合收益当期 转入留存收益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少数股 东	
进 损 益 的 其 他 综 合 收 益								
其 中： 权 益 法 下 可 转 损 益 的 其 他 综 合 收 益								

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期计入其他综合收益当期转入损益	减： 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于少数股东	
其他 债权投资公允价值变动								
金融 资产重分类计入其他综合收益的								

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期计入其他综合收益当期转入损益	减： 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减： 所得税费用	税后归属于 母公司	税后归属于少数股东	
金额								
其他 债权 投资 信用 减值 准备								
现金流量套期储备								
外币财务	50,354,217.62 ⁻	15,088,168.33 ⁻				15,088,168.33 ⁻		65,442,385.95 ⁻

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减： 前期计入 其他综合 收益当期 转入损益	减： 前期计入 其他综合 收益当期 转入留存 收益	减： 所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少数 股东	
报表 折算 差额								
其他 综合 收益 合计	50,354,217.62 ⁻	15,088,168.33 ⁻				15,088,168.33 ⁻		65,442,385.95 ⁻

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。

58、专项储备

☐适用 ☒不适用

59、盈余公积

☐适用 ☒不适用

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-2,944,150,379.07	-2,416,337,051.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-2,944,150,379.07	-2,416,337,051.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-612,125,014.89	-527,813,327.29
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,556,275,393.96	-2,944,150,379.07

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,861,467,050.55	1,278,384,507.25	970,937,345.39	547,472,542.96
其他业务	2,072,345.13	1,080,588.71	2,862,488.81	4,440,298.76
合计	1,863,539,395.68	1,279,465,095.96	973,799,834.20	551,912,841.72

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型		
量产服务收入	1,162,728,907.81	972,664,010.44
设计服务收入	349,824,753.55	282,357,044.97
IP 授权使用费收入	292,667,088.33	23,363,451.84
IP 特许权使用费收入	56,246,300.86	-
其他业务	2,072,345.13	1,080,588.71

合计	1,863,539,395.68	1,279,465,095.96
----	------------------	------------------

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 履约义务的说明

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
量产服务	根据合同约定的交付条款在交货时或签收时履行履约义务	根据具体合同约定	货物	是	0.00	产品质量保证
设计服务	在某一时段内履行履约义务	根据具体合同约定	服务	是	0.00	无
IP 授权使用费	在交付知识产权授权许可产品时履行履约义务	根据具体合同约定	知识产权使用许可	是	0.00	无
IP 特许权使用费	在客户使用行为实际发生时履行履约义务	根据具体合同约定	版税	是	0.00	无
合计	/	/	/	/	0.00	/

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

☒适用 ☐不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为12,448,962,547.06元。

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

62、税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		
城市维护建设税	1,088,720.51	1,323,432.20
教育费附加	468,462.48	567,185.22
资源税		
房产税	1,757,380.65	1,431,685.16
土地使用税		
车船使用税		
印花税及其他	1,049,787.47	539,686.13
地方教育费附加	312,308.31	378,123.47
合计	4,676,659.42	4,240,112.18

其他说明：

无。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	55,080,031.65	43,698,620.80
会议和市场费用	6,615,433.01	9,740,291.42
专业服务费	4,367,423.06	3,278,456.73
差旅交通费用	2,428,275.98	1,866,498.05
租赁和物业费用	637,732.61	744,817.93
办公费	1,487,749.38	864,916.27
股份支付费用	12,123,555.70	-302,169.84
折旧及摊销费用	476,916.12	393,527.30
使用权资产摊销	1,820,938.88	1,641,366.12
其他费用	643,083.21	532,237.90
合计	85,681,139.60	62,458,562.68

其他说明：

无。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	55,110,996.47	43,071,998.33
专业费用	17,312,659.17	6,325,652.53
差旅交通费用	2,932,676.29	1,073,008.69
通讯及办公费用	7,246,490.93	4,165,800.58
租赁和物业费用	605,235.02	482,898.23
股份支付费用	43,381,280.60	75,802.43
折旧及摊销费用	3,656,558.23	1,179,562.37
使用权资产摊销	2,178,669.73	1,959,037.61
其他费用	942,739.83	302,299.28
合计	133,367,306.27	58,636,060.05

其他说明：

无。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	556,890,272.16	440,116,723.21
折旧及摊销费用	145,901,430.11	95,934,617.54
租赁和物业费用	3,164,702.04	2,337,971.07
差旅交通费用	5,329,709.58	4,551,925.93
办公及会务费用	20,184,749.82	10,931,929.45
股份支付费用	63,095,813.41	358,510.66
研发项目外部服务费用	29,126,188.44	11,119,887.64
测试费用	3,548,190.68	10,589,746.81
通讯费用	31,659,059.88	17,954,430.45
使用权资产摊销	15,517,487.16	16,128,991.82
其他费用	5,780,093.72	1,979,956.65
合计	880,197,697.00	612,004,691.23

其他说明：

无。

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	46,688,865.21	20,804,567.35
减：利息收入	3,228,833.17	6,398,490.25
金融机构手续费	243,666.61	142,413.30
汇兑收益	23,500,000.54	3,527,269.80
合计	67,203,699.19	18,075,760.20

其他说明：

无。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税进项税加计扣除	95,110.76	7,593,194.61
南京江北新区产业扶持项目补贴	-	5,024,270.83
其他	24,859,469.80	15,827,999.70
合计	24,954,580.56	28,445,465.14

其他说明：

无。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-97,829.48	-320,785.17
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,219,417.40	1,167,696.34
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
大额存单投资收益	644,985.18	
合计	8,766,573.10	846,911.17

其他说明：

无。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	692,850.50	-214,044.84
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	-22,603,685.21	
合计	-21,910,834.71	-214,044.84

其他说明：

无。

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失）	-1,076.67	1,583.28
合计	-1,076.67	1,583.28

其他说明：

√适用 □不适用

无。

72、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,326.67	5,557.14
应收账款坏账损失	-18,727,759.49	-5,206,120.61
其他应收款坏账损失	-631,943.97	-19,591.24
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
其他非流动资产坏账损失	-114,088.25	53,369.46
合计	-19,471,465.04	-5,166,785.25

其他说明：

无。

73、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	210,984.20	-82,041.63
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-2,930,473.96	745,372.19

合计	-2,719,489.76	663,330.56
----	---------------	------------

其他说明：

无。

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金/保险赔款	559,290.93	605,000.00	559,290.93
其他	14,914.20	2,025.26	14,914.20
合计	574,205.13	607,025.26	574,205.13

其他说明：

√适用 □不适用

无。

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	79,368.75	3,092.05	79,368.75
其中：固定资产处置损失	79,368.75	3,092.05	79,368.75
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
违约金等支出	15,135.49	31,273.27	15,135.49
合计	94,504.24	34,365.32	94,504.24

其他说明：

无。

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,099,173.82	11,469,493.62
递延所得税费用		

汇算清缴差异	4,071,627.68	
合计	15,170,801.50	11,469,493.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-596,954,213.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-89,543,132.01
子公司适用不同税率的影响	7,622,584.01
非应税收入的影响	-11,171,015.65
股权激励行权的纳税影响	1,498,314.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	719,195.88
研发费用加计扣除的纳税影响	-41,891,150.81
汇算清缴差异	4,071,627.68
调整以前期间可抵扣亏损	-10,646,220.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-490,812.41
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	145,248,570.95
境外源泉扣缴所得税费用	9,752,840.77
所得税费用	15,170,801.50

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,228,833.17	6,398,490.25
政府补助补贴	24,847,769.80	20,134,522.27
其他	5,879,272.39	603,184.09
合计	33,955,875.36	27,136,196.61

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金融机构手续费	243,666.64	142,413.30
业务招待费	2,085,639.33	2,129,669.29
租赁费	4,407,669.67	3,565,687.23
测试费	3,548,190.68	10,589,746.81
通讯费	38,905,550.81	32,470,938.93
专业服务费及会议费用等	50,806,270.67	42,131,365.20
其他	81,669,354.59	42,597,885.46
合计	181,666,342.39	133,627,706.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得投资收益收到的现金	8,544,417.40	1,167,696.34
合计	8,544,417.40	1,167,696.34

收到的重要的投资活动有关的现金

无。

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金	883,629,330.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,680,249.07	96,227,851.12
投资支付的现金	6,300,000.00	0.00
合计	970,609,579.99	96,227,851.12

支付的重要的投资活动有关的现金

无。

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品、结构性存款及大额存单收到的现金	4,076,000,000.00	851,000,000.00
合计	4,076,000,000.00	851,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财产品、结构性存款及大额存单支付的现金	4,554,000,000.00	674,000,000.00
合计	4,554,000,000.00	674,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无。

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
采购无形资产分期付款支付额	41,207,555.48	33,697,825.77
支付租赁费用	18,752,687.41	23,377,942.33
支付再融资发行相关费用	-	13,878,171.42
支付港股发行费用	25,056,500.00	-
合计	85,016,742.89	70,953,939.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	-	79,000,000.00	15,045,269.45	5,000,000.00		89,045,269.45
长期借款（含一年内到期）	1,567,199,681.05	199,900,000.00	21,528,234.99	306,890,286.81		1,481,737,629.23

长期应付款（含一年内到期）	114,228,751.61	-	1,195,280.35	40,292,505.93	-437,300.21	75,568,826.24
租赁负债（含一年内到期）	75,081,708.14	-	3,736,646.96	18,752,687.41		60,065,667.69
合计	1,756,510,140.80	278,900,000.00	41,505,431.75	370,935,480.15	-437,300.21	1,706,417,392.61

(4) 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-612,125,014.89	-319,848,567.48
加：资产减值准备	2,719,489.76	-663,330.56
信用减值损失	19,471,465.04	5,166,785.25

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,017,789.54	24,449,477.67
使用权资产摊销	20,197,176.15	20,576,323.89
无形资产摊销	124,492,563.99	81,438,597.87
长期待摊费用摊销	5,538,185.31	5,111,234.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,076.67	-1,583.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	79,368.75	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	21,910,834.71	214,044.84
财务费用（收益以“-”号填列）	55,530,796.66	23,845,611.88
股份支付费用	132,810,100.88	196,262.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,766,573.10	-846,911.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-164,795,232.82	-48,920,523.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-840,177,464.97	-201,451,481.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,834,890,356.85	45,534,265.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	625,794,918.53	-365,199,793.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
债务购置长期资产	26,957,348.47	19,145,102.41
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,059,017,161.76	2,271,904,841.85
减：现金的期初余额	2,006,424,465.77	642,835,328.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-947,407,304.01	1,629,069,513.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	930,488,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	46,858,669.08

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	883,629,330.92

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,059,017,161.76	2,006,424,465.77
其中：库存现金	27,696.39	80,110.94
可随时用于支付的银行存款	1,058,989,465.37	2,006,344,354.83
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,059,017,161.76	2,006,424,465.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
其他货币资金	1,352,509.51	1,089,469.61	海关进口关税、信用证保证金
合计	1,352,509.51	1,089,469.61	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	34,662,207.94
其中：美元	4,929,138.66	6.8109	33,571,870.50
欧元	19,895.88	7.7671	154,533.31
港币	39,654.79	0.8686	34,444.15
人民币	369,721.42	1.0000	369,721.42
加拿大元	111,112.20	4.7847	531,638.56
应收账款	-	-	3,146,577.91
其中：美元	461,991.50	6.8109	3,146,577.91
预付账款	-	-	707,935.16
其中：美元	103,941.50	6.8109	707,935.16
应付账款	-	-	16,998,211.39
其中：美元	2,495,736.45	6.8109	16,998,211.39
其他应付款	-	-	796,615.16
其中：美元	116,239.30	6.8109	791,694.28
加拿大元	1,028.46	4.7847	4,920.88
一年内到期的非流动负债	-	-	17,619,717.75
其中：美元	2,586,988.17	6.8109	17,619,717.75

其他说明：

无。

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☒适用 ☐不适用

境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
--------	---------	-------	------

VeriSiliconCayman	开曼	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
VeriSiliconHong Kong	中国香港	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
VeriSiliconJapan	日本	日元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
VeriSilicon,Inc.	美国	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
VeriSiliconEURL	法国	欧元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
VivanteUS	美国	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
芯原微电子香港	中国香港	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
Verisilicon Vietnam	越南	越南盾	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
ViXS Systems, Inc.	加拿大	美元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
逐点香港	中国香港	港币	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币
逐点日本	日本	日元	根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

本期计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 1,441,914.42 元。低价值资产租赁费用为人民币 57,282.30 元。

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额20,251,884.13(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
临港研发中心部分房产	2,072,345.13	-
合计	2,072,345.13	-

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	1,063,127.16	2,380,683.49
第二年		524,953.58
第三年		
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款总额	1,063,127.16	2,905,637.07

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无。

83、数据资源

□适用 √不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、研发支出**1、按费用性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	558,012,646.02	465,862,678.49
折旧及摊销费用	145,901,430.11	95,934,617.54
租赁和物业费用	3,164,702.04	2,337,971.07

差旅交通费用	5,329,709.58	4,558,489.99
办公及会务费用	20,208,201.41	10,931,929.45
股份支付费用	63,095,813.41	358,510.66
研发项目外部服务费用	29,126,188.44	11,119,887.64
测试费用	63,156,938.41	12,685,628.97
通讯费用	31,659,059.88	17,954,430.45
使用权资产摊销	15,517,487.16	16,128,991.82
其他费用	5,780,093.72	1,979,956.66
合计	940,952,270.18	639,853,092.74
其中：费用化研发支出	880,197,697.00	612,004,691.23
资本化研发支出	60,754,573.18	27,848,401.51

其他说明：
无。

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额			本期减少金额			期末 余额
		内部开发支 出	其他		确认为无 形资产	转入 当期 损益		
某芯片设计平台项目	36,035,385.43	60,754,573.18						96,789,958.61
合计	36,035,385.43	60,754,573.18						96,789,958.61

重要的资本化研发项目
√适用 □不适用

项目	研发进度	预计完成时 间	预计经济利 益产生方式	开始资本化 的时点	具体依据
某芯片设计平台项目	进行中	2026 年	无形资产的 使用	2025 年 1 月	该项目已于 2025 年 1 月完成前期研究阶段工作并通过功能测试，标志着项目能够使用或成功流片在技术上已经具备可行性；该项目立项即具备完整的市场化出售方案；该项目有明确的销售计划并将主要通

					过直接销售芯片方式取得芯片定制解决方案服务收入；该项目单独设立成本归集中心，开发阶段的支出能够可靠地计量。
--	--	--	--	--	---

开发支出减值准备
☐适用 ☒不适用

其他说明
无。

3、 重要的外购在研项目
☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并
☒适用 ☐不适用

(1)本期发生的非同一控制下企业合并交易
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
逐点	2026年1月6日	950,488,000.01	40%	购买	2026年1月6日	取得控制权	39,317,592.66	-63,825,776.38	-18,920,908.24

其他说明：
无。

(2)合并成本及商誉
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	逐点
--现金	930,488,000.01
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	20,000,000.00
--其他	
合并成本合计	950,488,000.01
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	516,089,163.07
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	434,398,836.94

合并成本公允价值的确定方法：

☒ 适用 ☐ 不适用

本次收购交易定价参考第三方机构出具的评估报告协商确定，以协议总额作为基础以确定合并成本公允价值。

业绩承诺的完成情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

大额商誉形成的主要原因：

☒ 适用 ☐ 不适用

本次收购强化公司视觉处理领域技术优势，进一步提升公司在端侧 AI ASIC 市场竞争力；公司将通过分布式渲染与 GPU 的结合，加强在端侧和云侧 AI ASIC 的布局。收购对价大于被收购公司可辨认净资产的差额形成商誉。

2025 年度，公司联合共同投资人对特殊目的公司天遂芯愿进行投资，并以天遂芯愿为收购主体收购逐点半导体的控制权。逐点半导体于 2004 年在张江成立，专注于移动设备视觉处理芯片、视频转码芯片和 3LCD 投影仪主控芯片及实施方案的开发和设计，是全球先进的创新视频、显示处理芯片和解决方案提供商。作为智能手机 AI 独立显示芯片引领者，逐点半导体拥有近 160 项知识产权。

本次收购事项的共同投资人包括：华芯鼎新（北京）股权投资基金（有限合伙）（大基金三期载体之一，其管理人为华芯投资）；上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）（上海三大先导母基金之一）；北京屹唐元创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京芯创智造二期创业投资基金（有限合伙）（亦庄国投旗下基金）；上海涵泽创业投资合伙企业（有限合伙）（即孚腾交大科技策源基金，由上海交通大学和上海国投共同发起设立的直投基金）。

2026 年 1 月，上述收购事项已完成交割。交割完成后，公司享有天遂芯愿的控制权，天遂芯愿持有逐点半导体 100% 股份，逐点半导体纳入公司合并报表范围。

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	逐点	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	559,663,424.01	154,399,838.34
货币资金	46,858,669.08	46,858,669.08
应收款项	32,427,583.10	32,427,583.10
预付账款	4,385,743.07	4,385,743.07
其他应收款	3,376,679.55	3,376,679.55
存货	23,749,875.08	23,749,875.08
其他流动资产	926,248.79	926,248.79
固定资产	20,093,492.92	20,093,492.92
使用权资产	2,705,570.24	2,705,570.24
无形资产	424,079,161.64	18,815,575.97
长期待摊费用	383,251.87	383,251.87
其他非流动资产	677,148.67	677,148.67
负债：	43,574,260.94	43,574,260.94
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付款项	12,345,941.43	12,345,941.43
合同负债	613,456.02	613,456.02
应付职工薪酬	2,981,740.88	2,981,740.88
应交税费	4,280,116.28	4,280,116.28
其他应付款	4,407,813.63	4,407,813.63
一年内到期的非流动负债	2,950,175.34	2,950,175.34
租赁负债	670,444.45	670,444.45
预计负债	5,634.55	5,634.55
递延收益	318,938.36	318,938.36
净资产	516,089,163.07	110,825,577.40
减：少数股东权益		
取得的净资产	516,089,163.07	110,825,577.40

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司在企业合并中取得的可辨认资产、负债，其公允价值的确定以成本法为核心基础，通过全流程逐层开展合并对价分摊(PPA)评估工作，在合并报表层面完成统一汇总校验，对账面原已确认的各项资产、负债价值进行逐项识别与调整，最终将其计量至购买日的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6)其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

全资子公司 VeriSilicon Microelectronics (Hong Kong) Limited 于 2026 年 3 月 20 日完成注销。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
芯原北京	北京	人民币 4,928,974.00 元	北京	集成电路行业	100%		同一控制下企业合并
芯原成都	成都	人民币 20,000,000.00 元	成都	集成电路行业	100%		同一控制下企业合并
图芯上海	上海	人民币 1,515,180.00 元	上海	集成电路行业	100%		非同一控制下企业合并
VeriSilicon Cayman	开曼	美元 50,000.00	开曼	集成电路行业	100%		同一控制下企业合并
VeriSilicon Hong Kong	中国香港	港币 200,000.00	中国香港	集成电路行业		100%	同一控制下企业合并
VeriSilicon Japan	日本	日元 10,000,000	日本	集成电路行业		100%	同一控制下企业合并
VeriSilicon, Inc.	美国	不适用	美国	集成电路行业		100%	同一控制下企业合并
VeriSilicon EURL	法国	欧元 2,000.00	法国	集成电路行业		100%	同一控制下企业合并
Vivante US	美国	不适用	美国	集成电路行业		100%	非同一控制下企业合并
芯原南京	南京	人民币 100,000,000.00 元	南京	集成电路行业	100%		设立
芯原海南	海南	人民币 50,000,000.00 元	海南	集成电路行业	100%		设立
芯原微电子香港	中国香港	港币 1.00	中国香港	集成电路行业		100%	设立
芯原科技	上海	人民币 500,000,000.00 元	上海	集成电路行业	100%		设立

VeriSilicon Vietnam	越南	越南盾 1,273,050,000	越南	集成电路行业		100%	设立
芯原广州	广州	人民币 23,400,000.00 元	广州	集成电路行业	100%		设立
天遂芯愿	上海	人民币 950,000,000.00 元	上海	集成电路行业	40%		设立
逐点半导体	上海	人民币 372,301,920.00 元	上海	集成电路行业		40%	非同一控制下企业合并
逐点珠海	珠海	人民币 30,000,000.00 元	珠海	集成电路行业		40%	非同一控制下企业合并
ViXS Systems, Inc.	加拿大	不适用	加拿大	集成电路行业		40%	非同一控制下企业合并
Pixelworks Hong Kong Limited	中国香港	港币 7,800.00 元	中国香港	集成电路行业		40%	非同一控制下企业合并
Pixelworks Japan Inc.	日本	日元 10,000,000	日本	集成电路行业		40%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2025 年 10 月 10 日，本公司新设立天遂芯愿，本集团持股 100%。2025 年 12 月 12 日，本公司与其他投资方签订天遂芯愿相关的增资协议和股东协议，于 2025 年 12 月 31 日增资完成后，本公司持股 40%，是天遂芯愿单一第一大股东，享有对天遂芯愿的控制权。天遂芯愿相关的股东协议明确，自增资交割日 12 个月届满之日起至 36 个月届满之日，本公司有权自行或指定第三方通过现金和/或发行股份购买资产和/或以可转债等方式，依据中国法律法规及监管机构的要求，按照与其他投资方协商一致的价格与条件收购其他投资方所持全部天遂芯愿股权。若前述收购未能完成，自增资交割日 36 个月届满之日起，其他投资方可以书面形式要求本公司以本金加固定利率的价格以现金收购其他投资方所持全部或部分天遂芯愿股权。截至 2026 年 6 月 30

日，本公司与其他投资方已实缴对天遂芯愿的出资，并将其他股东的出资确认为其他非流动负债。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。

其他说明：
无。

(2)重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币				
子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天遂芯愿	60%	-	-	-
逐点半导体	60%	-	-	-

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

√适用 □不适用

见第八节，十、1、（1）

其他说明：
□适用 √不适用

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天遂芯愿	47,391.51	950,488,000.01	950,535,391.52	726,000.00	0.00	726,000.00	930,000,715.72		930,000,715.72	233,000.00		233,000.00
逐点半导体	189,526,249.11	99,053,495.47	288,579,744.58	106,351,325.91	1,531,109.25	107,882,435.16	/	/	/	/	/	/

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天遂芯愿	0.00	41,675.80	41,675.80	533,670.04	/	/	/	/
逐点半导体	32,300,282.30	-61,751,647.24	-61,751,647.24	-37,410,325.30	/	/	/	/

其他说明：
无。

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1)重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
芯思原微电子有限公司	合肥	合肥	集成电路行业	42%		权益法
上海芯展科技有限公司	上海	上海	集成电路行业	10%		权益法
上海微镁科技有限公司	上海	上海	集成电路行业	12%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

(2)重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3)重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	芯思原	芯思原

流动资产	16,124,139.84	16,451,913.35
非流动资产	2,927,374.76	4,532,724.09
资产合计	19,051,514.60	20,984,637.44
流动负债	72,296,088.91	77,070,838.95
非流动负债	947,854.37	931,787.44
负债合计	73,243,943.28	78,002,626.39
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-54,192,428.68	-57,017,988.95
按持股比例计算的净资产份额	-	-
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	-	-
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	19,097,802.27	14,190,864.75
净利润	2,367,758.99	-19,098,185.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无。

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,541,995.62	1,147,548.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	94,447.06	1,425.71
--其他综合收益		

--综合收益总额	94,447.06	1,425.71
----------	-----------	----------

其他说明

无。

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

☐适用 ☒不适用

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
芯思原	24,768,152.54	1,186,735.31	23,581,417.23

其他说明

无。

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	收购新增	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
MIPI 接口 IP 核项目	2,291,009.24					2,291,009.24	-	与收益相关
南京市重大科技专项项目			400,000.00			8,000.00	392,000.00	与收益相关
高质量发展专项项目 EDA 与 IP 补贴		318,938.36			192,434.62		126,503.74	与资产相关
促进高质量发展项目			750,000.00			750,000.00	-	与收益相关
合计	2,291,009.24	318,938.36	1,150,000.00		192,434.62	3,049,009.24	518,503.74	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
南京江北新区产业扶持项目补贴	-	5,024,270.83
其他	24,859,469.80	15,827,999.70
合计	24,859,469.80	20,852,270.53

其他说明：
无。

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他流动资产、其他非流动资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款和其他非流动负债等，各项金融工具的详细情况说明见附注。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使所有者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元，欧元有关。本集团的主要采购和销售以人民币计价结算。于 2026 年 6 月 30 日、2025 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债为美元、欧元及港币余额外，本集团的资产及负债主要以各主体的记账本位币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

	人民币元	
	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
美元余额		
货币资金	33,571,870.50	14,792,664.24
应收账款	3,146,577.91	6,063,073.24
预付账款	707,935.16	
应付账款	(16,998,211.39)	(17,881,267.20)
其他应付款	(791,694.28)	(1,261,129.51)

一年内到期的非流动负债	(17,619,717.75)	(33,404,976.45)
合计净头寸	2,016,760.15	(31,691,635.68)

人民币元

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
欧元余额		
货币资金	154,533.31	163,852.36
其他应付款		(889,429.63)
合计净头寸	154,533.31	(725,577.27)

人民币元

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
港币余额		
货币资金	34,444.15	29,389.83
其他应收款		(56,630.84)
合计净头寸	34,444.15	(27,241.01)
人民币余额		
货币资金	369,721.42	369,637.32

人民币元

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
加拿大元余额		
货币资金	531,638.56	-
其他应付款	(4,920.88)	-
合计净头寸	526,717.68	-

本集团密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本集团目前并未采用任何措施规避外汇风险

汇率敏感性分析

敏感性分析包括外部的应收款项和应付款项，未包括对本集团境外子公司的应收款项和应付款项。假设在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当年损益和所有者权益的税前影响如下：

人民币千元

项目	汇率变动	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日	
		对利润总额的影响	对所有者权益的影响	对利润总额的影响	对所有者权益的影响
美元	对人民币升值 5%	100.84	100.84	(1,584.58)	(1,584.58)
美元	对人民币贬值 5%	-100.84	-100.84	1,584.58	1,584.58
欧元	对人民币升值 5%	7.73	7.73	(36.28)	(36.28)
欧元	对人民币贬值 5%	-7.73	-7.73	36.28	36.28

港币	对人民币升值 5%	1.72	1.72	(1.36)	(1.36)
港币	对人民币贬值 5%	-1.72	-1.72	1.36	1.36
加拿大元	对人民币升值 5%	26.34	26.34		
加拿大元	对人民币贬值 5%	-26.34	-26.34		

1.1.2 利率风险

本集团因利率变动而引起的金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2026 年 6 月 30 日，本集团浮动利率借款金额为人民币 1,417,173,002.84 元。本集团的政策是保持现有借款的利率情况。

在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期	
		对利润的影响	对所有者权益的影响
短期借款与长期借款	增加 0.3%	(2,125,759.50)	(2,125,759.50)
短期借款与长期借款	减少 0.3%	2,125,759.50	2,125,759.50

人民币元

1.2 信用风险

于 2026 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团于每个资产负债表日审核应收款及合同资产的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的信用损失。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

于 2026 年 6 月 30 日，按欠款方归集的年末集团前五名的应收账款及长期应收知识产权授权费余额合计为人民币 635,811,031.42 元，占应收账款及长期应收知识产权授权费总余额的比例为 36.19%。本公司管理层已对上述客户的信用风险进行单独评估并相应计提预期信用损失。除上述客户外，本公司无其他重大信用集中风险。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团的目的在于持续取得资金及通过计息贷款提供之灵活性以维持平衡。本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，保持并维护信用，与银行保持良好的合作关系，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融负债及租赁负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上
短期借款	89,045,269.45		
应付账款	411,991,356.88	-	-
其他应付款	80,389,080.65	-	-
租赁负债(含一年内到期)	29,526,497.80	28,152,800.12	3,492,795.43
长期应付款(含一年内到期)	55,007,419.87	22,163,941.06	-
长期借款(含一年内到期)	544,594,261.91	694,569,273.43	374,287,927.69
其他非流动负债		684,000,000.00	
合计	1,210,553,886.56	1,428,886,014.61	377,780,723.12

人民币元

2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上
应付账款	325,871,180.57	-	-
其他应付款	74,821,858.83	-	-
租赁负债(含一年内到期)	36,454,571.55	37,491,392.96	4,286,612.57
长期应付款(含一年内到期)	77,132,108.96	39,905,369.27	-
长期借款(含一年内到期)	478,395,190.37	838,309,463.88	388,120,261.00
其他非流动负债	-	706,800,000.00	-
合计	992,674,910.28	1,622,506,226.11	392,406,873.57

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）银行理财产品投资		361,293,355.64		361,293,355.64
（2）结构性存款投资		1,021,212,753.42		1,021,212,753.42
（二）其他非流动金融资产				
（1）权益工具投资	26,730,148.18		169,149,817.94	195,879,966.12
持续以公允价值计量的资产总额	26,730,148.18	1,382,506,109.06	169,149,817.94	1,578,386,075.18

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒适用 ☐不适用

本公司第一层次公允价值计量的其他非流动金融资产系本公司持有的上市公司股票。以资产负债表日的收盘价作为公允价值计量的依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

项目	2026 年 6 月 30 的公允价值	2025 年 12 月 31 的公允价值	估值技术	输入值
银行理财产品	361,293,355.64	356,973,596.46	现金流量折现法	预期收益率
结构性存款 投资	1,021,212,753.42	566,839,662.10	现金流量折现法	预期收益率

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
☒适用 ☐不适用

项目	2026 年 6 月 30 的公允价值	2025 年 12 月 31 的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
权益工具投资	169,149,817.94	193,580,341.86	近期交易价格倒推法、近期交易价格或市场法	被投资单位最近融资价格、波动率、情景概率与可比公司市场乘数

被投资单位最近融资价格、波动率与权益工具投资公允价值成正相关性。

项目	2025 年 12 月 31 日	转出 第三层次	当期利得 或损失总额 计入损益	本期购买	2026 年 6 月 30 日	对于在 报告期末持有的 资产，计入损益的 当期未实现利得或 损失的变动
其他非流动金融资产	193,580,341.86	- 20,000,000.00	- 10,430,523.92	6,000,000.00	169,149,817.94	-10,430,523.92

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☒适用 ☐不适用

于 2026 年 6 月 30 日及 2025 年 12 月 31 日，本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款和其他非流动负债。

本集团管理层认为，财务报表中的非长期金融资产和金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本集团之子公司构成情况，详见第八节，十、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

本集团重要的合营或联营企业详见第八节，十、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
芯思原微电子有限公司（“芯思原”）	联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Wayne Wei-Ming Dai	董事长、首席执行官、总裁
兆易创新科技股份有限公司（“兆易创新”）	本集团原监事在本报告期的过去 12 个月内曾任该公司董事
生纳科技(上海)有限公司（“生纳科技”）	本集团董事长、首席执行官、总裁任该公司董事长，本集团董事任该公司董事
Alphawave IP Inc.（“Alphawave”）	本集团董事及高级管理人员亲属过去 12 个月内曾任该公司董事

威视芯半导体(合肥)有限公司(“威视芯”)	本集团高管任该公司董事
至成微科技(浙江)有限公司(“至成微科技”)	本集团董事及高管任该公司董事
湖南越摩先进半导体有限公司(“湖南越摩”)	本集团董事间接控制该公司
广州增芯科技有限公司(“广州增芯”)	本集团董事间接控制该公司并担任其董事长
鹏瞰集成电路(杭州)有限公司(“鹏瞰”)	本集团高管任该公司董事
上海华力集成电路制造有限公司(“华力集成”)	本集团董事任该公司董事
上海开放处理器产业创新中心(“开放处理器”)	本集团董事长、首席执行官、总裁任该公司理事长，本集团高管任该公司理事
SILICON BOX PTE LTD	本集团董事及高级管理人员亲属任该公司董事

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	交易对手方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
芯思原	芯思原	研发服务	18,283,933.91	65,000,000.00	否	7,267,602.56
威视芯	Whiz Display Inc	资产采购	-	7,000,000.00	否	9,699,480.00
生纳科技	生纳科技	零星采购	-	不适用	否	5,616.00
Alphawave	Alphawave	IP 授权使用费成本	9,300,280.00	30,000,000.00	否	4,491,220.00
Alphawave	芯潮流	IP 授权使用费成本	-	同上	否	40,601,393.00
至成微科技	至成微科技	资产采购	-	30,000,000.00	否	6,450,000.00
湖南越摩	湖南越摩	封测服务	10,336,299.33	20,000,000.00	否	5,914,271.87
鹏瞰	鹏瞰	资产采购	-	40,000,000.00	否	8,406,216.00
SILICON BOX PTE LTD	SILICON BOX PTE LTD	封测服务	1,144,402.34	150,000,000.00	否	-

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
芯思原	IP 授权使用费收入	6,150.00	270,541.66
至成微科技	设计服务收入	1,392,446.44	
兆易创新	设计服务收入		593,586.35
兆易创新	IP 授权使用费收入	214,794.23	8,103,175.51
上海华力	设计服务收入	679,734.40	1,389,620.21
上海华力	IP 授权使用费收入	945,157.39	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,637.10	1,283.08
关键管理人员以权益结算的股份支付确认的费用金额	4,849.65	6.31
合计	6,486.75	1,289.39

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	交易对手方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芯思原	芯思原	14,284,585.00	447,787.71	15,193,242.82	476,684.33
应收账款	至成微科技	至成微科技	4,405,259.70	138,094.40	4,405,259.70	138,213.96
预付款项	湖南越摩	湖南越摩	2,172,978.22		8,946,465.55	

项目名称	关联方	交易对手方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上海开放处理器产业创新中心	上海开放处理器产业创新中心	847,000.00			
其他流动资产	Alphawave	芯潮流	17,074,149.19		16,690,312.59	
其他非流动资产	芯思原	芯思原	8,000,000.00		-	

(1) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	交易对手方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖南越摩	湖南越摩	1,995,145.54	146,498.07
应付账款	SILICON BOX PTE LTD	SILICON BOX PTE LTD	1,143,277.67	
应付账款	芯思原	芯思原	3,578,269.55	
应付账款	Alphawave	Alphawave	9,932,160.78	23,702,275.00
应付账款	Alphawave	芯潮流	-	387,276.68
合同负债	广州增芯	广州增芯	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	芯思原	芯思原	152,830.19	152,830.19
其他应付款	威视芯	威视芯	-	69,585.12
其他应付款	至成微科技	至成微科技	645,000.00	645,000.00
其他应付款	鹏瞰	鹏瞰	-	913,744.00

(2) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
限制性股票激励计划			57,000	2,196,210.00			74,500	6,301,210.00
合计			57,000	2,196,210.00			74,500	6,301,210.00

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
2020 年限制性股票激励计划			人民币 38.53 元	6 个月
2025 年限制性股票激励计划			人民币 84.58 元	52 个月

其他说明

2020 年 12 月 25 日，本集团批准通过 2020 年限制性股票激励计划(“2020 限制性股票计划”), 对 444 名激励对象以人民币 38.53 元/股的授予价格拟授予 308.20 万股限制性股票。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止。

2021 年 8 月 3 日，2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，本集团批准通过向激励对象授予预留限制性股票的议案，对 62 名激励对象以人民币 38.53 元/股的授予价格拟授予 41.20 万股限制性股票。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止。

2021 年 12 月 20 日，2020 限制性股票计划规定的授予条件已成就，本集团批准通过向激励对象授予预留限制性股票的议案，对 27 名激励对象以人民币 38.53 元/股的授予价格拟授予 35.60 万股限制性股票。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 48 个月后的首个交易日至首次授予之日起 60 个月内的最后一个交易日止。

2022 年 1 月 21 日，本集团批准通过 2022 年限制性股票激励计划(“2022 限制性股票计划”), 对 1,099 名激励对象以人民币 39 元/股的授予价格拟授予 343 万股限制性股票。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次

授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。

2022 年 10 月 27 日，本集团 2022 限制性股票计划规定的 2022 年限制性股票授予条件已经成就，以人民币 39 元/股的授予价格向 34 名激励对象授予 58.25 万股限制性股票。根据计划，获得本次预留授予部分的限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。

2025 年 11 月 6 日，本集团批准通过 2025 年限制性股票激励计划(“2025 限制性股票计划”)，对 1,123 名激励对象以人民币 84.58 元/股的授予价格拟授予 643.85 万股限制性股票。根据计划，获授限制性股票的员工需在三个归属期按约定比例分批次归属，第一批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日至首次授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 24 个月后的首个交易日至首次授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三批限制性股票的归属时间为自首次授予之日起 36 个月后的首个交易日至首次授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	限制性股票激励计划激励对象
授予日权益工具公允价值的确定方法和重要参数	布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)模型
可行权权益工具数量的确定依据	本公司管理层的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	395,273,079.60

其他说明

本集团资产负债表日对可行权权益工具数量根据本公司管理层的最佳估计作出，在确定该估计时，考虑了员工预期离职等相关因素的影响。

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
限制性股票激励计划	132,810,100.88	
合计	132,810,100.88	

其他说明
无。

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
资本承诺

人民币千元

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	23,333	35,000

本集团不存在需要披露的其他承诺事项。

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

2026 年 8 月 9 日，经本公司第三届董事会第十三次会议批准，审议通过《芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并同步通过《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本激励计划拟向激励对象授予不超过 514.8000 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 52,591.5273 万股的 0.9789%。其中首次授予不超过 411.8400 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.7831%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80%；预留 102.9600 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.1958%，预留部分占本次授予权益总额的 20%。

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为芯片定制解决方案服务、半导体 IP 授权服务及其他。这些报告分部是以业务性质为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础存在差异。这些差异主要为分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	芯片定制解决方案服务	半导体 IP 授权服务	其他	合计
分部营业收入	1,512,553,661.36	348,913,389.19	2,072,345.13	1,863,539,395.68
分部营业成本	1,255,021,055.41	23,363,451.84	1,080,588.71	1,279,465,095.96
分部利润(亏损)	257,532,605.95	325,549,937.35	991,756.42	584,074,299.72
税金及附加				4,676,659.42
销售费用				85,681,139.60
管理费用				133,367,306.27
研发费用				880,197,697.00
财务费用				67,203,699.19
加：其他收益				24,954,580.56
投资收益				8,766,573.10
公允价值变动损益				-21,910,834.71
信用减值损失				-19,471,465.04
资产减值损失				-2,719,489.76
资产处置损失				-1,076.67
报表营业利润				-597,433,914.28

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4) 其他说明

√适用 □不适用

按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产：

收入来源地	本期
来源于境内的收入	1,303,206,471.60
来源于境外的收入	560,332,924.08
合计	1,863,539,395.68

人民币元

资产所在地	2026 年 6 月 30 日
位于境内的非流动资产	2,218,905,038.74
位于境外的非流动资产	297,260,702.91
合计	2,516,165,741.65

人民币元

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,877,220,514.07	1,774,227,469.41
小于 6 个月	1,826,313,884.93	1,763,395,408.61
6 个月至 1 年	50,906,629.14	10,832,060.80
1 至 2 年	3,594,337.10	17,462,367.92
2 至 3 年	46,329,169.24	79,044,110.51
3 年以上		
3 至 4 年	42,323,519.44	6,656,094.32
4 至 5 年	2,255,518.42	4,810,578.82
5 年以上	3,441,348.65	1,657,047.89
合计	1,975,164,406.92	1,883,857,668.87

单位：元 币种：人民币

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	21,512,665.41	1.09	21,512,665.41	100	-	21,512,665.41	1.14	21,512,665.41	100.00	-
其中：										
单项计提	21,512,665.41	1.09	21,512,665.41	100	-	21,512,665.41	1.14	21,512,665.41	100.00	-
按组合计提坏账准备	1,953,651,741.51	98.91	94,759,264.26	4.85	1,858,892,477.25	1,862,345,003.46	98.86	86,541,305.09	4.65	1,775,803,698.37
其中：										
R1	782,791,377.38	39.63	24,538,439.21	3.13	758,252,938.17	834,141,514.35	44.28	26,163,983.65	3.14	807,977,530.70
R6	2,319,920.32	0.12	1,303,564.76	56.19	1,016,355.56	2,086,967.41	0.11	1,170,457.13	56.08	916,510.28
R7	1,071,046,179.70	54.23	-	-	1,071,046,179.70	928,622,257.59	49.29	-	0.00	928,622,257.59
R8	97,494,264.11	4.94	68,917,260.29	70.69	28,577,003.82	97,494,264.11	5.18	59,206,864.31	60.73	38,287,399.80
合计	1,975,164,406.92	/	116,271,929.67	/	1,858,892,477.25	1,883,857,668.87	/	108,053,970.50	/	1,775,803,698.37

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
应收账款单项计提坏账准备	21,512,665.41	21,512,665.41	100.00	集团认为存在重大财务困难的客户相应的应收账款以及存在重大逾期的应收账款已发生信用减值，并单项计提了减值准备。
合计	21,512,665.41	21,512,665.41	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
R1	782,791,377.38	24,538,439.21	3.13
R6	2,319,920.32	1,303,564.76	56.19
R7	1,071,046,179.70	-	-
R8	97,494,264.11	68,917,260.29	70.69
合计	1,953,651,741.51	94,759,264.26	4.85

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司对非集团内关联方客户进行内部风险等级评估，并结合客户所在地区将其分为8种风险等级，包括中国大陆大客户(R1)、美国大客户(R2)、中国台湾大客户(R3)、欧洲大客户(R4)、东亚大客户(R5)、所有中小客户(R6)、集团内关联方(R7)及高风险客户(R8)，并确定各评级应收账款的预期损失率。本公司基于减值矩阵确认应收账款的预期信用损失准备。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	合计数
2025 年 12 月 31 日	26,163,983.65	81,889,986.85	108,053,970.50
转入已发生信用减值	-65,328.63	65,328.63	0.00
本年计提预期信用损失		10,282,932.00	10,282,932.00
本年转回预期信用损失	1,560,215.81	504,757.02	2,064,972.83
2026 年 6 月 30 日	24,538,439.21	91,733,490.46	116,271,929.67

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无。

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	108,053,970.50	10,282,932.00	2,064,972.83			116,271,929.67
坏账准备						
合计	108,053,970.50	10,282,932.00	2,064,972.83			116,271,929.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	其他非流动资产-应收知识产权授权费年末余额	应收账款、合同资产、其他非流动资产-应收知识产权授权费年末余额	占应收账款、合同资产、其他非流动资产-应收知识产权授权费年末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	550,343,763.72			550,343,763.72	23.31	-
客户二	349,552,751.65			349,552,751.65	14.81	-
客户三	101,916,100.00		23,519,100.00	125,435,200.00	5.31	3,932,094.68
客户四	101,983,440.94	20,466,963.20		122,450,404.14	5.19	3,839,083.95
客户五	102,170,073.01			102,170,073.01	4.33	-
合计	1,205,966,129.32	20,466,963.20	23,519,100.00	1,249,952,192.52	52.95	7,771,178.63

其他说明
无。

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,441,786.03	1,430,087.80
合计	1,441,786.03	1,430,087.80

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(5) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(6) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(7) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(8) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(9) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无。

(10) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(11) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）		
小于 6 个月	1,295,200.92	1,142,328.00
6 个月至 1 年	25,000.00	35,000.00
1 至 2 年	35,000.00	204,472.48
2 至 3 年		-
3 年以上		
3 至 4 年		5,000.00
4 至 5 年	5,629.00	38,705.00
5 年以上	83,726.00	45,650.00
合计	1,444,555.92	1,471,155.48

(12) 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收代垫款		947,520.00
应收押金、备用金及暂支款	231,784.61	319,163.00
应收关联方款项	1,212,771.31	204,472.48
合计	1,444,555.92	1,471,155.48

(13) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☒适用 ☐不适用

人民币元项目	未来 12 个月内 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减 值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减 值)	合计数
2026 年 1 月 1 日余 额	41,067.68	-	-	41,067.68
本期计提	24.81	-	-	24.81
本期转回	38,322.60	-	-	38,322.60

2026 年 6 月 30 日余额	2,769.89	-	-	2,769.89
-------------------	----------	---	---	----------

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(14) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	41,067.68	24.81	38,322.60			2,769.89
合计	41,067.68	24.81	38,322.60			2,769.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无。

(15) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(16) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	721,000.00	49.91	应收关联方款项	小于 6 个月	
第二名	294,122.21	20.36	应收关联方款项	小于 6 个月	
第三名	197,649.10	13.68	应收关联方款项	小于 6 个月	
第四名	38,076.00	2.64	应收押金、备用金及暂支款	5 年以上	1,537.94

第五名	31,529.61	2.18	应收押金、备用金及暂支款	小于 6 个月	9.46
合计	1,282,376.92	88.77	/	/	1,547.40

(17) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,729,346,782.33		1,729,346,782.33	1,441,837,228.15		1,441,837,228.15
对联营、合营企业投资	1,541,995.62		1,541,995.62	1,147,548.56		1,147,548.56
合计	1,730,888,777.95		1,730,888,777.95	1,442,984,776.71		1,442,984,776.71

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
芯原北京	7,057,434.54					7,263,981.45	14,321,415.99	
芯原成都	40,724,910.58					28,787,315.50	69,512,226.08	
图芯上海	9,415,491.37						9,415,491.37	
VeriSilicon Cayman	245,635,145.83					18,730,390.99	264,365,536.82	
芯原南京	43,234,864.06					7,727,866.24	50,962,730.30	
芯原海南	18,971,253.16						18,971,253.16	
芯原科技	500,000,000.00		200,000,000.00				700,000,000.00	
芯原广州	-		5,000,000.00				5,000,000.00	
天遂芯愿	576,798,128.61		20,000,000.00				596,798,128.61	
合计	1,441,837,228.15		225,000,000.00	-	-	62,509,554.18	1,729,346,782.33	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面 价值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末余额 （账面价 值）	减值准备期 末余额
			追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
芯 思 原 微 电 子 有 限 公 司	-				- 192,276.54		192,276.54					
上 海 芯 展 科 技 有 限 公 司	1,147,548.56				94,496.58						1,242,045.14	
上 海 微 镁 科 技 有 限 公 司	-		300,000.00		-49.52						299,950.48	
小计	1,147,548.56		300,000.00		-97,829.48		192,276.54				1,541,995.62	
合计	1,147,548.56		300,000.00		-97,829.48		192,276.54				1,541,995.62	

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1)营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,050,373,540.74	656,496,353.43	567,178,602.59	338,968,107.35
其他业务				
合计	1,050,373,540.74	656,496,353.43	567,178,602.59	338,968,107.35

(2)营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
主营业务收入	1,050,373,540.74	656,496,353.43
合计	1,050,373,540.74	656,496,353.43

其他说明

□适用 √不适用

(3)履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
量产服务	根据合同约定的交付条款在交货时或签收时履行履约义务	根据具体合同约定	货物	是	无	产品质量保证
设计服务	在某一时段内履行履约义务	根据具体合同约定	服务	是	无	无
IP 授权使用费	在交付知识产权授权许可产品时履行履约义务	根据具体合同约定	知识产权使用许可	是	无	无
IP 特许权使用费	在客户使用行为实际发生时履行履约义务	根据具体合同约定	版税	是	无	无
合计	/	/	/	/	无	/

(4)分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5)重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无。

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-97,829.48	-320,785.17
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,073,824.65	1,054,446.56
大额存单投资收益	644,985.18	-
合计	8,620,980.35	733,661.39

其他说明：

无。

6、 其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,076.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	27,645,176.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-13,046,432.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	245,500.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	479,700.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,598,015.65	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	9,724,852.61	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-19.29	-1.16	-1.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.60	-1.18	-1.18

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 17 日

修订信息

☐适用 ☒不适用